พฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 โดยการเคลือบผิว ด้วยคาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร

นายณัฐพงศ์ กลงุนทด

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555

CORROSION RESISTANCE BEHAVIOUR OF AISI H13 HOT WORK TOOL STEEL BY DIAMOND-LIKE CARBON (DLC) COATING

Natthaphong Konkhunthot

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Metallurgical Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2012

พฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 โดยการเคลือบผิวด้วยการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(คร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล) กรรมการ

(ศ. คร.ชูกิจ ถิมปีจำนงค์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ณัฐพงศ์ กลขุนทค : พฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับ งานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 โดยการเคลือบผิวด้วยการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร (CORROSION RESISTANCE BEHAVIOUR OF AISI H13 HOT WORK TOOL STEEL BY DIAMOND-LIKE CARBON (DLC) COATING) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา, 126 หน้า.

เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 ถูกเคลือบด้วยชั้นเคลือบ คาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอสตั้งแต่ -100 ถึง -1000 โวลต์ ด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ โดยลักษณะของโครงสร้างและสัดส่วนของ พันธะระหว่างเพชรต่อกราฟไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ของชั้นเคลือบถูกตรวจสอบด้วยเทคนิค รามานสเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์ เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี และกล้องจลทรรศน์แบบส่องกราค ตามลำคับ หลังจากนั้นพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ ้ การ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรและ ไม่เกลือบถูกทคสอบในสารละลายโซเดียมกลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ก่ากวามเป็นกรด-ด่าง 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดย อาศัยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าวัคเส้นโค้งโพลาไรเซชัน และหาค่าตัวแปรการกัดกร่อน หลังจาก ทดสอบการกัดกร่อน กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด และเทคนิคเอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอน ้ไมโครสโกปีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาบริเวณที่ถูกกัดกร่อน ผลการทดสอบพบว่าชิ้นงาน ้เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรแสดงพฤติกรรม ้ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบผิวทกค่าความเป็น กรค-ค่าง นอกจากนี้ยังพบว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดงพฤติกรรมต้านทานทานการกัดกร่อนสูงที่สด

ลายมือชื่อนักศึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมโลหการ</u> ปีการศึกษา 2555

NATTHAPHONG KONKHUNTHOT : CORROSION RESISTANCE BEHAVIOUR OF AISI H13 HOT WORK TOOL STEEL BY DIAMOND-LIKE CARBON (DLC) COATING. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. PORNWASA WONGPANYA, Ph.D., 126 PP.

DIAMOND-LIKE CARBON/BIAS VOLTAGE/FCVA/CORROSION

Diamond-like carbon (DLC) films were deposited on AISI H13 hot work tool steel prepared under alteration of bias voltage from -100 to -1000V by a filtered cathodic vacuum arc (FCVA) deposition. The film structure and sp³/sp² ratio of DLC films were investigated by Raman spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), x-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM), and scanning electron microscope (SEM), respectively. Furthermore, the corrosion behavior of the uncoated and DLC coated AISI H13 hot work tool steel was examined in air-saturated 3.5 wt.% NaCl solution with pH 2, 7, and 10 at 27°C by the electrochemical technique. After the corrosion test has completed, SEM and X-PEEM were used to evaluate the corroded area. The results indicated that the corrosion resistance of the DLC coated AISI H13 sample was higher than that of uncoated AISI H13 in term of the corrosion rate at all pHs. In addition, it also found that the DLC coated AISI H13 prepared under -1000 V of bias voltage showed the highest corrosion resistance behavior at all tested samples.

School of <u>Metallurgical Engineering</u>

Academic Year 2012

Student's Signature_____Advisor's Signature_____

Co-advisor's Signature_____

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ อย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งด้านข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาแนะนำ การตรวจแก้ไข การติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และ ขอขอบพระกุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ไข ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ และแนวคิด ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งตลอดการทำวิทยานิพนธ์และการทำงานในอนากต

ขอกราบขอบพระคุณ คร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ องค์ความรู้ทางวิชาการในด้านแสงซินโครตรอน และสละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง งานวิจัย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (อาคารเครื่องมือ 6 และ 1) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีทคลอง 3.2a 3.2b และ 6a รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำโรงเครื่องมือกล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ ตลอดการทำวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าของกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ได้ให้กำลังใจ และสนับสนุน การศึกษาเสมอมา ตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ซึ่งไม่สามารถ กล่าวนามได้หมดในที่นี้ สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ ให้แด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนสถาบันการศึกษาอันเป็นที่เการพ

ณัฐพงศ์ กลงุนทด

สารบัญ

e. N	
บทคดยอ (ภาษา ไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	. 1
สารบัญตาราง	պ
สารบัญรูป	ល្ង
บทที่	
1 บทน้ำ	1

I	บทน	I I
	1.1	ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย1
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3	สมมติฐานของการวิจัย
	1.4	ขอบเขตของการวิจัย
	1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2	ปริทั	สนั่วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง5
	2.1	เหล็กกล้ำเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน5
	2.2	กระบวนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคลายเพชร
	2.3	สารหล่อลื่น
		2.3.1 สารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน
		2.3.2 สารหล่อลื่นประเภทจาระบี
	2.4	การกัคกร่อนของโลหะ
		2.4.1 การกัดกร่อนในสภาวะเปียก
		2.4.2 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง
	2.5	การวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิว
		2.5.1 เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (X-PEEM)

สารบัญ (ต่อ)

จ

		2.5.2	เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโกปีหรือสเปกโตรสโกปี	
			ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลคปล่อยค้วย	
			รังสีเอ็กซ์ (XPS)	30
		2.5.3	รามานสเปกโตรสโกปี	32
		2.5.4	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)	34
	2.6	การทบ	มทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	36
3	วัสดุ	อุปกรณ์	สารเคมี ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย	38
	3.1	วัสคุ อุ	ปกรณ์ และสารเคมี	38
		3.1.1	วัสดุที่ใช้ในการวิจัย	38
		3.1.2	อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	41
		3.1.3	สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	55
	3.2	ขั้นตอา	นและวิธีดำเนินการวิจัย	55
		3.2.1	การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ	57
		3.2.2	กระบวนการเกลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ	
			คาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร	59
		3.2.3	การทดสอบการกัดกร่อน	61
		3.2.4	การวิเคราะห์พื้นผิวและการตรวจสอบโครงสร้างของชั้นเคลือบ	62
4	ผลก	ารทดลอ	วงและวิเคราะห์ผลการทดลอง	63
	4.1	การบ่ง	ชี้ลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
		ชั้นเคลื	อบ DLC ภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอสด้วยเทคนิค	
		รามาน	สเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอน	
		ที่ถูกป	ลคปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์ และเอ็กซ์เรย์	
		โฟโตอ็	อิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี	63

สารบัญ (ต่อ)

	4.2	การวิเคราะห์ตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC	70
	4.3	ผลการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำเกรื่องมือ AISI H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ DLC และ ไม่เกลือบ	72
		4.3.1 พฤติกรรมการกัดกร่อนจากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน	72
		4.3.2 กลไกการกัดกร่อนที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่	
		เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบ	78
	4.4	การบ่งชี้ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้ำเครื่องมือ AISI H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ DLC หลังทดสอบการกัดกร่อน	82
		4.4.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้ำเครื่องมือ H13	
		ที่เกลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ DLC และ ไม่เกลือบ ด้วย SEM	82
		4.4.2 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		ที่เกลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ DLC ด้วยเทกนิก X-PEEM	84
5	สรุปเ	และข้อเสนอแนะการทดลองต่อไป	90
	5.1	สรุป	90
	5.2	ง้อเสนอแนะเพื่อการทดลองต่อไป	91
รายการ	รอ้างอิง	۹	92
ภาคผเ	เวก		97
រា៍	าคผนว	อก ก. การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	
		และอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบผิว	97
រា	าคผนว	วก ข. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	101
រា	าคผนว	วก ค. เทคนิคการอาร์กในระบบสุญญากาศและขั้นตอนการเคลือบ	
		ชั้นเกลือบ DLC ด้วยเทกนิกฟิลเตอร์กาโธดิกอาร์ก	
		ในระบบสุญญากาศ	116

สารบัญ (ต่อ)



หน้า

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1.1	ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
2.1	คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H136
2.2	คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
2.3	การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคาร์บอนอสัณฐานกับเพชรและกราฟไฟต์
2.4	ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามความร้อน (the coefficient of thermal expansion)
	ของวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5	ข้อดีและข้อเสียของสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน
2.6	ข้อดีและข้อเสียของสารหล่อลื่นประเภทจาระบี
3.1	ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
3.2	จำนวนชิ้นงานและเงื่อนไขที่ใช้ในการวิจัย
3.3	ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
	ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน 59
3.4	ตัวแปรควบคุมในการเคลือบชั้นเคลือบ DLC
3.5	ค่าความแข็งระดับนาโนเมตรของชิ้นงานที่เคลือบผิว (DLC/Ti/AISI H13)
	และ ไม่เคลือบผิว (Uncoated H13)
4.1	โครงสร้าง ตำแหน่งจุดยอดแหลม และปริมาณสัคส่วน โครงสร้าง
	ของชั้นเคลือบ DLC ที่ได้จากการคำนวณพื้นที่ใต้
4.2	ค่าความแข็งระดับนาโนเมตรของชิ้นงานที่เคลือบผิว (DLC/Ti/AISI H13)
	และไม่เคลือบผิว (Uncoated H13)
4.3	ค่าที่ได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิว
	ด้วยชั้นเคลือบ DLC (DLC coated) และ ไม่เคลือบผิว (uncoated)
ก.1	ค่าน้ำหนักกรัมสมมูลและความหนาแน่นของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13
	และชั้นเคลือบ DLC

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้		
ก.2	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบผิว ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
	ที่พีเอช 2	
ก.3	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบผิว ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
	ที่พีเอช 7	
ก.4	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เกลือบผิว ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
	ที่พีเอช 10	

สารบัญรูป

id	
ราท่	
ขั	

หน้า

2.1	เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ที่ใช้ในการวิจัย
2.2	แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคไอทางเคมี
2.3	แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคลำไอออน11
2.4	แผนภาพการเกลือบชั้นเกลือบ DLC ด้วยเทกนิก
	closed field unbalanced magnetron sputter ion plating 12
2.5	แผนภาพเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศศ. 15
2.6	ภาพแสดงขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ closed-architecture filters
2.7	ภาพแสดงขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ opened -architecture filters
	ที่ถูกติดตั้งเข้ากับแหล่งกำเนิดคาโชดิกอาร์ก16
2.8	ขคลวคทองแคงก่อนคัค (ซ้าย) และหลังคัคโค้ง 90 องศา (ขวา)
2.9	ฟิล์มสารหล่อลื่นระหว่างระนาบแรงเฉือนของชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่
2.10	แผนภาพการวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน
	โดยเครื่องโพเทนชิโอสแตท
2.11	กราฟศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน
2.12	ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม
	ที่ทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่มีและไม่มีคลอไรด์ไอออน
2.13	ลักษณะ โลหะที่เกิดออกไซค์ (ซ้าย) และซัลไฟค์ (ขวา)
2.14	แสดงการกัดกร่อนของคลอไรค์ไอออนที่ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304
2.15	แสดงแผนภาพของ X-PEEM
2.16	แผนภาพการทำงานของ XPS
2.17	แผนภาพระบบการทำงานของรามานสเปกโตรสโกปี
2.18	รามานสเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC
2.19	แผนภาพการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1	เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ก่อนตัด (บน)
	และหลังตัด (ล่าง)
3.2	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
	หลังการขึ้นรูปในสภาพปกติ (ก่อนอบชุบทางความร้อน)
3.3	โครางสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13
	หลังผ่านการอบชุบทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1025 องศาเซลเซียส
	เป็นเวลา 30 นาที
3.4	เครื่องตัดโลหะประเภท EDW WIRECUT 42
3.5	เครื่องขัดพื้นผิวชิ้นงาน 2 หัว แบบหยาบชนิดจานหมุน
3.6	เครื่องขัดพื้นผิวชิ้นงานพื้นผิว 2 หัว แบบละเอียดชนิดจานหมุน
3.7	เตาอบชุบทางความร้อน
3.8	เครื่องถ้างชิ้นงานแบบอัลตราโซนิกส์
3.9	เครื่องกรองไอออนในน้ำ
3.10	ตู้ดูคกวามชื้นแบบแห้ง (บน) และแบบใช้สารเคมี (ล่าง)
3.11	กระดาษทรายที่ใช้สำหรับเครื่องขัดแบบหยาบ 48
3.12	เกรื่องเกลือบ (ชั้นเกลือบ DLC)
	ฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์คในระบบสุญญากาศ
3.13	เครื่องโพเทนซิโอสแตทสำหรับทคสอบการกัคกร่อน
3.14	อิเล็กโทรดอ้างอิง (ซ้าย) และแท่งกราฟไฟต์ อิเล็กโทรดกระแส (ขวา)
3.15	ชุดเครื่องมือวัคค่าพีเอชของสารละลาย
3.16	ชุดอุปกรณ์ในการเตรียมและเก็บสารละลายเคมี
3.17	เครื่อง XPS (ซ้าย) และ X-PEEM (ขวา) 53
3.18	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
3.19	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3.20	แผนภาพแสดงขั้นตอนและการคำเนินการวิจัย

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.21	แผนภาพขั้นตอนการอบชุบด้วยความร้อนของเหล็กกล้าเกรื่องมือ
	สำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 57
3.22	เกรื่องวัดค่าความแข็งแบบ Rockwell C scale
3.23	เกรื่องเกลือบฟิล์มไททาเนียมแบบสปัตเตอริง (ซ้าย)
	และเครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้าของระบบสปัตเตอร์ (ขวา)
3.24	เกรื่องทคสอบความแข็งระดับนาโนเมตร
4.1	รามานสเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ที่เตรียมด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโชดิกอาร์ก
	ในระบบสุญญากาศภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอส
4.2	ตำแหน่งของจีพีคและค่าความแข็งกับศักย์ไฟฟ้าไบแอส
4.3	C1s XPS สเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ภายใต
	ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์
4.4	C K-edge XAS สเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ภายใต้
	ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์
4.5	แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย
	ชั้นเคลือบ DLC ที่กำลังขยาย 3,500X
4.6	แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC
	โดยใช้เทกนิก EDS ในการตรวจสอบ
4.7	แสดงเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้าที่ไม่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ
	DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้า -100 และ -1000 โวลต์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
	ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10
4.8	แผนภาพแสดงการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC
4.9	ลักษณะพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ
	DLC และไม่เคลือบ ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์
	โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ ที่กำลังขยาย 1,000X

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.10	สเปกตรัม XAS ของ C K-edge ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC
	ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000โวลต์ ที่ผ่านการทคสอบการกัดกร่อน
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 87
4.11	สเปกตรัม XAS ของ O K-edge ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC
	ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ที่ผ่านการทคสอบการกัคกร่อน
	ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 88
4.12	สเปกตรัม XAS ของ Ti <i>L-edge</i> ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC
	ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ที่ผ่านการทคสอบการกัคกร่อน
	ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 89
ก.1	วิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน
	และอัตราการกัคร่อนจากเส้น โค้ง โพลาไรเซชัน
ข. 1.1	สวิตช์เปิด/ปิด ตัวแสดงสถานะของปั๊ม110
ข. 1.2	D-sub pin และตัวควบคุมปั้ม
ข. 2	สวิตช์ ON/OFF ระบบน้ำหล่อเย็น111
ข. 3.1	สวิตช์เปิด/ปิด เครื่องจ่ายศักย์ไฟฟ้าไบแอส112
ข. 3.2	สวิตช์ ON/OFF และปุ่มหมุนปรับศักย์ไฟฟ้า112
ข. 4.1	เครื่อง Plasma Arc Power Supply 113
ข. 4.2	แผงควบคุมพัลส์ในการอาร์ค (Arduino Diecimila) และสวิตช์ ON/OFF 113
ข. 5	วาล์วเปิด/ปิด ก๊าซไนโตรเจน115
ข. 6	ฉนวนเซรามิกส์และบริเวณที่ต้องเคลือบด้วยคินสอ 2B116
ข. 7	ตำแหน่งในการวัดการนำไฟฟ้าด้วยมิเตอร์วัดไฟฟ้า116

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

เป็นที่ทราบดีว่าเทคโนโลยีทางด้านพื้นผิว (surface technology) เช่น การเคลือบไอทาง กายภาพ (physical vapor deposition, PVD) การเคลือบไอทางเคมี (chemical vapor deposition, CVD) พลาสมาในไตรดิง (plasma nitride) และคาโชดิกอาร์ก (cathodic arc) มีบทบาทสำคัญใน การพัฒนากระบวนการเคลือบผิวโลหะในปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการ พื้นผิวเรียบ แข็ง ด้านทานต่อการขูดขีด (scratch resistance) การสึกหรอ (wear resistance) หรือ แม้กระทั่งต้านทานต่อการกัดกร่อน (corrosion resistance) ตัวอย่างชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีพื้นผิวมีตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ซึ่งเน้นสมบัติพื้นผิวที่ต้องเรียบและ แข็งพิเศษ เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำและไม่เสียหายได้ง่ายหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่มีขนาด ใหญ่ที่ต้องรับภาระกรรมทางกลและความร้อนสูง เช่น แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลต่าง ๆ เป็นต้น

เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน (hot work tool steel) มีความสำคัญต่อ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เช่น แม่พิมพ์โลหะ (die casting) แม่พิมพ์อัคเส้นร้อน (hot extrusion) ลูกรีคโลหะร้อน (hot roller) โดยเหล็กกล้าเครื่องมือขึ้นรูปร้อนสามารถทนอุณหภูมิ ใค้สูงประมาณ 600 องศาเซลเซียส ซึ่งเหล็กกล้าเครื่องมือที่นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่ เหล็กกล้าเครื่องมือ ขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 AISI H10 และ AISI L6 เป็นต้น ในการออกแบบแม่พิมพ์ที่คีนั้นเป็น เบื้องหลังความสำเร็จในการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กกล้าเครื่องมือขึ้นรูป ร้อนให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนมีการใช้งาน ที่ต้องรับแรงที่เป็นวัฏจักร เกิดการเสียดสี สูญเสียเนื้อโลหะที่ผิว นำไปสู่การสึกหรอ (wear) และใน บางกรณีที่มีการใช้ในสภาวะที่สัมผัสกับสารหล่อลื่นทั้งแบบของเหลวและผง ดังนั้นจะส่งผลให้เกิด การกัดกร่อนที่พื้นผิวได้ง่ายขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่เป็นไปตามต้องการและเหล็กกล้า เครื่องมือหรือแม่พิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นลง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงพื้นผิว (surface modification) โดย วิธีการปรับปรุงพื้นผิวแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ คาร์บูไรซิง (carburizing) การ์โบไนไตรดิง (carbonitriding) และไนไตรดิง (nitriding) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมี กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวแบบใหม่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ใทย เช่น พลาสมาในไตรดิง (plasma nitriding) การเคลือบไอทางกายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) การเคลือบไอทางเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD) และการเคลือบชั้น เคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร (Diamond Like Carbon, DLC) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สะอาด ปลอดภัย และให้ชั้นเคลือบที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี แต่ยังคงต้องมีการทำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ดังนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปร้อนให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ ในระหว่างการใช้งานขึ้นรูปที่ด้องสัมผัสกับสภาวะที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย ในการทำงาน วิจัยนี้จึงได้เลือกวิธีการปรับปรุงแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปร้อนด้วยการเคลือบชั้นเคลือบ DLC โดยวัสดุที่ เลือกเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม กวามด้านทานการกัดกร่อนด้วยเทคนิกทางไฟฟ้าเกมี ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับงานขึ้นรูปร้อนที่ใช้ในงานวิจัยแสดงดังตารางที่ 1.1 เทคนิกที่ใช้ในการเคลือบชั้นเคลือบ DLC คือ เทคนิกฟิลเตอร์กาโชดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ (filtered cathodic vacuum are, FCVA) ซึ่งเป็นกระบวนการเคลือบผิวที่ช่วยเพิ่มความแข็ง และลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ผิว นอกจากนี้ยังปรับปรุงสมบัติกวามด้านทานการกัดกร่อน อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่ เกี่ยวกับชั้นเคลือบ DLC ได้มุ่งเน้นไปในทิสทางที่เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน ดังนั้นเพื่อตอบสนอง จุดมุ่งหมายหลักของกระบวนปรับปรุงพื้นผิว การวิจัยครั้งนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสมบัติดังกล่าว ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

					ð		
Element	С	Mn	Si	Cr	Ni	Мо	V
Wt. %	0.32-0.45	0.20-0.25	0.80-1.20	4.75-5.50	0.30 max	1.10-1.75	0.80-1.20

ตารางที่ 1.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสร้างชั้นเคลือบ DLC
- 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน
 AISI H13 ทั้งก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ใน

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) 2 7 และ 10 ตามลำดับ

1.2.3 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ทั้งก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด เทคนิครามานสเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูก ปลดปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์ และเอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1.3.1 ค่าศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่แตกต่างกันในการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC อาจมีผล ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน การยึดเกาะระหว่างชั้นเคลือบกับวัสดุพื้น และสมบัติเชิงกล โดย ศักย์ไฟฟ้าไบแอสอาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างของชั้นเคลือบแตกต่างกัน

 1.3.2 การกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ที่ไม่ ผ่านการเคลือบและที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในสภาวะความเป็นกรด (พีเอช 2) กลาง (พีเอช 7) และค่าง (พีเอช 10) อาจมีพฤติกรรมที่ต่างกัน

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ชิ้นงานหรือวัสดุพื้น (substrate) ที่ถูกนำมาเคลือบผิวในงานวิจัยครั้งนี้ คือ เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13

1.4.2 เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อปรับปรุงพื้นผิว (surface modification technology) คือ เทคนิค ฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ (filtered cathodic vacuum arc technique, FCVA) โดย ชั้นเคลือบที่ได้จากเทคนิคดังกล่าว คือ ชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร (diamond-like carbon, DLC) อย่างไรก็ตามการเคลือบผิวด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ มีตัวแปรสำคัญที่ต้องควบคุมดังนี้

- ก) ค่าความคัน
- ข) อุณหภูมิวัสดุพื้น
- ค) เวลาที่ใช้ในการเคลือบ
- ง) ศักย์ไฟฟ้าการอาร์กและศักย์ไฟฟ้าใบแอส (bias voltage)
- ความถี่ (frequency) และรอบการทำงาน (duty cycle) ในการอาร์ก

1.4.3 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ตามหัวข้อ 1.4.2 จะถูกนำไปศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชั้นเคลือบตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 ก) การวิเคราะห์พื้นผิวชั้นเคลือบ (surface characterization) ด้วย เทคนิครามาน สเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy) เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนเปกโตรสโกปี (x-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM) สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูก ปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (x-ray photoelectron spectroscopy, XPS) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM)

 ง) ความต้านทานต่อการกัดกร่อน (corrosion resistance) โดยวิธี electrochemical potentiostat ตามหลักเคมีไฟฟ้า เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนในสิ่งแวคล้อมแบบเปียก (wet corrosion) ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ ณ อุณหภูมิห้อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เข้าใจถึงพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน
 AISI H13 ทั้งก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC

 1.5.2 เข้าใจค่าความเป็นกรด-ค่างของสารละลายที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ทั้งก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC

1.5.3 สามารถนำแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางด้านโลหะวิทยาได้ เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างและส่วนผสมทางเคมีของชั้นเคลือบ DLC ที่เคลือบบนเหล็กกล้า เครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนทั้งก่อนและหลังจากทดสอบการกัดกร่อน ถือว่าเป็นการนำเอา เทคนิดขั้นสูงมาช่วยวิเคราะห์ในงานวิสวกรรมพื้นผิวที่ต้องการความละเอียด ซึ่งก่อให้เกิดองก์ ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในการวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนและโลหะวิทยา

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 กระบวนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC สารหล่อลื่น การกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิว และทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการวิจัย ยังได้มีการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พื้นผิวของชั้นเคลือบ โดยสามารถ อธิบายได้ดังนี้

2.1 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน

เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ที่อุณหภูมิสูง เช่น แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน หล่อแบบฉีด อัดขึ้นรูปร้อน งานตัดร้อน เป็นต้น สิ่งสำคัญ คือเหล็กกล้าเครื่องมือจะต้องรักษาสมบัติความแขึ่งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ด้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ การอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูงและมีความเหนียวที่ดี ธาตุผสมที่ส่งเสริมให้เหล็กกล้า เครื่องมือมีคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่ โครเมียม (Cr) โมลิบดีนัม (Mo) และวาเนเดียม (V) สำหรับ การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 อันเนื่องมาจาก เหล็กกล้ากลุ่มนี้สามารถนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน ทุกชนิด ทั้งงานขึ้นรูปโลหะ พลาสติก และแก้ว อีกทั้งยังเหมาะกับการทำใบมืดตัดเหล็กหนา ซึ่งมี ส่วนผสมทางเคมี คือ C: 0.32-0.45% Si: 0.80-1.20% Mn: 0.20-0.25% Cr: 4.75-5.50% Mo: 1.10-1.75% Ni: 0.30% max และ V: 0.80-1.20% ตามลำดับ (Roberts, G.A., 1998) ลักษณะของเหล็กกล้า เครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนที่ใช้ในการวิจัยแสดงดังรูปที่ 2.1 สำหรับตารางที่ 2.1 และ 2.2 แสดงกุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กกล้าเครื่องมือขึ้นรูปร้อน AISI H13



รูปที่ 2.1 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ที่ใช้ในการวิจัย

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกายภา	เพของเหล็กกล้ำเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German special
steel canter, 2010)	

คุณสมบัติ	อุณหภูมิทคสอบ							
การนำความร้อน (W/m·K)	20°C		350	350°C		700°C		
สภาพอบอ่อน	27.2		30.5		33.4			
สภาพชุบแข็งและอบคืนตัว 🏀	25.5 27.6		6	30.3				
	สอเมษณตร	<u>สอเทคเนเดอา</u> อุณหภูมิทคสอบ						
สานไรแลินรื่อวรถตายกังหางอาวา	100°C	200°C		300°C		400°C		
ถมบวะถุพุษการขยายตาพ เงศามาม	10.9		11.9	12.3		12.7		
$\frac{10}{10} \frac{10}{10} 10$	500°C		600°C 700°C		C			
	13.0	13.0 13.3 13		13.5	5			
สายโรยสิทธิ์อารยือตัว	อุณหภูมิทคสอบ							
(10^3) $V(mm^2 - CD)$	200°C		400	°C		800°C		
(10 N/mm = GPa)	224.9		213		124			
ความจุกวามร้อนที่ 100°C (J/g.°C)	0.44							
ความหนาแน่น (g/cm³)	7.85							
สภาพทางแม่เหล็ก	ซึมซับ							

ค่าความแข็งแรง		อุณหภูมิทคสอบ											
(Hot tensile strength)		20 °C		200 °C			300 °C	400 °C		500 °C			600 °C
0.2 % Y.S.	min	n 1240		1150			1070	940		750			400
$(N/mm^2 = MPa)$	max	1370		1320			1240	1130		9	10		590
U.T.S.	min	1420		1370			1290 1180		99		90		640
(N/mm^2)	max	1560		1530			1425	1320		11	30		800
	min	29		29			29	32		35		48	
% R.A.	max	45		45			45	53		59			77
ค่าสัมประสิทธิ์การยืด		อุณหภูมิทคสอบ											
ตัว E in N/mm ² (×1000)		20 °C	1(00°C	200 °C		300 °C	400 °C	50	00°C	600 °C		700 °C
ชุบแข็งและอบคืนตัวให้				9			1						
ความแข็งที่ 43 H	RC	216	1	212	206		200	193		185	174		161
และทคสอบที่อุณหภูมิ					\mathbb{N}_{2}	9							
อบอ่อนและทคสอบที่													
20°C		217											
ชุบแข็งและทคสอบที่		725											
20°C		้ายาลัยเทคโนโลยีล. 208											

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 (Thai-

German special steel canter, 2010)

2.2 กระบวนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร

กระบวนการเคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร (diamond-like carbon, DLC) เกิดขึ้นขณะที่อะตอมของคาร์บอนหรือโมเลกุลของก๊าซไฮโครคาร์บอนถูกทำให้กลายเป็นไอออน (ionize) หรือสลายตัว (decompose) ในฟอร์มที่เป็นอะตอมหรือไอออนแล้วเกิดการถ่ายโอนผ่าน สุญญากาศหรือก๊าซความดันต่ำ (plasma) ไปเคลือบบนผิวของวัสดุพื้น (substrate) หรือชิ้นงาน ซึ่ง ชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถจำแนกออกได้ 2 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของไฮโครเจนในชั้นเคลือบ ดังนี้

- กลุ่มมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ (hydrogenated diamond-like carbon or hydrogenated tetrahedral amorphous carbon; ta-C:H)
- กลุ่มไม่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ (non-hydrogenated diamond-like carbon or hydrogen-free tetrahedral amorphous carbon; ta-C)

ชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรเป็นชั้นเกลือบที่ประกอบด้วยโกรงสร้างของ อะตอมการ์บอนที่มีลักษณะรูปร่างของโกรงสร้างผลึกที่ไม่แน่นอนหรืออสัณฐาน (amorphous carbon) ปกติไม่มีลักษณะเด่นทางด้านโกรงสร้างผลึก โกรงสร้างประกอบไปด้วยพันธะที่ผสมกัน ระหว่างแกรไฟต์ (sp² carbon bonds) และเพชร (sp³ carbon bonds) การควบคุมคุณสมบัติของ ชั้นเกลือบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ก่าศักย์ไฟฟ้า (voltage) ศักย์ไฟฟ้าไบแอส (bias voltage) พลังงานไอออนของการ์บอน (carbon ions energy) กวามหนาแน่นไอออน (ion density) และอุณหภูมิของวัสดุพื้นขณะทำการเกลือบ ชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรมี กุณสมบัติที่ดีบางประการที่กล้ายกับเพชร เช่น กวามแข็ง โมดูลัสของสภาพยึดหยุ่น และกวามเลื่อย ต่อการทำปฏิกิริยาทางเกมี แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรจะได้มา ในลักษณะที่เป็นชั้นเกลือบหรือฟิล์มบางซึ่งไม่มีขอบเกรน โดยคุณสมบัติทั่วไปของชั้นเกลือบ การ์บอนแต่ละรูปฟอร์มและวัสดุต่าง ๆ ได้มีการแสดงดังตารางที่ 2.3 (Robertson, J., 2002) และ 2.4 (Marques, F.C., Lacerda, R. G., and Champi, A., 2003; Wei, C., and Yen, J.Y., 2007)

ปัจจุบันการเคลือบชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรได้ถูกพัฒนาให้มีหลากหลายวิธี ได้แก่ การเคลือบด้วยไอทางเคมี การเคลือบด้วยลำไอออน การเคลือบแบบสปัตเตอริง แมกนีตรอน สปัตเตอริงแบบพลังงานกระตุ้นสูง และคาโธดิกอาร์ก เป็นต้น (Strondl, C., Carvalho, N.M., Hosson, J.Th.M.D., and Kolk, G.J.V.D., 2003; Lu, Z.G., Chung, C.Y., 2008; Grill, A., 1999; Anders, A., 2008)

Materials	sp ³ (%)	H (%)	Density (g·cm ⁻³)	Gap (eV)	Hardness (GPa)
Diamond	100	0	3.515	5.5	100
Graphite	0	0	2.267	0	-
Evaporated C	0	0	1.9	0.4-0.7	-
Sputtered C	5	0	2.2	0.5	3
ta-C	80-88	0	3.1	2.5	80
a-C:H Hard	40	30-40	1.6-2.2	1.1-1.7	10-20
a-C:H soft	60	40-50	1.2-1.6	1.7-4	<10
ta-C:H	70	30	2.4	2.0-2.5	50

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของการ์บอนอสัณฐานกับเพชรและแกรไฟต์

ตารางที่ 2.4 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามความร้อน (the coefficient of thermal expansion, CTE) ของวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Materials	CTE ($\mu m m^{-1} \cdot K^{-1}$)
Diamond	1.0
Graphite	2-8
DLC	2.3
Ti ^{เอ} กยาลัยเทคโน	8.6
AISI H13	10-13

การเคลือบด้วยไอทางเคมี (chemical vapor deposition, CVD) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้สำหรับ การสังเคราะห์ชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร ซึ่งกระบวนการที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ plasma assisted CVD (PACVD) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการใช้ก๊าซไฮโครคาร์บอนเป็น แหล่งกำเนิดของคาร์บอน ดังนั้นชั้นเคลือบที่ได้จะเป็นชั้นเคลือบคาร์บอนอสัณฐานและมีอะตอม ของไฮโครเจนเป็นองค์ประกอบ (amorphous carbon, a-C: H) เป็นชั้นเคลือบที่เกิดจากการรวมกัน ของพันธะระหว่างแกรไฟต์ (sp² carbon bonds) และเพชร (sp³ carbon bonds) มีค่าความแข็ง ระหว่าง 900 ถึง 3000 H_v (ประมาณ 9 ถึง 30 GPa) โดยทั่วไปกระบวนการ PACVD จะทำให้เกิด กวามร้อนไม่น้อยกว่า 600 องศาเซลเซียส และชิ้นส่วนที่เกลือบจะถูกต่อเข้ากับขั้วกาโธด (มีศักย์ไฟฟ้าลบ) ซึ่งเป็นสภาวะที่มีการกวบกุมกวามดัน กวามต่างศักย์ไฟฟ้าให้มีอัตราส่วน เหมาะสม ขณะเดียวกันกับการ์บอนที่อยู่ในก๊าซไฮโดรการ์บอนจะถูกทำให้กลายเป็นไอระเหยและ แตกตัวเป็นไอออนของการ์บอนที่มีประจุบวก (C⁺) เกลื่อนที่ไปยังกาโธคเกิดเป็นชั้นเกลือบที่มี พันธะแข็งแรงบนผิวของชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 2.2 กระบวนการ PACVD เป็นกระบวนการที่ สามารถเกลือบวัสดุได้หลากหลาย เช่น พลาสติก โลหะ และเซรามิกส์ เป็นต้น



รูปที่ 2.2 แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคไอทางเคมี (http://www.made-in-zelenograd.com, 2010)

การเคลือบด้วยลำไอออน (ion beam deposition, IBD) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับ กระบวนการเคลือบผิวด้วยคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรที่ใช้หลักการลำไอออนของคาร์บอนใน การปลูกฝังอะตอมของคาร์บอน แสดงดังรูปที่ 2.3 แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มี สมบัติคล้ายเพชรด้วยเทคนิคลำไอออน ซึ่งเป็นเทคนิคที่แหล่งกำเนิดของคาร์บอนได้จากเครื่อง กำเนิดไอออน (ion source) ที่ให้เฉพาะไอออนของคาร์บอน (C⁺) เท่านั้น และมีแหล่งกำเนิดของ อิเล็กตรอนพลังงานสูง (e⁻ beam evaporator) ใช้สำหรับเร่งพลังงานจลน์ของคาร์บอนไอออนที่วิ่ง เข้าไปเกาะที่ผิวชิ้นงานให้มีพลังงานสูงขึ้นตั้งแต่ 100 ถึง 1000 อิเล็กตรอนโวลต์ (Robertson, J., 2002) โดยกระบวนการจะเกิดขึ้นในระบบสุญญากาศ เมื่อไอออนถูกเร่งด้วยพลังงานจลน์ไปเกาะ บนผิวของชิ้นงานจะเกิดเป็นชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรที่ปราศจากองค์ประกอบของ อะตอมไฮโดรเจน ทำให้ชั้นเคลือบที่ได้มีความหนาแน่นและความแข็งสูง อุณหภูมิที่ใช้ขณะเคลือบ ต่ำใกล้เกียงกับอุณหภูมิห้อง จึงสามารถเคลือบวัสดุได้หลากหลายโดยไม่ทำลายโครงสร้างของวัสดุ นั้น อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวมีข้อเสียที่ให้อัตราการเคลือบค่อนข้างต่ำกว่า 1 ไมโครเมตร ต่อชั่วโมง และชิ้นงานที่นำมาเคลือบจำเป็นด้องมีรูปร่างที่สมมาตรเพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความ สม่ำเสมอ (http://www.spirecorp.com, 2010)



รูปที่ 2.3 แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคลำไอออน

การเคลือบด้วยเทคนิคสปัตเตอริง (sputter ion plating) ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อต้องการให้ได้ชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรที่มีความหนาสูง สามารถเคลือบลงบน วัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้หลากหลาย กระบวนการผลิตอยู่บนพื้นฐานระหว่าง closed field unbalanced magnetron sputter ion plating (CFUBMS) และ PACVD ซึ่งให้ชั้นเคลือบที่มีการยึด เกาะที่ดีกับพื้นผิว สามารถเคลือบได้หลากหลายวัสดุและรูปทรง มีอัตราการการเคลือบสูงจึงเป็น กระบวนการที่เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตให้ได้ปริมาณมาก โดยปกติกระบวนจะ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส ให้อัตราการเคลือบสูงมากกว่า 5 ไมโครเมตรต่อ ชั่วโมง แหล่งกำเนิดของกระบวนการเกิดจากการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอมคาร์บอนหรือ โมเลกุลของก๊าซไฮโดรการ์บอนรวมทั้งจากการสปิตเตอร์ที่แผ่นโลหะที่เป็นเป้าโลหะเคลือบ (target) จึงทำให้ได้ชั้นเกลือบที่หนาและคุณภาพสูง สามารถเกลือบได้อย่างสม่ำเสมอทั่วชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 2.4 จากภาพประกอบด้วยแผ่นเป้าโลหะที่ถูกใช้ในการเกลือบ 4 แผ่น ตั้งอยู่ตรงข้าม โดยมีแผ่นโลหะโกรเมียม (Cr) สำหรับเกลือบฟิล์มบางโกรเมียมก่อนการเกลือบชั้นเกลือบการ์บอน ที่มีสมบัติกล้ายเพชร ซึ่งฟิล์มบางนี้จะทำหน้าที่ลดกวามเก้นภายในชั้นเกลือบและเพิ่มแรงยึดเกาะ ระหว่างชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรกับวัสดุพื้น แหล่งกำเนิดของการ์บอนในที่นี้ได้จาก แผ่นโลหะผสมทังสเตนการ์ไบด์ (WC) โดยกระบวนการเกลือบมีการใช้ก๊าซอาร์กอน (Ar gas) เพื่อช่วยในการสปัตเตอร์และก๊าซอะเซทิลีน (acetylene gas) ร่วมทำปฏิกิริยาด้วย ชิ้นงานมี การวางอยู่บนแท่นวางชิ้นงานที่สามารถหมุนได้ เพื่อให้ชั้นเกลือบที่ได้มีกวามสม่ำเสมอมากขึ้น (Strondl, C., Carvalho, N.M., Hosson, J.Th.M.D., and Kolk, G.J.V.D., 2003)



รูปที่ 2.4 แผนภาพการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิค CFUBMS

การเคลือบด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบพลังงานกระตุ้นสูง (high power impulse magnetron sputtering, HIPIMS) ถูกประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความหนาแน่น และอัตราการเคลือบสูง ด้วยพลังงานที่สูงกว่า 1000 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ความกว้างของพัลส์ 50 ถึง 200 ไมโครวินาที ความถี่กว่า 50 ถึง 1000 เฮิรตซ์ และรอบการทำงาน (duty cycle) ต่ำโดย ปกติจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้สามารถผลิตพลาสมาที่มีความหนาแน่นสูง ้โดยที่เกิดความร้อนบริเวณคาโธดต่ำได้ แต่ปกติปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในกระบวนการเกลือบผิว คือ แรงยึดเหนี่ยวหรือการยึดเกาะ (adhesion) ของชั้นเคลือบบนวัสดุพื้นต่ำ ถึงแม้ว่ากระบวนการเคลือบ ้ผิวทั่วไปแบบ PVD สามารถที่จะให้สัคส่วนของเพชร และค่าความแข็งของชั้นเคลือบสูง แต่ปัญหา ที่พบคือการยึดเกาะของชั้นเคลือบกับวัสดุพื้นที่ต่ำ เนื่องจากความเค้นแรงอัด (compressive stress) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเคลือบ ส่งผลให้บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบและวัสดุพื้นมี แนวโน้มที่จะแยกออกเป็นชั้นฟิล์มหรือหลุดร่อนได้ง่ายเมื่อถูกแรงกระทำจากภายนอก ดังนั้น เทคโนโลยีของ HIPIMS สามารถทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้ โดยการเกลือบฟิล์มบางโลหะรอง พื้นก่อนในขั้นตอนแรก ซึ่งฟิล์มบางที่ได้เกิดจากการปลูกฝังไอออนของโลหะก่อนที่จะเคลือบชั้น เคลือบ DLC ตามขั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ทำให้กระบวนการ HIPIMS สามารถผลิตชั้นเคลือบที่มี คุณสมบัติเชิงกลที่ดีและได้ความหนาชั้นเคลือบที่สูง เนื่องจากแหล่งกำเนิดของ HIPIM จะให้ความ หนาแน่นของไอออนที่สูงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระบวนการสปัตเตอร์แบบคั้งเคิมให้ก่ากวาม หนาแน่นของไอออนโลหะได้น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ โดยไอออนที่วิ่งเข้ามาเกาะที่วัสดุพื้นจะถูกเร่ง ด้วยความต่างศักย์ใบแอสในช่วง 600 ถึง 1200 โวลต์ ซึ่งทำให้เพิ่มพลังงานของไอออนและ ประสิทธิภาพของการสปัตเตอร์ลงบนวัสดุได้สูงมาก ถ้าพลังงานที่เกิดขึ้นสูงเพียงพอ ฟิล์มบางของ โลหะที่เคลือบก่อนหน้าอาจเกิดเป็นชั้นสารประกอบโลหะ (inter-metallic) บาง ๆ ระหว่างชั้น เกลือบ DLC กับฟิล์มบางโลหะได้ ซึ่งเป็นปัจจัยให้สามารถลดความเค้นแรงอัดระหว่างรอยต่อของ ชั้นเคลือบและยังสามารถปรับปรุงแรงยึดเกาะของชั้นเคลือบ DLC กับวัสดุพื้นให้ดียิ่งขึ้น (http://www.richterprecision.com, 2010)

การเคลือบด้วยเทคนิคคาโธดิกอาร์ก (cathodic arc) เกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดที่เป็นโลหะ สองชนิด (คาโธดและแอโนด) ในสุญญากาศ ซึ่งกระบวนการแตกตัวเป็นไอออนเกิดขึ้นที่คาโธดจึง ถูกเรียกว่า คาโธดิกอาร์ก คาโธดิกอาร์กถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเนื่องจากให้พลาสมา ของโลหะคงที่ สม่ำเสมอและการควบคุมสะดวก เทคนิคคาโธดิกอาร์กที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ เทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ (filtered cathodic vacuum arc, FCVA) เนื่องจาก เป็นเทคนิคที่ให้คุณสมบัติชั้นเคลือบที่ดี เช่น ความแข็งสูง ค่าสัมประสิทธิ์การยืดตัวและ

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (Anders, A., 2008) โดยให้พันธะของเพชร (sp³ carbon bonds) สูงเกิน ้ร้อยละ 80 ของโครงสร้าง แต่ข้อเสียของเทคนิคนี้ คือ ระหว่างการอาร์กจะเกิดอนุภาคที่หลอมเหลว ของโลหะที่มีขนาคระดับไมโครเมตรเกิดขึ้น ที่ถูกเรียกว่า macroparticles ซึ่งเป็นอนุภาคที่ทำให้เกิด ้ปั้งหากับพื้นผิวชั้นเคลือบได้ สำหรับวิธีการกำจัดอนภาคเหล่านี้สามารถทำได้โดยการใช้ขดลวด องศา ทำหน้าที่เป็นตัวกรองอนุภากและควบคุมลำพลาสมาใน แม่เหล็กไฟฟ้าดัดโค้ง 90 ขณะเดียวกัน โดยยอมให้อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า (macroparticles) สามารถลอดผ่านขดลวด ้ออกไปได้ คงเหลือเฉพาะไอออนที่ถูกบังกับอยู่ภายในงดลวดก่อนตกกระทบที่ผิวชิ้นงาน แต่ข้อเสีย อีกประการของเทคนิคนี้ คือ ชั้นเคลือบที่ได้มีความเค้นภายในที่สูง ทำให้แรงยึดเกาะระหว่าง ้ชิ้นงานและชั้นเคลือบต่ำ วิธีการแก้ไขทำได้โดยการเคลือบฟิล์มบางของโลหะที่สามารยึดเกาะได้ดี ระหว่างชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรกับชิ้นงานเหล็กกล้า ได้แก่ ไททาเนียม โครเมียม ซิลิกอน ทั้งสเตน ลงบนผิวชิ้นงานก่อนการเคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร ซึ่งการ เคลือบดังกล่าวอาจเกลือบด้วยโลหะเพียงชั้นเดียว (monolayer) หรือหลายชั้น (multilayer) และการ แก้ไขอีกวิธีคือ การเพิ่มอะตอมหรือไอออนของโลหะไปพร้อม ๆ กันกับการเกลือบการ์บอนที่มี สมบัติกล้ายเพชร วิธีการนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าของชั้นเกลือบได้ ซึ่งเหมาะกับ การเคลือบฉนวนที่ถูกใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องนำไฟฟ้าได้ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้ เทกนิกฟิลเตอร์กาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศในการสร้างชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้าย เพชร จากรูปที่ 2.5 แสดงแผนภาพการเกลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิค FCVA ซึ่งได้ถูกปรับปรุง และพัฒนาขึ้นที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โคยมีรายละเอียคของขั้นตอนการปรับปรุงคังนี้



รูปที่ 2.5 แผนภาพเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ



รูปที่ 2.6 ภาพแสดงขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ closed-architecture filters



รูปที่ 2.7 ภาพแสดงขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ opened -architecture filters ที่ถูกติดตั้งเข้ากับแหล่งกำเนิดคาโธดิกอาร์ก

 สำหรับขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ทำเป็น filter ถูกทำจากท่อทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.33 มิลลิเมตร พันทั้งหมด 15 รอบ ด้วยขนาดรัศมีของการพันเท่ากับ 2.40 เซนติเมตร หลังจากนั้นดัดโค้ง 90 องศา เพื่อใช้กรอง macroparticles แสดงดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ขคลวคทองแคงก่อนคัค (ซ้าย) และหลังคัคโค้ง 90 องศา (ขวา)

 ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับง่ายศักย์ไฟฟ้าไบแอสให้กับชิ้นงาน เพื่อใช้ใน การเพิ่มพลังงานของการ์บอนไอออน (carbon ions energy) ที่จะวิ่งเข้ามายังชิ้นงานให้มีพลังงาน เพียงพอสำหรับงานการเกิดชั้นเกลือบ DLC (ปกติการ์บอนไอออนจะต้องมีพลังงานอยู่ในช่วง ระหว่าง 30 ถึง 150 อิเล็กตรอนโวลต์)

 4. ได้ติดตั้งระบบหล่อเย็นให้กับแหล่งกำเนิดกาโธดิกอาร์ก เนื่องจากขณะเกิด การอาร์กจะมีความร้อนเกิดขึ้นบริเวณจุดอาร์ก ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดกวามเสียหายได้เมื่อใช้เป็น เวลานาน ดังนั้นระบบหล่อเย็นจะช่วยยืดระยะเวลาในการเกลือบและอายุการใช้งานของ แหล่งกำเนิดกาโธดิกอาร์กให้นานยิ่งขึ้น

5. ได้มีการติดตั้งท่อสำหรับส่งก๊าซที่ใช้ในระบบการเคถือบ และติดตั้งระบบ จำกัดปริมาณการไหลของก๊าซ (leak valve) เข้าสู่ห้องเคลือบ

2.3 สารหล่อลื่น

สารหล่อลื่น (lubricant) ที่เหมาะสมสำหรับแม่พิมพ์โลหะจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยยืดอายุ ของแม่พิมพ์ให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด ดังนั้นจึงด้องมีการเลือกและจัดการเกี่ยวกับการใช้ สารหล่อลื่น สารหล่อลื่นที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน (oil) หรือจาระบี (grease) ซึ่งจุดประสงก์หลักถูกใช้เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวที่เกลื่อนที่ สัมผัสกัน ลดความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีและลดการสึกหรอ สำหรับกลไกของสารหล่อลื่นที่ เกิดขึ้นประกอบด้วยการเกิดชั้นเกลือบของเหลวระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกัน ทำหน้าที่เสมือนเป็นชั้น ที่ลดแรงสะเทือนและหล่อลื่นการเกลื่อนที่ของผิวสัมผัสให้แรงเสียดสีที่เกิดขึ้นลดลง คุณสมบัติของ การลดแรงเสียดทานนั้นได้ถูกเรียกว่า ความสามารถในการหล่อลื่น (lubricity) ลักษณะของสาร หล่อลื่นที่ดีได้แก่ จุดเดือดสูง จุดเยือกแข็งต่ำ ดัชนีความหนืดสูง มีเสลียรภาพทางกวามร้อน ป้องกัน การกัดกร่อนและความด้านทานการเกิดออกซิเดชันสูง โดยสารหล่อลื่นมีหน้าที่หลัก คือ ลดแรง เสียดทาน ลดการสึกหรอ ดูดซับการสั่นสะเทือน ลดอุณหภูมิ และลดการกัดกร่อนให้น้อยที่สุด การ ลดแรงเสียดทานเป็นหน้าที่แรกของสารหล่อลื่น โดยสารหล่อลื่นจะทำหน้าที่อยู่ระหว่างพื้นผิวสอง พื้นผิวที่สัมผัสกันอยู่เป็นชั้นเคลือบหนืดเหนือพื้นผิวระหว่างระนาบของแรงเลือน แสดงดังรูปที่ 2.9 (Bannister, K.E., 1996)

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุรบา

18



รูปที่ 2.9 ฟิล์มสารหล่อลื่นระหว่างระนาบแรงเฉือนของชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่

สารหล่อลื่นทำหน้าที่เติมเต็มพื้นผิวส่วนที่หยาบให้น้อยลง ส่งผลให้การชนกันระหว่าง พื้นผิวที่ขรุขระลดลง เสษโลหะที่เกิดจากการชน และการสึกหรอระหว่างพื้นผิวลดลง อายุการใช้ งานจึงเพิ่มขึ้น การดูดซับแรงสั่นสะเทือนมีความสำคัญอย่างยิ่งภายในพื้นเพืองที่ประสานกัน เมื่อ ไม่ได้มีการใช้สารหล่อลื่นพื้นเพืองที่ประสานกันจะเกิดคลื่นสั่นสะเทือน (shock wave) สูง ซึ่ง บ่อยครั้งเป็นผลให้พื้นเพืองแตกหักได้ ดังนั้นการใช้สารหล่อลื่นพบว่าช่วยลดการสั่นสะเทือนใน ลักษณะของการดูดซับการสั่นสะเทือนไว้และทำให้พื้นเพืองวิ่งไปด้วยความราบเรียบมากขึ้น และ อีกหนึ่งประโยชน์หลักของสารหล่อลื่นนอกจากลดแรงเสียดทานแล้วคือการลดอุณหภูมิในขณะ ปฏิบัติงาน โดยสารหล่อลื่นจะทำหน้าที่ในการกระจายความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารหล่อลื่นที่ เป็นน้ำมันสามารถนำความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีออกไปได้ดีกว่าอากาศที่อยู่รอบ ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถลดการกัดกร่อนได้ด้วยการป้องกันความชื้นที่อยู่ในอากาสรอบข้างไม่ให้สัมผัสกับ ชิ้นงาน อย่างไรก็ตามสารหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือสารหล่อลื่นที่หมดอายุการใช้ สารหล่อลื่นบางประเภทก็กัดกร่อนโลหะบางชนิดได้ ดังนั้นการเลือกใช้สารหล่อลื่นจึงกวรพิจารณา กวบกู่กับตัวแปรในหลาย ๆ ด้าน เช่น พื้นผิวที่สัมผัส อุณหภูมิของระบบ เป็นต้น

2.3.1 สารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน

สารหล่อลื่นประเภทน้ำมันสามารถจำแนกได้ชนิดดังนี้

- (1) สารหล่อลื่นจากพืชและสัตว์ (vegetable/animal lubricant)
- (2) สารหล่อลื่นจากสินแร่ (mineral lubricant)
- (3) สารหล่อลื่นจากการสังเคราะห์ (synthetic lubricant)

สารหล่อลื่นจากพืชและสัตว์

โดยปกติน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตวจะไม่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากมัก เกิดการเป็นกรดขึ้นหลังจากถูกใช้งาน ซึ่งกรดที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อพื้นผิวทำให้เกิดการกัดกร่อน ที่รุนแรง ดังนั้นส่วนใหญ่น้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จุดประสงค์มักถูกใช้สำหรับการประกอบ อาหาร

สารหล่อลื่นจากสินแร่

โดยส่วนมากสารหล่อลื่นประเภทน้ำมันได้มาจากขั้นตอนของการทำให้ ปิโตรเลียมบริสุทธิ์ (refining petroleum) วิธีการทำให้บริสุทธิ์ไม่ว่าด้วยกระบวนการการใช้ สารละลายหรือกระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยการใช้ไฟฟ้า ทั้งสองวิธีนี้จะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น น้ำมันที่เรียกว่า stock oil ซึ่งเมื่อเติมสารเติมแต่ง (additive) เข้าไปก็จะได้เป็นสารหล่อลื่นที่มี คุณสมบัติพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้

สารหล่อลื่นจากการสังเคราะห์

การสังเคราะห์สารหล่อลื่นถูกทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้ได้สารหล่อลื่นที่มีความ สม่ำเสมอของโครงสร้างมากกว่าน้ำมันที่ได้จากปีโตรเลียมและเพื่อทดแทนปีโตรเลียมซึ่งเป็นแหล่ง พลังงานจำกัด ส่วนใหญ่สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงมักได้จากการสังเคราะห์
ข้อคื	ข้อเสีย
ใช้งานง่าย	ควบคุมยาก
ต้นทุนต่ำ	ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สามารถทำความสะอาดและถ่ายเทได้สะดวก	รั่วซึมได้ง่าย
สามารถใช้ในระบบหมุนเวียนได้	กวามหนืดต่ำ
มีคุณสมบัติที่เสถียรมากกว่าจาระบี	ควรกำจัดเศษโลหะออกก่อนใช้งานรอบต่อไป

ตารางที่ 2.5 ข้อดีและข้อเสียของสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน (Bannister, K.E., 1996)

2.3.2 สารหล่อลื่นประเภทจาระบี

ไม่ว่าจะเป็นสารหล่อลื่นประเภทน้ำมันหรือจาระบิก็มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน แต่ สิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือน้ำมันเป็นของเหลวสามารถไหลได้ง่ายด้วยตัวของมันเอง ส่วนจาระบิถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเช่นกันแต่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ด้วยลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนี้จะช่วยลด ความคันจากการเกลื่อนที่ของพื้นผิวได้ดีกว่าน้ำมัน จาระบิที่ใช้งานอยู่มีลักษณะที่หลากหลายตั้งแต่ ลักษณะกล้ายของเหลวจนไปถึงมีความหนืดและกวามแข็งสูง ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

ตารางที่ 2.6 ข้อดีและข้อเสียของสารหล่อลื่นประเภทจาระบี (Bannister, K.E., 1996)

	146*
ข้อดี ^เ กยาลัยเทย	าโนโลยีฉีวี ข้อเสีย
เกาะติดได้ดีกับชิ้นส่วนจักรกล	เสียคุณสมบัติที่อุณหภูมิสูงได้ง่าย
ทนทานต่อแรงกระแทก	กักเก็บเศษ โลหะเล็ก ๆ ทำให้เกิดการเสียดสีต่อ พื้นผิว
ไม่จำเป็นต้องใช้งานสม่ำเสมอ	ด้วยความหนืดสูงทำให้ต้องใช้พลังงานขับเคลื่อน เพิ่มขึ้น
ปิดกลั้นเศษอนุภากขนาดเล็ก ๆ ไม่ให้เข้ามา	
ในระบบได้ดี	

2.4 การกัดกร่อนของโลหะ

การกัดกร่อนของโลหะสามารถแบ่งได้ตามชนิดของสิ่งแวคล้อมการกัดกร่อน (Fontana, M.G., 1987; Sedriks, A.J., 1996) ได้ดังนี้

2.4.1 การกัดกร่อนในสภาวะเปียก

การกัดกร่อนคือการสูญเสียเนื้อโลหะโดยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อมอาจ เป็นปฏิกิริยาทางเคมีหรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง หนึ่งกล่าวคือ สินแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนพื้นโลกมีสภาวะเสถียรภาพอยู่แล้ว เมื่อนำสินแร่เหล่านี้มาถลุง ให้ได้เนื้อโลหะบริสุทธิ์ทำให้โลหะอยู่ในสภาวะไม่มีเสถียรภาพมากขึ้นโลหะที่ไม่มีเสถียรภาพจะ พยายามกลับคืนสู่สภาพเดิมคือสินแร่ตามธรรมชาติที่มีเสถียรภาพสูงกว่า ซึ่งก็คือกระบวนการกัด กร่อน ดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายามในการรักษาสภาพของโลหะเหล่านี้ให้เสื่อมสภาพจากสาเหตุ การกัดกร่อนน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

การกัดกร่อนในสภาวะเปียกเกิดเมื่อโลหะถูกใช้งานและสัมผัสกับตัวกลางการกัด กร่อนที่เป็นของเหลว เช่น ความชื้น น้ำหรือน้ำทะเล รวมทั้งสารละลายต่าง ๆ เป็นต้น

ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, *E*_{corr}) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อัตรารวมของ ปฏิกิริยาแอโนดิกทั้งหมดเท่ากับอัตรารวมของปฏิกิริยาคาโธดิก โดยความหนาแน่นกระแสที่ ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, *i*_{corr}) ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้อัตราการกัดกร่อน (corrosion rate) การวัดศักย์ไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าขณะเกิดการกัดกร่อนสามารถทำได้โดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) ซึ่งมี ลักษณะการวัดดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 แผนภาพการวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนโดยเครื่อง โพเทนชิโอสแตท

> อิเล็กโทรดที่ใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ ก) อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) คือ ซิลเวอร์ต่อซิลเวอร์ คลอ ไรด์ (Ag/AgCl) ข) อิเล็กโทรดกระแส (counter electrode) คือ แพลทินัม (Pt) หรือ แกรไฟต์ (graphite)

ก) อิเล็กโทรคตัวอย่าง (specimen electrode) คือ ชิ้นงานทคสอบ

ค่าศักย์ไฟฟ้าได้จากการวัดเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงกับ อิเล็กโทรดตัวอย่าง สำหรับค่ากระแสไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบระหว่างอิเล็กโทรดกระแสกับ อิเล็กโทรดตัวอย่าง จากค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้เมื่อนำมาสร้างกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองจะได้กราฟที่เรียกว่ากราฟเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (polarization curve)



รูปที่ 2.11 กราฟศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

จากรูปที่ 2.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของ ปฏิกิริยาแอโนดิกและปฏิกิริยาคาโธดิกบนพื้นผิวของโลหะที่กำลังเกิดการกัดกร่อน เมื่อมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วไฟฟ้าที่ผิวความต่างศักย์ของขั้วทั้งสองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังใน เส้นกราฟแอโนดิก (anodic curve) และเส้นกราฟคาโธดิก (cathodic curve) ตามลำดับ โดยที่ความ ต่างศักย์ของแอโนดจะเปลี่ยนค่าไปในทางบวก ส่วนความต่างศักย์ของคาโธดจะเปลี่ยนค่าไป ในทางลบ ลักษณะเช่นนี้แสดงถึงการเกิดโพลาไรเซชันของขั้วทั้งสอง ซึ่งสามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้า การกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนได้จากจุดตัดของเส้นความชันของ เส้นกราฟแอโนดและเส้นกราฟแคโทดดังรูปที่ 2.11

เมื่อทราบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการ กัดกร่อนแล้ว สามารถหาอัตราการกัดกร่อน (Fontana, M. G., 1987; Sedriks, A. J., 1996) ได้จาก

$$R_{mpy} = 0.13 i_{corr} e / \rho หรือ R_{mmpy} = 3.27 i_{corr} e / \rho$$
(1)

เมื่อ R_{mpy} = อัตราการเกิดการกัดกร่อน (มิลล์ต่อปี)

i_{corr} = ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน (ไมโครแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)
 e = น้ำหนักกรัมสมมูลของโลหะ

ho = กวามหนาแน่นของโลหะ (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่างการศึกษากลไกพาสซิวิตี (passivity) ของ เหล็กกล้าไร้สนิมจากกราฟเส้นโค้งโพลาไรเซชันเมื่อทำการทดลองต่อจากรูปที่ 2.11 โดยเพิ่ม ้ศักย์ไฟฟ้าไปทางสูงขึ้น (noble) จาก E_{corr} และบันทึกค่ากระแสที่ได้ ดังรูปที่ 2.12 ทราบว่า จุดตัด ของเส้นกราฟคาโธดิกและเส้นกราฟแอโนดิก คือ ค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนหรือ E_{corr} เมื่อเพิ่ม ้ศักย์ไฟฟ้าต่อกระทั่งจุดหนึ่งกระแสกลับลดลงเนื่องจากเกิดฟิล์มพาสสีฟ (passive film) บนผิวโลหะ เรียกค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดว่าเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงแอคทีฟ-พาสสีฟ (active-passive transition) และ ้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เรียกว่าศักย์ไฟฟ้าพาสซิเวชันปฐม (primarily passive potentials) ใช้สัญลักษณ์ E_{pp} เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าต่อไปกระแสจะเริ่มลดลงจนคงที่ ๆ ค่าหนึ่ง แม้จะเพิ่มศักย์ไฟฟ้าให้แก่เซลล์ ต่อไปความหนาแน่นของกระแสก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงกราฟที่แสดงจุดนี้เรียกว่าช่วงพาสสีฟ (passive zone) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความทนทานของฟิล์มบนผิวโลหะ ถ้ายังเพิ่ม ้ศักย์ไฟฟ้าต่อไปอีกจนถึงก่าหนึ่งซึ่งฟิล์มพาสสีฟแตกหรือหลุดล่อนจะทำให้กระแสเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว เรียกช่วงที่เลยจุดนี้ว่า ช่วงทรานพาสสีฟ (transpassive zone) และเรียกศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้ว่า ้ศักย์ไฟฟ้าทรานพาสสีฟ ใช้สัญลักษณ์ E, ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เป็นค่าที่โลหะเริ่มกัดกร่อนเฉพาะที่ คือ การกัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (pitting corrosion) ซึ่งหากป้อนศักย์ไฟฟ้าเกินค่า E, จะเกิดการแตก ของฟิล์มพาสสีฟจุดใหม่เพิ่มขึ้นและฟิล์มจุดที่แตกจุดเดิมจะมีการขยายตัวของรูเข็มหรือหลุมใหญ่ ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเส้นโพลาไรเซชันที่ได้จากการทดลองของโลหะตัวอย่างในสารละลายที่ไม่มี ้คลอไรด์และสารละลายที่มีคลอไรด์พบว่าในสารละลายที่มีคลอไรด์จะให้ค่า E, หรืออีกนัยหนึ่ง ้เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม ใช้สัญลักษณ์ $E_{_p}$ ต่ำกว่า และมีความกว้างช่วงพาส ้สีฟแกบกว่าเส้นโค้งโพลาไรเซชันที่ได้จากการทคลองในสารละลายที่ไม่มีคลอไรค์



รูปที่ 2.12 ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม ที่ทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่มีและไม่มีคลอไรค์ไอออน

2.4.2 การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงคือรูปแบบของการกัดกร่อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สารละลายอิเล็กโทร ไลต์หรือของเหลว บางครั้งการกัดกร่อนในรูปแบบนี้อาจเรียกว่า การกัดกร่อน แบบแห้งหรือการเกิดสนิม (scaling) สนิมอาจเกิดจากเกลือหรือก๊าซร้อนที่สัมผัสอยู่กับพื้นผิวโลหะ และด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาหลายอย่างร่วมด้วย ได้แก่

ปฏิกิริยาออกซิเคชัน (oxidation) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากโลหะกับออกซิเจนให้ สารประกอบออกไซด์ที่ผิวของโลหะ ถูกเรียกว่า โลหะออกไซด์ บ่อยครั้งออกไซด์ที่เกิดขึ้นสามารถ ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนได้ แต่ผลเสียเมื่อเกิดออกไซด์ก็คือ ออกไซด์มักจะนำความร้อนได้ไม่ดี ทำให้ความสามารถในการนำความร้อนของพื้นผิวโลหะที่เกิดออกไซด์ลดลง ซึ่งอาจมีปัญหาต่อการ ระบายความร้อนออกจากระบบดังกล่าวได้ ปฏิกิริยาซัลฟีเดชัน (sulfidation) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกำมะถันหรือ ซัลเฟอร์ (sulfur) ทำให้เกิดการสะสมของชั้นเคลือบซัลไฟด์ ปกติชั้นเคลือบซัลไฟด์เป็นชั้นเคลือบที่ มีเสถียรภาพต่ำไม่เหมือนกับชั้นเคลือบออกไซด์ ดังนั้นจึงไม่มีส่วนช่วยในการต้านทานต่อการกัด กร่อน จากรูปที่ 2.13 เป็นภาพแสดงออกไซด์และซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะ ซึ่งซัลเฟอร์ มักแพร่เข้าไปตามแนวเกรนของโลหะเกิดเป็นซัลไฟด์ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดการกัดกร่อน เปราะ และแตกหักได้ง่ายภายหลังการนำไปใช้งาน (Caminha I., Zeng C., Paes M.P., Monteiro M.J., and Rizzo F., 2004)



รูปที่ 2.13 ลักษณะ โลหะที่เกิดออกไซด์ (ซ้าย) และซัลไฟด์ (บวา)

^{าย}าลัยเทคโนโลยีส์

ปฏิกิริยาในตรายเดชัน (nitridation) ปกติการทำในตรายค์ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ใน การเพิ่มความแข็ง (strengthening) ให้พื้นผิวของโลหะผสม แต่ในสภาวะที่เกิดการกัดกร่อนจาก ในโตรเจน พบว่าขณะที่ในโตรเจนแตกตัวเปลี่ยนเป็นในตรายค์หรือในโตรเจนไอออนแล้วเกิดการ ตกผลึกหรือเกิดการแพร่ซึมเข้าไปด้านในเนื้อโลหะด้วยสาเหตุที่ว่าในโตรเจนอะตอมมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นอะตอมของในโตรเจนจะเกิดการแพร่อีกครั้งและรวมตัวหรือ ตกผลึก (precipitation) ตามแนวขอบเกรนของโลหะ ซึ่งมักเกิดเป็นสารประกอบในตรายค์ที่มีความ แข็งสูง แต่เปราะ ส่งผลให้โลหะเกิดการแตกหักแบบเปราะได้ง่ายเมื่อถูกแรงกระทำ

ปฏิกิริยาคลอริเนชัน (chlorination) คลอไรค์ไอออน (Cl) เป็นสารประกอบที่ ค่อนข้างไว้ต่อการเข้าทำปฏิกิริยาการกัดกร่อน ซึ่งจะเข้าทำลายฟิล์มออกไซค์และพื้นผิวของโลหะ โดยตรง ทำให้กุณสมบัติเชิงกลของโลหะลดลง โดยเฉพาะโลหะที่มีฟิล์มพาสสีฟ การกัดกร่อนที่มี กลอไรด์ไอออนร่วมด้วยจะเกิดเฉพาะที่ และมีร่องรอยขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ในช่วงแรก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนเกิดความเสียหาย ดังรูปที่ 2.14 แสดงการกัดกร่อนของคลอไรด์ ไอออนเฉพาะที่ ส่งผลให้ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมถูกกัดกร่อนเสียหายแบบรูเข็ม



รูปที่ 2.14 แสดงการกัดกร่อนของคลอไรด์ไอออนที่ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304

ปฏิกิริยาคาร์บูไรเซชัน (carburization) เนื่องด้วยคาร์บอนเป็นธาตุที่สามารถเกิด การแพร่ได้ง่ายในสภาวะที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันของวัตถุสองสิ่งที่สัมผัสกันอยู่โดยเฉพาะใน สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ถ้าโลหะมีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่าสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดการแพร่ของ การ์บอนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปยังพื้นผิวของโลหะ ดังนั้นปริมาณคาร์บอนที่ผิวโลหะจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่า คาร์ไบด์ ซึ่งมีความแข็งมาก จึงมักทำให้เกิดการแตกแบบเปราะ ได้ง่าย

2.5 การวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิว

สำหรับการวิเคราะห์ชั้นเคลือบในการวิจัยครั้งนี้จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีความละเอียด ระดับสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ดังนั้นจึงได้เลือกใช้เทคนิค ได้แก่ เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (x-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM) เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโกปี (x-ray photoelectron spectroscopy, XPS) รามานสเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM)

2.5.1 เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (X-PEEM)

เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปีเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ชาตุ องก์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างผลึกของวัสดุรวมทั้งเทคนิคการดูภาพเหมือนจากกล้อง

้งุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งเทคนิค X-PEEM มีการใช้แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนตั้งแต่ช่วงรังสี อัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) ถึงรังสีเอกซ์ (x-ray) เป็นพลังงานในการกระตุ้นอิเล็กตรอนให้ หลุดออกจากผิวของวัสดุที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งมีระดับกวามลึกในการวิเคราะห์จากพื้นผิวของวัสดุ ้ลงไปประมาณ 20 นาโนเมตร นั่นถือได้ว่าเป็นระดับที่ก่อนข้างละเอียด จึงทำให้เป็นเทกนิกที่เหมาะ ้สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ชั้นเคลือบหรือฟิล์มบางเป็นอย่างยิ่ง โดยมี 2 เทคนิคหลักที่ถูกใช้ในการ ตรวจสอบการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของพื้นผิวของวัสด ได้แก่ เทคนิค micro x-ray absorption spectroscopy (u-XAS) ที่จะใช้หลักการวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ และอีกหนึ่งเทคนิค คือ micro x-ray photoemission spectroscopy (µ-XPS) ที่จะวิเคราะห์อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากการ กระตุ้นของรังสีเอ็กซ์ที่พื้นผิวของวัสคุซึ่งเกิดปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก โคยทั้งสองเทคนิคจะมี ประโยชน์อย่างมากสำหรับงานที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิว ชั้นเคลือบ และรอยต่อระหว่าง สองพื้นผิวในระดับนาโนเมตร นอกจากนี้ภาพถ่ายที่ได้จากเทคนิค PEEM จะแสดงความแตกต่าง ของพื้นผิวออกมา เนื่องจากค่าพลังงานแสงของธาตุแต่ละชนิดจะปลดปล่อยโฟโตอิเล็กตรอนที่ไม่ เท่ากัน ทำให้เห็นความแตกต่างของแต่ละธาตุบนพื้นผิววัสดุได้ นอกจากนี้ภาพถ่ายจากเทคนิค PEEM ยังสามารถที่เลือกบริเวณที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์หาธาตุได้ด้วยเทคนิคที่ได้กล่าวไว้ ้ข้างต้น ซึ่งผลที่ได้จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มพลังงานแสง (intensity) และค่าพลังงาน โฟตอน (photon energy) สำหรับเทคนิค แ-XAS และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ความเข้มพลังงานแสง (intensity) และค่าพลังงานยึคเหนี่ยวของอิเล็กตรอน (binding energy) ใน เทคนิค µ-XPS ดังนั้นการรวมภาพถ่ายจากเทคนิค PEEM กับเทคนิค µ-XAS และ µ-XPS ไว้ด้วยกัน ้จะเป็นประโยชน์เหมาะมากสำหรับใช้วิเคราะห์หาธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของพื้นผิวที่มีความ แตกต่างกันในระดับที่เล็กมาก ๆ เช่น พื้นผิวของชิ้นงานบริเวณที่เกิดการกัดกร่อนและบริเวณที่ไม่ เกิดการกัดกร่อน เป็นต้น

นอกจากการเทคนิคข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่ X-PEEM สามารถถ่ายภาพระดับนาโนเมตรได้ คือ เทคนิค low-energy electron microscopy (LEEM) ซึ่งจะ ใช้แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนในการสร้างภาพถ่าย เมื่ออิเล็กตรอนเกิดการเลี้ยวเบนหลังจากผ่าน โครงสร้างผลึกของวัสดุที่ต้องการวิเคราะห์ ภาพที่ได้จะเกิดจากการนำเอาอิเล็กตรอนที่เลี้ยวเบนมา ขยาย เรียกภาพที่ได้นั้นว่า dark-field imaging ซึ่งภาพที่ได้จะมีความสว่างของแต่ละบริเวณที่ แตกต่างกันสอดคล้องกับโดเมนของโครงสร้างของวัสดุนั้น ๆ โดย LEEM จะเป็นเทคนิคที่เหมาะ สำหรับใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางผลึกของวัสดุต่าง ๆ รวมทั้งพื้นผิวชั้นเคลือบ และ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสหรือโครงสร้างผลึกแบบเป็นลำดับขั้นตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

รูปที่ 2.15 แสดงหลักการทำงานของ PEEM เมื่อฉายแสงซินโครตรอนหรือ โฟตอนเข้าไปยังชิ้นงานจะทำให้อิเล็กตรอนที่พื้นผิวหลุดออกมาและถูกเร่งความเร็วไปยังเลนส์วัตถุ (objective lens) ก่อนที่จะถูกบังคับให้เกิดการเลี้ยวผ่านส่วนของแม่เหล็ก (sector magnet) ไปยัง เลนส์ฉาย (projector lenses) ซึ่งที่บริเวณนี้ลำของอิเล็กตรอนจะถูกรวม (focus) ก่อนที่จะผ่านไปยัง ส่วนเครื่องวิเคราะห์พลังงานอิเล็กตรอนและสุดท้ายลำของอิเล็กตรอนทั้งหมดที่ผ่านมาจะถูกแสดง เป็นภาพที่หน้าจอเรืองแสงหรือหน้าจอรับภาพ (phosphor screen)



รูปที่ 2.15 แสดงแผนภาพการทำงานของ X-PEEM (Gunther, S., Kaulich, B., Gregoratti, Kiskinova, M., 2002)

2.5.2 เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโกปีหรือสเปกโตรสโกปีของอนุภาค
 อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (XPS)
 สำหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชันคือเทคนิคที่วิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของโฟโต

อิเล็กตรอนของธาตุ เช่น องก์ประกอบทางเกมี พลังงาน และทิสทางการเกลื่อนที่ของโฟโต อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวัสดุหลังการเกิดอันตรกิริยากับโฟตอนหรือแสงที่ฉายเข้าไป เรียกการ เกิดลักษณะนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ซึ่งก็คือการที่แหล่งกำเนิดของแสงที่ฉายหรือ โฟตอนมีอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนในวัสดุที่ถูกฉายแสงและถ้าโฟตอนมีพลังงานมากพอและคงที่ ก็สามารถชน (knock) หรือปลดปล่อยอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากวัสดุที่ต้องการวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ ทำให้สามารถบ่งบอกถึงชนิดของธาตุที่เป็นองก์ประกอบของตัวอย่างได้ เนื่องจากพลังงานยึด เหนี่ยวของอิเล็กตรอน (electron binding energy) ของธาตุแต่ละชนิดนั้นก็มีก่าเฉพาะตัวที่ไม่เท่ากัน กลไกพื้นฐานของ XPS ดังรูปที่ 2.16 เมื่อพลังงานแสงหรือโฟตอน (photon energy) ในช่วง 40-160 และ 220-1040 อิเล็กตรอน โวลด์ ถูกใช้เพื่อกระตุ้นสภาวะอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมใต้พื้นผิวของ วัสดุให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากพื้นผิว ที่ระดับความลึกประมาณ 10 นาโนเมตร พลังงานของ อิเล็กตรอนจะถูกวิเคราะห์ด้วย hemispherical electron energy analyzer (HSA) ก่อนที่ความเข้ม ระดับพลังงาน (intensity) จะถูกบันทึกโดยเครื่องตรวจจับ (electron detector) ซึ่งผลที่ได้จะแสดง เป็นกราฟกวามสัมพันธ์ระหว่างกวามเข้มระดับพลังงานและพลังงานอีดเงาตรกิจ



รูปที่ 2.16 แผนภาพการทำงานของ XPS

2.5.3 รามานสเปกโตรสโกปี

รามานสเปกโตรสโกปี เป็นเทกนิกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถูกใช้ใน ้การหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ โครงสร้างและคุณสมบัติของส่วนประกอบพื้นฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงของ โพลาไรเซชันโดยการฉายรังสีให้ชิ้นงานด้วยลำแสงของเลเซอร์ (laser beam) ที่หนาแน่นของก๊าซ อาร์กอนหรือฮีเลียม ส่งผลให้ชิ้นงานเปล่งรังสีออกมาด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ Stokes scattering Anti-stokes scattering และ Rayleigh scattering ซึ่งถูกบังคับผ่านเลนส์และมีตัววิเคราะห์ ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็น Stokes และ Anti-stokes scattering (Raman inelastic) สุดท้ายจะแปลงสัญญาณออกมาในรูปแบบสเปกตรัมแสดงบนจอแสดงภาพ ดังรูปที่ 2.17 การ ทคสอบด้วยรามานสเปกโตรสโกปีอาศัยการชนกันของอะตอมที่อาจเป็นกรณีของโปรตอนได้รับ พลังงานจากโมเลกุลหรือสูญเสียพลังงานให้กับโมเลกุล กระบวนการนี้เรียกว่า การกระเจิงแบบไม่ ซึ่งการสั่นสะเทือนจากการชนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น (inelastic scattering) ์ โพลาไรเซชันเกิดขึ้นภายในโมเลกล โดยโพลาไรเซชันของโมเลกุลที่ถูกเปลี่ยนไประหว่างการ ้สั้นสะเทือนของโมเลกลจะส่งผลต่อรามานสเปกตรัมด้วย ดังนั้นโมเลกุลที่ทำให้แสงโมโน โครมาติก (monochromatic) หรือเลเซอร์ที่ฉายเข้ามาเกิดการกระเจิงแล้วทำให้เกิดรามานสเปคตรัม ้ได้ โมเลกลนั้นจะต้องเกิดการสั่นและทำให้โพลาไรเซชันของสารเปลี่ยนไปด้วย การประยกต์ที่ถก นำมาใช้ในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์วัสดุได้หลากหลายมากขึ้น เช่น เส้นใย ยา ลิปสติก และ สารละลาย โดยตัวอย่างที่สามารถทดสอบเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ การวิเคราะห์ไม่ ้งำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างและสารเคมีที่ยุ่งยาก สิ่งสำคัญที่สุด คือ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ นั้นสามารถใช้ในปริมาณเล็กน้อยขนาคพิโคกรัมหรือเฟมโตลิตรได้ ตัวอย่างไม่ถูกทำลายจากการ ้วิเคราะห์ ซึ่งเส้นสเปกตรัมรามานแสดงสัญญาณการสั่นที่จำเพาะของตัวอย่างที่ถูกวัดค่าพลังงาน ้ของการกระเจิงแสง ด้วยลักษณะเฉพาะนี้จึงเป็นประโยชน์มากในการจำแนกสารที่ไม่ทราบค่า โดย รามานสเปกโตรสโกปีมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบได้ ซึ่ง เป็นคุณสมบัติทั่วไปของชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร และข้อมูลยังถูกรบกวนน้อย ซึ่ง เทกนิกส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรมักถูกรบกวนได้มาก ทำให้รามานสเปกโตรสโกปีมักถูกใช้เป็นขั้นแรกเพื่อตรวจสอบยืนยันชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติ ้คล้ายเพชร รูปที่ 2.18 แสดงรามานสเปกตรัมของชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร ซึ่งพบ พิค (peak) เกิดขึ้นสองตำแหน่ง โดยที่ตำแหน่งแรก คือ ตำแหน่งแกร ไฟต์ที่มีการเรียงตัวอย่าง ไม่เป็น ระเบียบ (disordered graphite) ซึ่งถูกเรียกว่า ดีพีค (D-peak) และตำแหน่งที่สอง คือ ตำแหน่งของ แกร ไฟต์ ซึ่งถูกเรียกว่า จีพีค (G-peak) จากตำแหน่งทั้งสองแสดงให้เห็นว่าชั้นเคลือบมีโครงสร้าง

เป็นการ์บอนอสัณฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงกุณลักษณะของชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรที่เกิด จากโกรงสร้างอสัณฐานระหว่างเพชรกับแกรไฟต์



รูปที่ 2.17 แผนภาพระบบการทำงานของรามานสเปกโตรสโกปี



(Sui, J.H., and Cai, W., 2007)

2.5.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ สามารถขยายภาพสูงสุดประมาณ 0.2 นาโนเมตร (กำลังขยายตั้งแต่ 20 ถึง 30,000X) สามารถ ถ่ายภาพแนวลึกได้มากกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบแสงถึง 300 เท่า โดยขึ้นงานที่จะศึกษาไม่ จำเป็นต้องเตรียมให้มีขนาดบางเท่ากับเมื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ภาพที่ได้จาก SEM มีลักษณะเป็น 3 มิติ ดังนั้นจึงถูกประยุกต์ใช้กับวิทยาการแขนงต่าง ๆ ใน การศึกษาสัณฐานและรายละเอียดลักษณะของพื้นผิวของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ เช่น ลักษณะ พื้นผิวของโลหะ เนื้อเยื่อ เซลล์ รวมทั้งลักษณะพื้นผิวของโครงสร้างผลึกของชั้นเคลือบและ ภาคตัดขวางเป็นต้น

ส่วนประกอบพื้นฐานและหลักการทำงานของ SEM แสดงคังรูปที่ 2.19 แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนหรือปืนอิเล็กตรอน (electron gun) อยู่ส่วนบนสุด เป็นส่วนที่ต่อเข้ากับ สายไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าแรงคันสูงระหว่าง 0 ถึง 30 กิโลโวลต์ (บางเครื่องอาจทำได้สูงถึง 50 กิโลโวลต์) ด้วยศักย์ไฟฟ้าที่เพียงพอจะทำให้ลวดโลหะ (tungsten filament) ที่อยู่ภายในมีความร้อน ้สูงและปลคปล่อยอิเล็กตรอนออกมาในสภาวะที่เป็นสุญญากาศภายในคอลัมน์ อิเล็กตรอนที่มีประจุ ลบทั้งหมดจะถูกดึงด้วยขั้วบวก (anode plate) และถูกบังคับด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic lens) ด้วยกัน 2 ชุด หรือมากกว่า ซึ่งถ้าอิเล็กตรอนจะถูกบังคับให้มีลักษณะเป็น รูปกรวยที่สมมาตรโดยชุดของแอพเพอร์เจอร์ (aperture) หรือช่องรับส่งสัญญาณซึ่งมีขนาคต่าง ๆ กันตามลักษณะการใช้งาน ส่วนของเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าชุดแรก เรียกว่า เลนส์คอนเคนเซอร์ (condenser lens) ถือว่ามีความสำคัญเพราะทำหน้าที่บังคับลำอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดให้เป็นลำ ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กลงก่อนเข้ามายังเลนส์วัตถุ (objective lens) ซึ่งเป็นเลนส์ชุดสุดท้าย ที่มี แอพเพอร์เจอร์วัตถุ (objective aperture) ทำหน้าที่รวมถำอิเล็กตรอนให้เป็นรูปกรวยขนาดเล็กที่มี ้ความสมมาตรมากที่สุด โดยสามารถกำหนดขนาดของอิเล็กตรอนและปริมาณของอิเล็กตรอนให้ ตกกระทบบนพื้นผิวของชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อให้ภาพมีความลึก ซึ่งมีสแกนคอยล์ (scan coil) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนลำอิเล็กตรอนให้กราคไปบนผิวชิ้นงานภายในกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยม เล็ก ๆ โดยพื้นที่ผิวชิ้นงานที่ถูกยิงด้วยลำอิเล็กตรอนนี้ จะเกิดเป็นสัญญาณ (signal) ต่าง ๆ หลาย ชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีเครื่องตรวจจับสัญญาณ (detector) ทำหน้าที่รับสัญญาณต่าง ๆ ก่อน แปลงให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปประมวลผลเป็นภาพบนหน้าจอ ตัวอย่างของ ้สัญญาณที่เกิดขึ้น ได้แก่

อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron, SE) ให้ลักษณะของพื้นผิวชิ้นงาน และถือ ว่าเป็นสัญญาณที่ถูกนำมาใช้สร้างภาพมากที่สุด เรียกภาพที่ได้ว่า ภาพอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron image, SEI)

อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (backscattered electron, BSE) ให้ลักษณะที่เป็นส่วนผสม ทางเคมีของพื้นผิวชิ้นงาน และแสดงให้เห็นถึงความตื้นลึกของภาพ

นอกจากนี้ SEM ยังสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น เช่น energy dispersive spectrometry (EDS) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน





2.6 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการวิจัยนี้ พบว่าวัสดุต่าง ๆ ที่ผ่านการเคลือบด้วย ชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรมีคุณสมบัติการต้านการกัดกร่อนและคุณสมบัติเชิงกล ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC ผิวยังขึ้นกับ สภาวะแวคล้อมการใช้งานอีกด้วย

Fung, M.K. และคณะได้ศึกษาคุณสมบัติพื้นผิวของ hard disk ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC ซึ่งได้ชั้นเคลือบคาร์บอนอสัณฐาน (*a-C: H*) ที่มีความหนา 10 นาโนเมตร เมื่อ ทดสอบค่าความหยาบเฉลี่ย พบว่าพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ -150 โวลต์ จะมีค่า ความหยาบลดลงจากเดิม 3.5 A.U. เหลือเพียง 2.3 A.U. นอกจากนี้เมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสจาก -50 โวลต์ เป็น -120 โวลต์ พบว่าทำให้ปริมาณไฮโดรเจนในชั้นเคลือบลดลง (dehydrogenation) ซึ่งมีผลทำให้ค่าความแข็งชั้นเคลือบสูงขึ้นถึง 22 GPa (Fung, M.K., Lai, K.H., Lai, H.L., and Chan, C.Y., 2000)

Lattemann, M. และคณะได้ศึกษาผลของพลังงานไอออนที่ใช้ในกระบวนการเคลือบผิวต่อ การยึดเกาะของชั้นเคลือบด้วยเทคนิค HIPIMS พบว่าที่ระดับพลังงานของไอออนสูง (U_b) เท่ากับ 1200 โวลต์ ทำให้ชั้นเคลือบออกไซด์ถูกกำจัดออกไปหรือเกิดรีสปัตเตอร์ริง (re-sputtering) ก่อนทำ ให้เกิดการฝังตัวของไอออนที่พื้นผิวที่จะเกิดการโตของชั้นเคลือบ ทำให้การเกาะตัวของชั้นเคลือบ มีความหนาแน่นมากขึ้น ที่ระดับพลังงานของไอออนเท่ากับ 700 โวลต์ พบว่าเกิดการวิ่งเข้าชนของ ไอออนโลหะอย่างหนาแน่น นำไปสู่การเกิดชั้นเคลือบที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนก่อนที่จะเกิด การโตของชั้นเคลือบ ส่วนที่ระดับพลังงานต่ำเท่ากับ 400 โวลต์ พบว่าเกิดการขยายของชั้นเคลือบ ในลักษณะคอลัมนาร์ (columnar) มากกว่าการทำความสะอาดพื้นผิว ทำให้ได้คุณสมบัติที่ไม่ดีของ ชั้นเคลือบ (Lattemann, M., Ehiasarian, A.P., Bohlmark, J., 2006)

Sui, J. และ Cai, W. ได้ศึกษาสมบัติทางกลและพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC ที่เคลือบบนซิลิกอนและ โลหะผสมนิเกิล-ไททาเนียมด้วยกระบวนการพลาสมาอิมเมอร์ชันไอออน (plasma immersion ion processing, PIIP) ผลการศึกษาในส่วนของชั้นเคลือบ DLC ที่เคลือบบน โลหะผสมนิกเกิล-ไททาเนียม พบว่าความแข็งของชั้นเคลือบลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความกว้าง ของพัลส์ (pulse width) ซึ่งความแข็งของชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบผิว นอกจากนี้ยังพบว่าโลหะผสมนิกเกิล-ไททาเนียมที่ผ่านการเคลือบผิวมีค่า สมประสิทธิ์แรงเสียดทานผิวที่ต่ำกว่าโลหะผสมนิกเกิล-ไททาเนียมที่ไม่ได้เคลือบผิว และจาก เส้น โค้งโพราไรเซชันพบว่าโลหะผสมนิกเกิลที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC มี กวามต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าโลหะผสมนิกเกิล-ไททาเนียมที่ไม่ได้เคลือบผิว (Sui, J., and Cai, W., 2006) Huang, G.F. และคณะใด้ศึกษาสมบัติทางกลและพฤติกรรมความด้านทานการ กัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 2Cr13 เหล็กกล้าผสมต่ำเกรด 40Cr และเหล็กกล้าผสมต่ำเกรด 20Cr ซึ่งได้ผ่านการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC โดยกระบวนการ ion-beam assisted deposition จากผลการศึกษาพบว่าชั้นเคลือบ DLCไม่เพียงแต่ลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและลดการสึกหรอ ที่ผิว แต่ยังสามารถปรับปรุงความด้านทานการกัดกร่อนของเหล็กได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัดกร่อนเฉพาะที่ (localized corrosion) เช่น การกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) สาเหตุที่ เป็นเช่นนั้น เนื่องด้วยความเลื่อยต่อทำปฏิกิริยาทางเกมี (chemical inertness) ทำให้ชั้นเคลือบ DLC ทำหน้าที่ป้องกันเนื้อเหล็กไม่ให้สัมผัสกับสารละลายกัดกร่อน ดังนั้นจึงทำให้อัตราการกัดกร่อน ลดลง (G.F. Huang, Lingping, Z., 2003)

Marciano, F.R. และคณะได้ศึกษาพฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนชั้นเคลือบ DLC ระดับนาโนเมตร (nano crystalline-diamond) ที่เคลือบบนเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด AISI 304 ด้วย เทคนิค plasma-enhanced chemical vapor ซึ่งพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC ได้ถูก ศึกษาโดยใช้เทคนิคไฟฟ้าเคมี ผลจากการศึกษาพบว่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{corr}) มีค่ามากขึ้นและความหนาแน่นการกัดกร่อน (corrosion current density, i_{corr}) มีค่าลดลง เมื่อ เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบผิว นอกจากนี้ผลจากเส้น โด้งโพลาไรเซชันยังบ่งบอก ได้ว่าความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการเคลือบผิวสามารถถูกปรับปรุง ได้ด้วยชั้นเคลือบ DLC (Marciano, F.R., Almeida, E.C., 2010)

จากผลที่รายงานในวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พบว่าวัสดุต่าง ๆ ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC สามารถเพิ่มความแข็ง ปรับปรุงพฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อน และลด สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวได้ โดยการวิจัยส่วนมากได้มุ่งเน้นที่การศึกษาความหยาบหลัง การเคลือบชั้นเคลือบ การควบคุมศักย์ไฟฟ้าในการเคลือบ ตลอดจนการควบคุมปริมาณไฮโดรเจน ในชั้นเคลือบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวยังไม่ได้ศึกษาผลของโครงสร้างของชั้นเคลือบ (สัดส่วนระหว่างเพชรกับแกรไฟต์) ต่อพฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการเคลือบผิวให้ได้ชั้นเคลือบ DLC ที่มีโครงสร้างที่ เหมาะสมต่อการใช้งานในสภาวะที่มีการกัดกร่อนที่ก่าความเป็นกรด-ด่างแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็น พื้นฐานที่สำคัญต่อไปในอนากต

บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในการศึกษาพฤติกรรมการต้านทาน การกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร ในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ กวามเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี

3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 เนื่องจากเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งมีส่วนผสมทางเคมีดัง ตารางที่ 3.1 โดยขึ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ได้ถูกตัดให้มีขนาด กวามกว้าง ยาว และหนา เท่ากับ 10 10 และ 2.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 3.1 สาเหตุที่ต้อง ตัดชิ้นงานให้มีขนาดดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสำหรับทดสอบการกัดกร่อน รวมถึง เพื่อให้สามารถนำชิ้นงานเข้าสู่ระบบ X-PEEM และ XPS ได้ โดยชิ้นงานทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้จำนวน 54 ชิ้น การจำแนกเงื่อนไขและจำนวนชิ้นงานในการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 3.2

สีบาวาม	ส่วนผสมทางเกมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)						
ายมาน	С	Cr	V	Мо	Si	Mn	Fe
AISI H13	0.40	5.30	1.00	1.40	1.00	1.40	Bal.

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13



รูปที่ 3.1 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ก่อนตัด (ซ้าย) และหลังตัด (ขวา) ขนาด กว้าง ยาว และหนา เท่ากับ 10 10 และ 2.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ตารางที่ 3.2 จำนวนชิ้นงานและเงื่อนไขที่ใช้ในการวิจัย

วัสดุพื้น	ชั้นเคลือบ	ศักย์ไฟฟ้าไบแอส (โวลต์)	จำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)		
AISI H13 DLC coate	Uncoated		3	3	3
	5, 14	-100	3	3	3
	TISNEN	-200	3	3	3
	DLC coated	-600	3	3	3
	-	-800	3	3	3
		-1000	3	3	3

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ในสภาพที่ผ่านการขึ้นรูปประกอบด้วยโครงสร้างพื้นที่เป็นเฟอร์ไรท์และมีสารประกอบคาร์ไบด์ กระจายอยู่ภายใน ปกติเหล็กกล้าเครื่องมือก่อนใช้งานต้องทำการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลด้วยการ อบชุบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริง ภายหลังจากนำชิ้นงานไปทำการอบชุบด้วยความร้อนที่ อุณหภูมิ 1025 องสาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เรียบร้อยนำออกจากเตาอบแล้วจุ่มแช่ลงในน้ำมัน ทันทีจนชิ้นงานเย็นดัว พบว่าโครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยมาร์เทนไซด์ ออสเทนในท์เหลือค้าง และสารประกอบการ์ไบด์ขนาดเล็กกระจายอยู่ในเนื้อพื้น ด้วยลักษณะโครงสร้างที่เป็นมาร์เทนไซด์ และการ์ไบด์ขนาดเล็กทำให้คุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าเครื่องมือในด้านความแข็งและความ เหนียวสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการนำไปสู่กระบวนการเคลือบ สำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการ อบชุบทางความร้อนตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลการทดลองใกล้เคียงกับการใช้งาน จริง ซึ่งผลทางด้านโครงสร้างจุลภาคที่ได้มีความสอดกล้องกับก่าความแข็ง ดังตารางที่ 3.3 (ใน หัวข้อ 3.2.1) สำหรับโครงสร้างจุลภาคภายหลังการขึ้นรูปสภาพปกติแสดงดังรูปที่ 3.2 และภายหลัง กระบวนการอบชุบทางความร้อนดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.2 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 หลังการขึ้นรูป ในสภาพปกติ (ก่อนอบชุบทางความร้อน)



รูปที่ 3.3 โครางสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 หลังผ่านการ อบชุบทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1025 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของการทดลอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้

ก) อุปกรณ์สำหรับการเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ

งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องตัดโลหะแบบ WIRECUT รุ่น CHARMILLES
 TECHNOLOGIES ROBOFIL 190 พร้อมด้วยลวดตัด (wire cut) ทำด้วยโลหะทองเหลืองขนาดเส้น
 ผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร สำหรับตัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI
 H13 ให้ได้ขนาด 10×10×2.5 มิลลิเมตร แสดงเครื่องตัดดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 เครื่องตัดโลหะประเภท EDW WIRECUT

 การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานใช้เครื่องขัดพื้นผิวชิ้นงาน 2 หัว แบบหยาบชนิด จานหมุนยี่ห้อ Metkon รุ่น FOLCIPAL 2V สำหรับขัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูป ร้อน AISI H13 โดยใช้กระดาษทรายเป็นตัวขัดระดับความหยาบผิวให้ได้ตามต้องการ ระหว่างขัดมี ระบบน้ำฉีดเพื่อหล่อเย็นและกำจัดเศษ โลหะที่ถูกขัดออก แสดงลักษณะของเครื่องขัดดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 เกรื่องขัดพื้นผิวชิ้นงาน 2 หัว แบบหยาบชนิดจานหมุน

เครื่องขัดพื้นผิวชิ้นงาน 2 หัว แบบละเอียดชนิดจานหมุนยี่ห้อ BUHLER
 รุ่น Phoenix 2000 ใช้สำหรับขัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ให้
 พื้นผิวของชิ้นงานมีความเรียบสม่ำเสมอมากขึ้น โดยใช้แผ่นผ้าสักหลาดควบคู่กับผงขัดอะลูมินา
 ขนาด 0.50 และ 0.05 ไมโครเมตร ตามลำดับ ระหว่างขัดมีระบบน้ำฉีดเพื่อหล่อเย็นชิ้นงานและเพื่อ
 กำจัดเศษอนุภาคโลหะออกจากบริเวณผิวหน้าชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เกรื่องขัดพื้นผิวชิ้นงานพื้นผิว 2 หัว แบบละเอียดชนิดจานหมุน

เตาสำหรับอบชุบชิ้นงานยี่ห้อ LINDBERG/BLUE-M รุ่น BF51828C/
 51828 BOX ใช้ในการอบชุบชิ้นงานด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกลให้กับชิ้นงานก่อนทำการ
 เคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร สามารถให้อุณหภูมิสูงสุด 1200 องศาเซลเซียส
 ภายในบุผนังด้วยอิฐทนไฟที่ทำจากอะลูมินาซึ่งสามารถด้านทานอุณหภูมิได้สูง เหมาะต่อการ
 นำไปใช้ในการใช้ในการวิจัย แสดงดังรูปที่ 3.7





รูปที่ 3.7 เตาอบชุบทางความร้อน

 เครื่องทำความสะอาดชิ้นงานด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์ เป็นเครื่องที่ สามารถทำความสะอาดคราบน้ำมันหรือคราบสกปรกต่าง ๆ บนผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่สามารถ เข้าถึงได้ โดยอาศัยตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือสารละลายที่เหมาะสม เช่น น้ำ เอทธานอล หรือ อะซิโตน เป็นต้น นอกจากนี้ตัวเครื่องได้มีการติดตั้งตัวทำความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาการทำละลาย คราบสกปรกที่เกาะแน่นอยู่บนชิ้นงานให้หลุดออกไปได้ง่ายขึ้น แสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 เครื่องล้างชิ้นงานแบบอัลตราโซนิกส์

- เครื่องกรองไอออนที่อยู่ในน้ำ (deionization system) เป็นเครื่องที่ใช้กรอง ไอออนที่ละลายอยู่ในน้ำ เนื่องจากถ้ามีไอออนละลายอยู่ในน้ำที่นำมาใช้ทำความสะอาคชิ้นงาน อาจทำให้ผิวชิ้นงานมีประจุตกค้างซึ่งมีปัญหาต่อการเคลือบชั้นเคลือบ ด้วยเหตุนี้พื้นผิวของชิ้นงาน ก่อนเคลือบจำเป็นต้องมีความสะอาคมากที่สุด เพื่อลดปัญหาการเคลือบชั้นเคลือบไม่ติด จึงจำเป็นที่ จะต้องใช้น้ำที่ไม่มีการเจือปนของประจุไอออนต่าง ๆ แสดงเครื่องกรองไอออนดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 เครื่องกรองไอออนในน้ำ

- ตู้ดูดความชื้นแบบแห้งและแบบใช้สารเกมี (desiccators cabinet) ยี่ห้อ WEIFO รุ่น Dry และ NORTHMAN รุ่น D36 ซึ่งตู้นี้มีขนาดความจุ 68 และ 36 ลิตร ตามลำดับ โดย สามารถใช้เก็บชิ้นงานโลหะเพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศโดยตรงหรือสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศ ลดปัญหาชิ้นงานเกิดสนิมระหว่างการเก็บชิ้นงานรอทดสอบได้ โดยแบบแห้งจะมีการปรับอุณหภูมิ ภายในตู้ไว้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส และแบบใช้สารเกมีใช้เม็ดเจลซิลิกาใส่ไว้ในถาดด้านล้าง (cabinet) เพื่อดูดความชื้นในสภาพอุณหภูมิปกติและในตู้นี้มีการตั้งก่าความดันเท่ากับ 10⁻³ มิลลิบาร์ โดยใช้ ไฮโกรมิเตอร์ (hygrometer) เป็นตัววัด ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 ตู้ดูดความชื้นแบบแห้ง (บน) และแบบใช้สารเคมี (ล่าง)

กระคาษทรายที่ใช้กับเครื่องขัคหยาบในการปรับค่าความหยาบของพื้นผิว

ประกอบด้วยเบอร์หยาบถึงละเอียด ดังนี้ 180, 200, 320, 400, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 กระคาษทรายที่ใช้สำหรับเครื่องขัดแบบหยาบ

ข) อุปกรณ์สำหรับการเคลือบชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร

 เกรื่องเคลือบผิวด้วยเทคนิคฟิลเตอร์กาโชดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ
 เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิจัยกรั้งนี้สำหรับสร้างชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร โดยการ
 เกลือบจะเกิดขึ้นในระบบสุญญากาศ ซึ่งสามารถบรรจุชิ้นงานในการเกลือบแต่ละครั้งได้ 4 ถึง 5 ชิ้น
 สำหรับเครื่องนี้ตั้งอยู่ในระบบลำเลียงแสง BL3.2b: PEEM ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 (องก์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทกโนโลยี จ.นครราชสีมา ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 เครื่องเคลือบ (ชั้นเคลือบ DLC) ฟิลเตอร์ คาโชดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ

ค) อุปกรณ์สำหรับการทดสอบการกัดกร่อน

 เครื่องโพเทนซิโอสแตท (potentiostat analyzer) รุ่น PGSTAT 302H ของ บริษัท ECO CHEMIE B.V. KANALWEG 29-G 3526 KM UTRECHT THE NETHERLANDS แสดงดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 เครื่องโพเทนซิโอสแตทสำหรับทดสอบการกัดกร่อน

อิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนประกอบด้วยอิเล็กโทรด

อ้างอิง (reference electrode) คือ ซิลเวอร์ต่อซิลเวอร์คลอไรค์ (Ag/AgCl, 3M KCl) และอิเล็กโทรด กระแส (counter electrode) คือ แท่งแกรไฟต์ เหตุผลที่ใช้แท่งแกรไฟต์เนื่องจากมีราคาถูกกว่า แพลทินัม นอกจากนี้ในส่วนการนำไฟฟ้าพบว่าแกรไฟต์เป็นวัสดุที่ย่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ดีพอ ๆ กับแพลทินัม ดังนั้นจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลทั้งเรื่องราคาและคุณภาพที่จะเลือกใช้ แกรไฟต์ ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 อิเล็กโทรดอ้างอิง (ซ้าย) และแท่งแกรไฟต์ "อิเล็กโทรดกระแส" (ขวา)

- เครื่องวัดค่าพีเอช (pH) ของสารละลาย รุ่น 827 pH Lab บริษัท Metrohm

แสคงคังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 ชุดเครื่องมือวัดก่าพีเอชของสารละลาย

 อุปกรณ์สำหรับเตรียมสารละลายทดสอบการกัดกร่อน ได้แก่ บีกเกอร์ ขวดลูกชมพู่ ขวดปริมาตร แก้วกวนสาร หลอดหยด และกรวย ซึ่งได้ถูกใช้สำหรับเตรียมสารละลาย ไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 ชุดอุปกรณ์ในการเตรียมและเก็บสารละลายเคมี

 ง) อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบโครงสร้าง ส่วนผสมทางเคมี และลักษณะ พื้นผิวของชั้นเคลือบ DLC

- รามานสเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy) ใช้สำหรับตรวจสอบความ เป็นชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร ส่วนเอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี (x-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM) และเครื่องสเปกโตรสโกปีของอนุภาค อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (x-ray photoelectron spectroscopy, XPS) เป็นเครื่องมือที่ มีการใช้แสงซินโครตรอนเป็นแหล่งพลังงานในการวิเคราะห์สัดส่วนโครงสร้างและส่วนผสมทาง เกมีของชั้นเคลือบในการวิจัยครั้งนี้ โดยพลังงานที่ได้จากแสงซินโครตรอนถือว่าเป็นพลังงาน สะอาด มีความเข้มพลังงานสูง และสามารถเลือกย่านความถี่ในการใช้งานให้เหมาะสมกับวัสดุได้ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงที่มีประโยชน์มากในการวิจัยที่ต้องการความแม่นยำของข้อมูล โดย ตัวเครื่องแสดงดังรูปที่ 3.17 ซึ่งตั้งอยู่ในระบบลำเลียงแสงที่ BL3.2a: PES และ BL3.2b: PEEM ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.นครราชสีมา



รูปที่ 3.17 เครื่อง XPS (ซ้าย) และ X-PEEM (ขวา)

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope, OM) OLYMPUS รุ่น
 BX41M-LED พร้อมโปรแกรมสำหรับถ่ายภาพ ถูกใช้สำหรับถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน
 เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อน/หลังผ่านกระบวนการอบชุบทางความร้อน แสดงดังรูปที่ 3.18 ซึ่ง
 ตั้งอยู่ในอาการเครื่องมือ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รูปที่ 3.18 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5410 ใช้สำหรับศึกษาลักษณะพื้นผิวของเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบ เพื่อดูร่องรอยการกัดกร่อน ซึ่งมี การใช้เทคนิค EDS ร่วมในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิว เครื่องนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) แสดงดังรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

3.1.3 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

สารละลายที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน คือ สารละลายโซเดียมคลอไรด์
 ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีการปรับก่าพีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10 ตามลำดับ

 สารละลายที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์
 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้มีสภาวะความเป็นกรด คือ สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ เข้มข้น 1 โมลาร์

สารละลายที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์
 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้มีสภาวะความเป็นกลางและค่าง คือ สารละลายโซเดียมไฮครอกไซด์
 ความเข้มข้น 1.25 โมลาร์

 น้ำกลั่น สารละลายเอทธานอล และอะซิโตนสำหรับเตรียมสารละลายและ กำจัดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นระหว่างทดสอบการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังใช้สำหรับทำความสะอาด ชิ้นงานก่อนการเคลือบผิวด้วย

- เม็คเจลซิลิกาใช้สำหรับดูดความชื่นในตู้ดูดความชื่นแบบใช้สารเคมี

 แท่งแกร ไฟต์ใช้สำหรับเป็นอิเล็ก โทรดกระแสและ ใช้สำหรับเป็นแหล่งกำเนิด ของการ์บอนในการเกลือบชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร มีความบริสุทธิ์ 99.99
 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.25 มิลลิเมตร

 ก๊าซ ใน ไตรเจนใช้สำหรับเป่าชิ้นงานให้แห้งหลังจากล้างทำความสะอาครวมทั้ง ใช้ในระบบเคลือบเพื่อปรับความดันระหว่างภายในห้องเคลือบกับความดันบรรยากาศให้เท่ากัน ก่อนนำชิ้นงานออก

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

3.2

สำหรับขั้นตอนและวิธีคำเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการเตรียมชิ้นงานสำหรับการ เคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร หลังจากเคลือบชั้นเคลือบเรียบร้อยแล้ว นำไป ตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ด้วยรามานสเปกโตรสโกปี X-PEEM และ XPS ตามด้วยการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานและการตรวจวิเคราะห์พื้นผิวการกัดกร่อนอีกครั้งด้วย เทคนิค X-PEEM ซึ่งแผนภาพขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยได้ถูกแสดงไว้ดังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 แผนภาพแสดงขั้นตอนและการดำเนินการวิจัย
3.2.1 การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ

การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบเริ่มด้วยการนำเหล็กกล้าเกรื่องมือสำหรับงาน ขึ้นรูปร้อน AISI H13 มาตัดให้ได้ขนาดความกว้าง 10 มิลลิเมตร ความยาว 10 มิลลิเมตร และความ หนา 2.5 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ตัดขนาดแล้วไปเข้าสู่กระบวนการอบชุบทางความ ร้อน ซึ่งได้อบชิ้นงานไปที่อุณหภูมิ 650 และ 1025 องศาเซลเซียส เพื่อให้โครงสร้างทั้งชิ้นงานเป็น โครงสร้างออสเทนไนท์ เป็นเวลา 5 และ 20 นาที ตามลำดับ หลังจากครบระยะเวลานำชิ้นงานออก จากเตาอบแล้วจุ่มลงกวนในน้ำมันจนกระทั่งชิ้นงานทุกชิ้นมีอุณหภูมิเท่ากับน้ำมัน ซึ่งหลังจากผ่าน การอบชุบแล้วโครงสร้างจากเดิมที่เป็นคาร์ไบด์กระจายตัวในโครงสร้างพื้นที่เป็นเฟอร์ไรท์จะ กลายเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ที่มีคาร์ไบด์งนาดเล็กกระจายตัวอยู่ภายใน นอกจากนี้เพื่อเพิ่ม ความเหนียวของโครงสร้างชิ้นงานจึงนำไปทำการอบคลายเครียด (tempering) โดยขั้นตอน กระบวนการอบชุบแสดงดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 แผนภาพขั้นตอนการอบชุบด้วยความร้อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13

หลังจากทำการอบชุบด้วยความร้อนเสร็จเรียบร้อย นำชิ้นงานไปขัดผิวด้วย กระดาษทรายจากเบอร์หยาบถึงละเอียด (180 200 320 400 และ 600) แล้วจึงนำไปวัดค่าความแข็ง ด้วยเกรื่องวัดความแข็งแบบร็อกเวลสเกลซี (Rockwell C scale) ดังรูปที่ 3.22 ซึ่งจากการวัดก่าความ แข็งก่อนและหลังอบชุบแสดงก่าความแข็ง ดังตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.22 เครื่องวัดค่าความแข็งแบบ Rockwell C scale

A 101 1112	ค่าความแขึ่ง (HRC)					
AISI H13	จุคที่ 1	จุคที่ 2	จุคที่ 3	ค่าเฉลี่ย		
ก่อนอบชุบ	14.42	14.71	14.91	14.68		
หลังอบชุบ	48.54	52.76	51.87	51.06		

ตารางที่ 3.3 ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ก่อนและหลัง การอบชบทางความร้อน

ก่อนและหลังจากวัดความแข็งชิ้นงาน นำชิ้นงานบางส่วนไปขัดเตรียมพื้นผิว ด้วยกระดาษทรายโดยใช้เครื่องขัดแบบหยาบ ตามด้วยขัดแบบละเอียดด้วยผ้าสักหลากและผงอะลูมิ นาก่อนนำไปกัดด้วยกรดไนตอล 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 5 ถึง 10 วินาที เพื่อให้เห็นขอบ เกรนแล้วจึงนำไปถ่ายภาพโครงสร้างจุลทรรศน์ก่อนและหลังการอบชุบ ดังรูปที่ 3.2 และ 3.3 หลังจากนั้นนำชิ้นงานทั้งหมดไปขัดกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์หยาบถึงละเอียด (180 200 320 400 และ 600) เพื่อเตรียมพื้นผิวก่อนการเกลือบชั้นเกลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร

เมื่อขัดชิ้นงานทั้งหมดเรียบร้อย นำชิ้นงานไปทำกวามสะอาดด้วยสารละลาย อะซิโตนโดยใช้เกรื่องทำกวามสะอาดด้วยกลื่นอัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 20 นาที เมื่อกรบเวลานำ ออกมาล้างด้วยน้ำ de-ionized แล้วจึงทำกวามสะอาดด้วยสารละลายเอทธานอลอีกกรั้งเป็นเวลา 20 นาที เพื่อขจัดกราบสกปรกและกราบไขมันออกจากผิวชิ้นงาน หลังจากนั้นให้ล้างอีกกรั้งด้วยน้ำ de-ionized ก่อนเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อทำกวามสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยจึงนำไป เก็บในตู้เก็บชิ้นงาน (ตู้ดูดกวามชื้น) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศและกวามชื้นโดยตรง

3.2.2 กระบวนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร

กระบวนการเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรด้วยเทคนิก ฟิลเตอร์กาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ บนชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ถูกใช้เพื่อสร้างชั้นเคลือบที่มีพฤติกรรมด้านทานการกัดกร่อนและสมบัติเชิงกลที่ดีให้กับ ชิ้นงาน ซึ่งก่อนเคลือบชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรจำเป็นด้องเคลือบฟิล์มไททาเนียม บนชิ้นงานเหล็กกล้าก่อน เพื่อเพิ่มการยึดติดที่ดีระหว่างชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรและ ชิ้นงาน โดยฟิล์มบางของไททาเนียมได้ถูกเคลือบด้วยเทคนิกสป์ตเตอริง มีกวามหนาไม่เกิน 100 นาโนเมตร แสดงเครื่องเคลือบแบบสป์ตเตอร์ดังรูปที่ 3.23 และตารางที่ 3.4 แสดงตัวแปรต่าง ๆ ที่ จำเป็นต้องกวบกุมในการเคลือบชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชร ภายหลังจากเคลือบฟิล์ม บางไทเทเนียมและเคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรแล้วชิ้นงานจากถูกนำไปทคสอบ ค่าความแข็ง โดยเครื่องทคสอบค่าความแข็งระดับนาโนเมตร เพื่อหาค่าเฉลี่ยของความแข็งของแต่ ละชิ้นงานจะทำการวัคชิ้นงานละ 3 จุด จากการทคสอบ ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 3.5 สำหรับรูปที่ 3.24 แสดงเครื่องทคสอบค่าความแข็งระดับนาโนเมตรที่ใช้ในงานวิจัย



รูปที่ 3.23 เครื่องเคลือบฟิล์มไททาเนียมแบบสปัตเตอริง (ซ้าย) และเครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้าของ ระบบสปัตเตอร์ (ขวา)

ตัวแปรควบคุม	ค่ากำหนด			
ความคันหลัก (ทอร์)	3.5×10^{-5}			
ศักย์ไฟฟ้าการอาร์ก (-โวลต์)	700			
รอบการทำงานการอาร์ก (เปอร์เซ็นต์)	50			
ความถี่การอาร์ก (เฮิรตซ์)	1			
เวลาของการเคลือบ (นาที)	5			
ศักย์ไฟฟ้าไบแอส (-โวลต์)	100 ถึง 1000			

ตารางที่ 3.4 ตัวแปรควบคุมในการเคลือบชั้นเคลือบ DLC

ชิ้นงาน	ค่า	ความแข็ง (Gl	ค่าความแข็งเฉลี่ย (GPa)		
Uncoated H13	3.75 3.01 3.37		3.38		
Ti layer	5.41	6.64	4.73	5.59	
-200V DLC coated	16.69	11.96	23.01	17.22	
-500V DLC coated	18.50	5.45	9.02	10.99	
-800V DLC coated	12.02	8.68	7.64	9.45	
-1000V DLC coated	14.65	22.09	17.01	17.92	

ตารางที่ 3.5 ก่ากวามแข็งระดับนาโนเมตรของชิ้นงานที่เกลือบผิว (DLC/Ti/AISI H13) และไม่



เคลือบผิว (Uncoated H13)

รูปที่ 3.24 เครื่องทคสอบความแข็งระดับนาโนเมตร

3.2.3 การทดสอบการกัดกร่อน

ภายหลังเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน AISI H13 ถูกเคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติกล้ายเพชรด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศฟิล์ม เสร็จเรียบร้อยจะนำชิ้นงานทั้งหมดไปทดสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมีด้วยเครื่อง โพเทนชิโอสแตท ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอชเท่ากับ 2 7 และ10 ตามลำคับ เพื่อให้สามารถอ้างอิงกับงานวิจัยอื่นๆ ได้ จึงได้ทำการทดสอบการกัดกร่อนตาม มาตรฐาน ASTM G44-99 (2005) สำหรับการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ทำได้โดยการนำผลึกโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) 3.5 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 96.5 มิลลิลิตร ขนให้ละลายเข้ากัน แล้วเก็บเตรียมรอไว้ก่อน หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่จะทดสอบไปติดตั้ง กับชุดทดสอบการกัดกร่อน เมื่อติดตั้งชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย นำสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีก่าพีเอช 2 7 และ 10 ที่เตรียมไว้ก่อนหน้า ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เทใส่ ลงในชุดทดลอง สำหรับค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในช่วง -1000 มิลลิโวลต์ ถึง -100 มิลลิโวลต์ อัตราการสแกนเท่ากับ 0.01 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ก่อนเริ่มการสแกนจำเป็นต้องทำการวัด ก่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (open circuit potential, OCP) ก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบวัสดุหรือชิ้นงาน ทดสอบว่าเป็นชิ้นงานที่ต้องการทดสอบหรือไม่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที เมื่อ ตรวจสอบ OCP เรียบร้อยจึงเริ่มสแกน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือในการปรับค่าพีเอชของ สารละลายในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สารละลายกรดไฮโครคลอริกเพื่อปรับพีเอชความเป็นกรดและใช้ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อปรับค่าพีเอชความเป็นกลางและค่าง ซึ่งต้องมีการวัดค่าพีเอช ของสารละลายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่าย เพื่อควบคมค่าพีเอชของสารละลายให้แต่ละครั้งคงที่

3.2.4 การวิเคราะห์พื้นผิวและการตรวจสอบโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC

ก่อนการทดสอบการกัดกร่อนลักษณะพื้นผิวของชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติ กล้ายเพชรถูกตรวจสอบด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม พลังงาน (intensity) และค่าส่วนกลับความยาวคลื่น (wave numbers หรือ Raman shift) โดยธาตุและ โครงสร้างที่ต่างกันจะทำให้มีค่าส่วนกลับความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากนั้นนำชิ้นงานไป ตรวจสอบโครงสร้าง องค์ประกอบของธาตุและหาปริมาณของแต่ละโครงสร้างด้วยเทคนิค XPS X-PEEM และ SEM ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่สามารถยืนยันลักษณะที่แตกต่างกันของ โครงสร้างได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาปริมาณของแต่ละโครงสร้างที่อยู่ภายใน ชั้นเคลือบได้ด้วย

ภายหลังทดสอบการกัดกร่อน ชิ้นงานจะถูกนำมาตรวจวิเคราะห์พื้นผิว และ องค์ประกอบทางเคมีของแต่ละบริเวณที่ถูกกัดกร่อนด้วย SEM และเทคนิค X-PEEM อีกครั้ง เพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างหลังการกัดกร่อนระหว่างชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิวด้วย การ์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชรกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว องค์ประกอบ ของธาตุที่สำคัญที่ถูกพิจารณาได้แก่ ธาตุการ์บอน ออกซิเจน เหล็ก และไททาเนียม ซึ่งผลที่ได้จาก การทดลองแสดงออกมาเป็นภาพ (ได้จากเทคนิค PEEM) และสเปกตรัมที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มพลังงาน (intensity) และพลังงานโฟตอน (photon energy) ด้วยภาพและสเปกตรัม เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบริเวณที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน ซึ่งทำให้สามารถที่ จะวิเคราะห์ความแตกต่างของชิ้นงานได้

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาโครงสร้างของชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร (Diamond-Like Carbon, DLC) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอส หลังจากวิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำไปทดสอบการกัดกร่อนต่อไป ซึ่งมี รายละเอียดอยู่ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

4.1 การบ่งชี้ลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC ภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าใบแอสด้วยเทคนิครามาน สเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วย รังสีเอ็กซ์ และเอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครโกปี

รามานสเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือลำคับแรกเพื่อบ่งชื้ ถักษณะโครงสร้างของชิ้นงานเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวค้วยชั้นเคลือบ DLC สำหรับการ สังเคราะห์ชั้นเคลือบ DLC ของการวิจัยครั้งนี้มีการควบคุมศักย์ไฟฟ้าการอาร์ก (arc voltage) ความถี่ การอาร์ก (arc frequency) รอบการทำงานการอาร์ก (duty cycle) และเวลาในการเคลือบให้คงที่ เท่ากับ 700 โวลต์ 1 เฮิรตซ์ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 5 นาที ตามลำดับ นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง ค่าศักย์ไฟฟ้าใบแอส (bias voltage) ให้กับชิ้นงานที่ 100 200 600 800 และ 1000 โวลต์ เพื่อดูผลของ ศักย์ไฟฟ้าใบแอสที่มีต่อลักษณะโครงสร้างของชั้นเคลือบ จากการทคสอบได้ผลดังนี้ รูปที่ 4.1 แสดงตัวอย่างรามานสเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ที่เคลือบผิวด้วยเทคนิกฟิลเตอร์คาโธดิกอาร์ก ในระบบสุญญากาศภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าใบแอส

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปีจะได้สเปกตรัมของชั้นเคลือบ ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มระดับพลังงาน (intensity) และส่วนกลับความยาวคลื่น (wave numbers หรือ Raman shift) จากผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 4.1 พบว่าสเปกตรัมของแต่ละชิ้นงาน ที่สักย์ไฟฟ้าไบแอสต่างกันมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันคือมีจุดศูนย์กลางของจุดยอดแหลม (peak center) อยู่ที่ตำแหน่ง Raman shift ประมาณ 1560 เซนติเมตร⁻¹ ซึ่งจากสเปกตรัมบ่งบอกถึงลักษณะ ที่คล้ายกันกับสเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ซึ่งมีตำแหน่ง Raman shift โดยประมาณ 1540 ± 20 เซนติเมตร⁻¹ สอดกล้องกับงานวิจัยของ (Lung, B.H., Chiang, M.J., and Hon, M.H., 2001) ด้วย ซอฟแวร์ของ ORIGIN ทำให้สามารถที่จะแยกสเปกตรัมหลัก (raw spectrum) ของแต่ละชิ้นงาน ออกเป็นสองเส้นโค้งแบบเกาส์เซียน (Gaussian line curve) ได้ดังนี้ ตำแหน่งเส้นโค้งแรกมีจุดยอด แหลมอยู่ที่ Raman shift ระหว่าง 1350 และ 1370 เซนติเมตร⁻¹ ถูกเรียกว่า ดีพีค (D peak) ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่แสดงถึงโครงสร้างของแกรไฟต์ที่มีการจัดเรียงตัวกันของอะตอมคาร์บอนอย่างไม่เป็น ระเบียบ (disordered graphite) และอีกเส้นโค้งที่ตำแหน่ง Raman shift ระหว่าง 1545 และ 1565 เซนติเมตร⁻¹ ถูกเรียกว่า จีพีค (G peak) แสดงถึงโครงสร้างของแกรไฟต์ (graphite)

้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอสมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งของดีพีคและจีพีค ซึ่งการ ้เลื่อนตำแหน่งดังกล่าวสามารถบ่งบอกความแตกต่างของโครงสร้างของชั้นเคลือบได้ นอกจากนี้ ด้วยการวิเคราะห์รูปร่างของรามานสเปกตรัม เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดีและจีพีค อัตราส่วนพื้นที่ใต้กราฟระหว่างดีและจี (I_D/I_G ratio) และฟูลวิคธ์ฮาล์ฟแมกซิมัม (full width half maximum) ยังสามารถจำแนกความแตกต่างของชั้นเคลือบคาร์บอนออกไปได้อีก จากรูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของจีพิคและค่าความแข็งระดับนาโนเมตรกับศักย์ไฟฟ้า ้ไบแอส จะเห็นว่าเมื่อขนาคของศักย์ไฟฟ้าไบแอสเพิ่มขึ้นจาก -100 โวลต์ เป็น -200 โวลต์ ตำแหน่ง ของจีพีกได้เลื่อนไปที่ Raman shift ต่ำลงจาก 1564 ไปยัง 1557 เซนติเมตร⁻¹ และเมื่อศักย์ไฟฟ้า ใบแอสเพิ่มขึ้นจาก -600 ถึง -1000 ยังคงพบว่าตำแหน่งของจีพีคได้เลื่อนไปที่ Raman shift ต่ำลง จาก 1560 ไปยัง 1546 เซนติเมตร⁻¹ เช่นกัน การที่ตำแหน่งของจีพีคเลื่อนไปยัง Raman shift ต่ำลงมี ้ส่วนสอคกล้องกับการเพิ่มขึ้นของสัคส่วนโครงสร้างที่เป็นเพชร (sp³ carbon bonds) ในชั้นเคลือบ DLC ซึ่งผลที่ได้สอดกล้องกับงานวิจัยของ (Lung, B.H., Chiang, M.J., Hon, M.H., 2001) จากผล ในงานวิจัยยังพบว่าตำแหน่งของจีพีกมีแนวโน้มลดลงตามศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาง กณะวิจัยของ (Jimenez, Sutherland, D.G.J., Buuren, T.V., Carlisle, J.A., Terminello, L.T., and Himpsel, F.J., 1998) ได้เสนอแนะว่าปริมาณโครงสร้างของเพชรที่เพิ่มขึ้นสามารถได้มาจากการ ้เพิ่มศักย์ไฟฟ้าไบแอสให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะเร่งการเคลื่อนที่ของคาร์บอนไอออนให้ไปปลูกฝังใน ้ชั้นใต้พื้นผิวและเพิ่มความหนาแน่นของอะตอมการ์บอนพร้อมกับการเกิดขึ้นของชั้นเคลือบ DLC ้ด้วยเหตุนี้ในการวิเคราะห์ลำดับต่อมาจึงได้เลือกพิจารณาศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่มีผลทำให้ตำแหน่ง ของจีพีกที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ซึ่งมีตำแหน่งของ จีพีคเท่ากับ 1564 และ 1546 เซนติเมตร⁻¹ ตามลำคับ

เพื่อดูผลของการเลื่อนตำแหน่งจีพีค ชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำไป วิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่อไปด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีของอนุภาค อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (x-ray photoemission spectroscopy, XPS) ซึ่งเป็นเทคนิค ที่วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงกุณภาพและเชิงปริมาณ จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ด้วยเทคนิค XPS ได้ผลดังนี้ รูปที่ 4.3 แสดง ้ตัวอย่าง C1s XPS สเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ที่เตรียมด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโชดิกอาร์กใน ระบบสุญญากาศภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ จากสเปกตรัมหลักแสดง ้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มระดับพลังงาน (intensity) และพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนใน อะตอม (binding energy) พบว่าชิ้นงานทั้งสองมีจุดยอดแหลมอยู่ที่ระดับพลังงานประมาณ 284.5 อิเล็กตรอนโวลต์ จากสเปกตรัมหลักสามารถแยกออกเป็น 3 สเปกตรัมย่อยได้ด้วยซอฟแวร์ของ ORIGIN ซึ่งแสดงระดับพลังงานที่ตำแหน่งจุดยอดแหลมต่าง ๆ ได้แก่ 287.5 285.0 และ 284.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ โดยจุดยอดแหลมตำแหน่งแรกที่ระดับพลังงานสูงสุด 287.5 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงระดับพลังงานที่สอดกล้องกับพันธะระหว่างอะตอมของการ์บอนกับ ออกซิเจน (C-O bonding) ซึ่งเป็นลักษณะของพันธะที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนในบรรยากาศโดยเฉพาะ ออกซิเจนที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานหรือระหว่างขั้นตอนการเก็บชิ้นงานรอ ทคสอบ XPS จุดยอดแหลมตำแหน่งที่สองและสามอยู่ที่ระดับพลังงาน 285.0 และ 284.0 แสดงระคับพลังงานที่สอดกล้องกับพันธะระหว่างอะตอมของการ์บอนกับ อิเล็กตรอนโวลต์ คาร์บอนที่เป็นโครงสร้างของเพชร (sp³ carbon bonding) และแกรไฟต์ (sp² carbon bonding) ตามลำดับ ด้วยลักษณะของโครงสร้างดังกล่าวบ่งบอกถึงโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ที่ ประกอบด้วยโครงสร้างของเพชรและแกรไฟต์ผสมกันเป็นโครงสร้างการ์บอนอสัณฐาน ซึ่งกล้าย กับงานวิจัยของทางคณะ (Wu, J.B., Chang, J.J., Li, M.Y., Leu, M.S., and Li, A.K., 2007)

นอกจากนี้เพื่อหาปริมาณของแต่ละ โครงสร้างที่อยู่ในชั้นเคลือบจึงได้ใช้โปรแกรมในการ กำนวณ (ADVANTAGE) จากการกำนวณได้ผลดังตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงเป็นโครงสร้าง ตำแหน่งจุด ขอดแหลม พื้นที่ใด้กราฟและปริมาณของแต่ละ โครงสร้างของชั้นเคลือบ จากตารางจะเห็นว่าชั้น เกลือบ DLC ที่เคลือบภายให้สักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ ให้โครงสร้างของเพชรมากกว่าชั้น เกลือบ DLC ที่เคลือบภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าชั้นเคลือบ DLC ที่เคลือบภายใต้สักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลด์ ให้ลักษณะของ โครงสร้างที่มีสัดส่วนระหว่างเพชรต่อแกรไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ที่สูงที่สุดและเป็นสภาวะ การเคลือบ DLC ทั้งสองมีสัดส่วนของเพชรต่อแกรไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ที่สูงที่สุดและเป็นสภาวะ การเคลือบ DLC ทั้งสองมีสัดส่วนของเพชรต่อแกรไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ที่สูงที่สุดและเป็นสภาวะ การเคลือบ DLC ทั้งสองมีสัดส่วนของเพชรต่อแกรไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ที่สูงที่สุดและเป็นสภาวะ การเคลือบ DLC ทั้งสองมีสัดส่วนของเพชรต่อแกรไฟต์ค่อนข้างสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชั้นเกลือบ DLC มีสมบัติเชิงกลที่ดีตามมาด้วย (J. Robertson, 2002) เพื่อยืนยัน สมบัติเชิงกลจึงได้มีการวัดก่าความแข็ง โดยการวัดได้เฉลี่ยกคชิ้นงานละ 3 จุด ซึ่งพบว่าก่าความแข็ง ระดับนาโนเมตรของชั้นเกลือบ DLC ที่เคลือบภายใต้สภาวะสักย์ไฟฟ้าไบแอสต่าง ๆ มีก่าความแข็ง อยู่ระหว่าง 9 ถึง 18 GPa เมื่อเทียบกับก่าความแข็งสูงสุด (18 GPa) พบว่ามีก่าสูงกว่าชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือและชั้นฟิล์มไทเทเนียมอยู่ประมาณ 4 และ 6 เท่า ตามลำดับ แสดงค่าความแข็ง ระดับนาโนเมตรดังตารางที่ 4.2 ซึ่งค่าความแข็งที่ได้จากการทดลองพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัย ของ (Li, K.Y., Zhou, Z.F., Chan, C.Y., Bello, I., Lee, C.S., Lee, S.T., 2001; Li, K.Y., Zhou, Z.F., Chan, C.Y., Bello, I., Lee, C.S., Lee, S.T., 2005; Sui, J., Cai, W., 2006; Sui, J.H., Cai, W., 2007; Wu, J.B., Chang, J.J., Li, M.Y., Leu, M.S., Li, A.K., 2007; Weng, K.W., Hen, S., Chen, Y.C., Wang, D.Y., 2008) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นชั้นเคลือบที่มีสมบัติเชิงกลทางด้านค่าความแข็งที่สูง เหมาะต่อการนำไปใช้เป็นชั้นเคลือบป้องกันการสึกหรอและการขูดขีดได้ดี

้นอกจากนี้เพื่อยืนยันลักษณะ โครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ใด้แก่ โครงสร้างที่เป็นเพชร หรือแกรไฟต์ (sp³ หรือ sp² carbon bonds) จึงได้นำตัวอย่างชิ้นงานที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชัน อิเล็กตรอนไมโครโกปี (x-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM) ซึ่งถือได้ว่าเป็น เทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ระบุโครงสร้างของชั้นเคลือบคาร์บอนอสัณฐาน (amorphous carbon) ได้ ้อย่างแม่นยำ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะแสดงเป็นสเปกตรัมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม ระดับพลังงาน (intensity) และพลังงานโฟตอน (photon energy) จากการทดสอบได้ผลดังนี้ รูปที่ 4.4 แสดงตัวอย่าง C K-edge XAS สเปกตรัมของชั้นเกลือบ DLC ที่เตรียมด้วยเทกนิกฟิลเตอร์ คาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ จากสเปกตรัม ดังกล่าวแสดงตำแหน่งระดับพลังงานของโครงสร้างต่าง ๆ ในชั้นเคลือบ ดังนี้ 285.2 287.8 และ 289.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ ตำแหน่งแรกระดับพลังงานที่ 285.2 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดง โครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะจาก C (1s) เป็นสภาวะ πst ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างของ hybridization) ตำแหน่งที่สองระดับพลังงาน 287.8 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดง แกรไฟต์ (sp² ้โครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะจาก C (1s) เป็นสภาวะ σ_* ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดจากพันธะ ระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจน (sp² (C=O)) หรือคาร์บอนกับไฮโครเจน (sp³ (C–H)) ซึ่งการปรากฏ ของออกซิเจนและไฮโครเจนในชั้นเคลือบ อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเคลือบ DLC หรือ ระหว่างการเตรียมชิ้นงานรอการเคลือบ และตำแหน่งสุดท้ายที่ระดับพลังงาน 289.5 อิเล็กตรอน ้โวลต์ แสดงโครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะจาก C (1s) เป็น σ* ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง ของเพชร (sp³ hybridization) นอกจากนี้ที่ระดับพลังงานตั้งแต่ 291 อิเล็กตรอนโวลต์ สูงขึ้นไปยัง แสดงลักษณะของโครงสร้างของการ์บอนอสัณฐาน ซึ่งตรงกับโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC คือมี ้ถักษณะเป็นชั้นเคลือบคาร์บอนอสัณฐานที่เกิดจากการผสมกันระหว่างโครงสร้างที่เป็นเพชรกับ แกรไฟต์ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเทกนิกฟิลเตอร์กาโธดิกอาร์กในระบบสุญญากาศสามารถที่จะสร้าง ้ชั้นเคลือบ DLC ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างคาร์บอนอสัณฐานที่ผสมระหว่างโครงสร้างที่เป็น

เพชรและแกรไฟต์ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งค่าระดับพลังงานที่ได้กล่าวมาเหล่านี้พบว่า สอดกล้องกับคณะวิจัยของ (Jimenez, D.G.J. Sutherland, T. van Buuren, Carlisle, J.A., Terminello, L.T., Himpsel, F.J., 1998)



รูปที่ 4.1 รามานสเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ที่เตรียมด้วยเทกนิกฟิลเตอร์กาโธดิกอาร์กในระบบ สุญญากาศภายใต้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอส



รูปที่ 4.2 ตำแหน่งของจีพีกและค่าความแข็งกับศักย์ไฟฟ้าไบแอส



รูปที่ 4.3 C1s XPS สเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์

$C - cn^3$				
C-sp	284.9	382.8	89.1	
C-sp ²	284.0	26.2	4.7	
C-O	287.7	20.2	6.2	
C-sp ³	285.0	229.5	83.3	
C-sp ²	284.2	21.2	7.6	
C-O	288.0	24.5	9.1	
	$ \begin{array}{c} C-sp^2 \\ \hline C-O \\ C-sp^3 \\ \hline C-sp^2 \\ \hline C-O \end{array} $	C-sp ² 284.0 C-O 287.7 C-sp ³ 285.0 C-sp ² 284.2 C-O 288.0	C-sp ² 284.0 26.2 C-O 287.7 20.2 C-sp ³ 285.0 229.5 C-sp ² 284.2 21.2 C-O 288.0 24.5	

ตารางที่ 4.1 โครงสร้าง ตำแหน่งจุดยอดแหลม และปริมาณสัคส่วนโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ที่ได้จากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ

ตารางที่ 4.2 ค่าความแข็งระดับนาโนเมตรของชิ้นงานที่เกลือบผิว (DLC/Ti/AISI H13) และ

ไม่เกลือบผิว (Uncoated H13)

ชิ้นงาน	۴	่าความแข็ง (Gl	ค่าความแข็งเฉลี่ย (GPa)		
Uncoated H13	3.75	3.01	3.37	3.38	
Ti layer	5.4	6.64	4.73	5.59	
-200V DLC coated	16.69	11.96	23.01	17.22	
-500V DLC coated	18.50	5.45	9.02	10.99	
-800V DLC coated	12.02	8.68	7.64	9.45	
-1000V DLC coated	14.65	22.09	17.01	17.92	



รูปที่ 4.4 C K-edge XAS สเปกตรัมของชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์

4.2 การวิเคราะห์ตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC

จากรูปที่ 4.5 แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราคที่กำลังขยาย 3,500X จากการทดสอบพบว่ามี บริเวณที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 3 บริเวณ ได้แก่ ชั้นเคลือบ DLC และฟิล์ม Ti (coating zone) บริเวณรอยต่อ (interface หรือ diffusion zone) และวัสดุพื้น (substrate zone)

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละบริเวณได้ดัง รูปที่ 4.6 แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เกลือบผิวด้วยชั้นเกลือบ DLC ซึ่งมีการ ใช้เทคนิก EDS ในการวิเกราะห์กวามแปรปรวนขององค์ประกอบทางเกมี จากรูป 4.6 (ก) แสดงภาพตัดขวางและทิศทางการสแกน สำหรับรูปที่ 4.6 (ข) แสดงกวามเข้มระดับพลังงาน ของธาตุในแต่ละบริเวณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยกรั้งนี้ ได้แก่ธาตุ เหล็ก (Fe) ไทเทเนียม (Ti) และ คาร์บอน (C) จากการวิเคราะห์พบว่าธาตุการ์บอนซึ่งเป็นธาตุหลักที่เป็นธาตุองค์ประกอบของ ชั้นเคลือบ DLC มีปริมาณสูงขึ้นและลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะที่ลึกเข้าไปถึงฟิล์มไทเทเนียม สำหรับ ธาตุไทเทเนียมพบว่ามีปริมาณก่อนข้างสูงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุการ์บอนใน ชั้นเคลือบ DLC เนื่องจากกวามหนาของฟิล์มไทเทเนียมที่ก่อนข้างหนากว่าชั้นเคลือบ DLC และเมื่อ พิจารณาบริเวณวัสดุพื้นพบว่ามีปริมาณของธาตุเหล็กก่อนข้างสูงเช่นเดียวกับธาตุไทเทเนียม เนื่องจากชิ้นงานที่ใช้ในงานวิจัยกรั้งนี้เป็นเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 สำหรับบริเวณรอยต่อระหว่าง ชั้นเคลือบ DLC กับฟิล์มไทเทเนียม พบว่าปริมาณของธาตุการ์บอนจะก่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นและลดลง เรื่อย ๆ ตามระยะความลึกเข้าไปทางฟิล์มไทเทเนียมในทางกลับกันปริมาณของธาตุไทเทเนียมมี แนวโน้มก่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น และเช่นเดียวกันกับบริเวณรอยต่อระหว่างฟิล์มไทเทเนียมกับวัสดุพื้น พบว่าปริมาณของธาตุไทเทเนียมจะเพิ่มสูงขึ้นและลดลงเรื่อย ๆ ตรงกันข้ามกับปริมาณของธาตุ เหล็กที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและคงที่เมื่อลึกเข้าไปบริเวณวัสดุพื้น



รูปที่ 4.5 แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ที่กำลังขยาย 3,500X



รูปที่ 4.6 แสดงภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC โดยการใช้เทคนิก EDS ในการตรวจสอบ

4.3 ผลการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบผิว

4.3.1 พฤติกรรมการกัดกร่อนจากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน

ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้า ใบแอส -100 และ -1000 โวลต์ และไม่เคลือบผิวถูกทดสอบการกัดกร่อนตามหลักไฟฟ้าเคมีใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2.7 และ 10 ตามลำดับ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4.7 จากผลการทดสอบพบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของทุกชิ้นงานเกิดการ เปลี่ยนแปลงตามค่าพีเอชของสารละลาย สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่ได้เคลือบผิว พบว่า ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, E_{corr}) ที่พีเอช 2.7 และ 10 มีความแตกต่างกัน เล็กน้อย ซึ่งจากการทดสอบพบว่าค่าที่ได้อยู่ในช่วง -550 ± 20 มิลลิโวลต์ อย่างไรก็ตามพบว่าค่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, i_{corr}) มีการเปลี่ยนแปลงตาม ค่าพีเอชของสารละลายที่เปลี่ยนไปเช่นกัน แต่ที่พีเอช 2 ซึ่งเป็นสารละลายที่มีความเป็นกรคจึงมี [H⁺] สูง จะเห็นว่าค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนมีค่าสูงมากกว่าที่พีเอช 7 และ 10 (สารละลายเป็นกลางและค่าง) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนมี แนวโน้มลดลงเมื่อนำไปทดสอบในสารละลายที่เป็นกลางและค่าง ซึ่งค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าของชิ้นงานที่ทดสอบในสารละลายที่พีเอช 2 มีค่าสูงกว่าชิ้นงานที่ทดสอบใน สารละลายที่พีเอช 7 และ 10 ประมาณ 10 เท่า (แสดงดังตารางที่ 4.3) ซึ่งบ่งบอกว่าสารละลายที่มี ความเป็นกรดสูงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ค่อนข้างมาก สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เกลือบผิวด้วยชั้น เกลือบ DLC พบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนยังคงขึ้นอยู่กับค่าพีเอชเช่นเดียวกันกับชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือที่ไม่เคลือบ

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบกับชิ้นงานเหล็กกล้า เกรื่องมือที่ถูกเคลือบ พบว่าก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิว ด้วยชั้นเคลือบ DLC มีค่าสูงกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบยกเว้นในสารละลายที่พีเอช 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารละลายที่พีเอช 2 ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบผิวเมื่อสัมผัสกับ สารละลายจะเกิดการกัดกร่อนก่อนเมื่อเทียบกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบผิวเมื่อสัมผัสกับ สารละลายจะเกิดการกัดกร่อนก่อนเมื่อเทียบกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบ อย่างไรก็ ตามค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC มีก่าต่ำกว่าของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบในทุกก่าพีเอช ซึ่งค่าความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ต่ำกว่าชี้ให้เห็นถึงอัตราการการกัดกร่อนที่ต่ำด้วย ดังนั้นจึง กล่าวได้ว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน H13 ที่ผ่านการเกลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC แสดงพฤติกรรมด้านทานการกัดกร่อนได้คีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผิวในทุกก่าพีเอช แต่ที่พีเอช 2 ชิ้นงานที่ถูกเคลือบจะเกิดการกัดกร่อนก่อนชิ้นงานที่ไม่เคลือบ แต่ สุดท้ายเมื่อทิ้งให้สัมผัสอยู่ในสารละลายการกัดกร่อนที่พีเอช 2 เป็นระยะเวลานานชิ้นงานเหล็กกล้า ที่ไม่เคลือบก็จะถูกกัดกร่อนด้วยอัตราการกัดกร่อนที่รวดเร็วกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าที่ถูกเคลือบ เนื่อง ด้วยสาเหตุที่ว่ามีก่าดวามหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่านั้นเอง

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะชิ้นงานที่เคลือบผิว พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดงค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบภายใด้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ อยู่เล็กน้อย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าชั้นเคลือบ DLC ที่เตรียมภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ -1000 โวลต์ แสดงพฤติกรรมด้านทานการกัดกร่อนในสารละลาย โซเดียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่พีเอชสารละลาย 2-7 และ 10 ได้ดีกว่า ชั้นเคลือบ DLC ที่เตรียมภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์



รูปที่ 4.7 แสดงเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบผิวค้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เกลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้า -100 และ -1000 โวลต์ ในสารละลายโซเคียม คลอไรค์ ความเข้มข้น3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำคับ จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ และไม่เคลือบผิว สามารถนำมาหา ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential, *E_{corr}*) ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density, *i_{corr}*) และค่าอัตราการกัดกร่อน (corrosion rate, *R_{mmpy}*) ได้ดังแสดงใน ตารางที่ 4.3

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าค่าสักข์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า เกรื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบ (uncoated sample) เปรียบเทียบกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบ ผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ที่สักข์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ (DLC coated sample) ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 พบว่าชิ้นงานทั้งที่ เคลือบผิวและไม่เคลือบมีค่าสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงที่สุดที่สารละลายพีเอช 7 รองลงมาที่พีเอช 10 และ 2 ตามลำคับ สำหรับค่าสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงที่สุดที่สารละลายพีเอช 7 รองลงมาที่พีเอช 10 และ 2 ตามลำคับ สำหรับค่าสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่พีเอช 2 และ 10 ของชิ้นงานที่เคลือบผิวทุก ชิ้นมีค่าสูงกว่าของชิ้นงานที่ไม่เคลือบเล็กน้อย ยกเว้นที่พีเอช 2 จะเห็นว่าค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ของชิ้นงานที่ไม่เคลือบมีค่าสูงกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบทุกชิ้นงาน แสดงว่าที่พีเอช 2 ชิ้นงานที่เคลือบ ผิวจะเกิดการกัดกร่อนก่อนชิ้นงานที่ไม่เคลือบ เนื่องจากค่าสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนจะเป็นตัวบ่งบอก ถึงความมีเสถียรภาพ (noble) ของโลหะนั้น ดังนั้นโลหะที่แสดงก่าสักย์ไฟฟ้าสูงกว่าก็จะเกิดการกัด กร่อนช้ากว่าโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ต่ำกว่าและเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะชิ้นงานที่เคลือบผิว พบว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดงก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูง กว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ แสดงก่าสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนสูง กว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวภายให้สักย์ไฟฟ้าใบแอส -100 โวลต์ แสดงก่าสักย์ใสงน่งบอกว่าชั้นเคลือบที่

้สำหรับค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของขึ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่ไม่ถูกเคลือบ (uncoated sample) เปรียบเทียบกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ เกลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ (DLC coated sample) ใน สารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 พบว่าก่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ไม่เคลือบผิวมีค่าสูงกว่าของชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ทุกค่าพีเอชของสารละลาย ซึ่งที่ก่าพีเอช 2 (สารละลายกรด) พบว่าชิ้นงานทุกชิ้นมีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงที่สุด และ เมื่อเปรียบเทียบที่พีเอช 2 7 และ 10 ของชิ้นงานทั้งหมด พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบภายใด้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดงก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนต่ำที่สุด รองลงมา เป็นชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ และชิ้นงานที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว ตามลำดับ ดังนั้นจากก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนบ่งบอกว่าชิ้นงานที่เกลือบผิว ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ จะมีอัตราการกัดกร่อนต่ำที่สุด รองลงมาเป็นชิ้นงานที่เคลือบ ผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ และชิ้นงานที่ไม่เคลือบ ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าที่ไม่เคลือบผิวและชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือที่ถูกเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 พบว่าชิ้นงาน เหล็กกล้าที่เคลือบผิวมือัตราการกัดกร่อนที่ต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าที่ไม่เคลือบทุกค่าพีเอชของ สารละลาย โดยที่พีเอช 7 ชิ้นงานทุกชิ้นมีค่าอัตราการกัดกร่อนที่ต่ำที่สุด รองลงมาที่พีเอช 10 และ พีเอช 2 ตามลำดับ นอกจากนี้ถ้าพิจารณาเฉพาะชิ้นงานที่เคลือบผิว พบว่าอัตราการกัดกร่อนของ ชิ้นงานที่เคลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีค่าต่ำกว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ ทุกพีเอช ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ป้อนให้กับ ชิ้นงานระหว่างเคลือบผิวมีผลทำให้พฤติกรรมความด้านทานการกัดกร่อนที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการ ทดสอบการกัดกร่อนตามหลักการไฟฟ้าเคมีในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ จะแสดงพฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานที่ เกลือบผิวภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ ในทุกค่าพีเอชาองสารละลาย



Something	E_{corr} (mV)			i_{corr} (A/cm ²)			(mm/y)		
Samples	pH 2	pH 7	pH 10	pH 2	pH 7	pH 10	pH 2	pH 7	pH 10
Uncoated	-518.290	-566.460	-571.610	37.08×10 ⁻⁶	3.18×10 ⁻⁶	3.60×10 ⁻⁶	0.449	0.037	0.042
-100V DLC coated	-550.100	-521.360	-533.800	20.38×10 ⁻⁶	1.12×10 ⁻⁶	1.18×10 ⁻⁶	0.090	0.009	0.009
-1000V DLC coated	-641.200	-493.790	-546.250	18.50×10^{-6}	0.90×10^{-6}	1.15×10 ⁻⁶	0.081	0.005	0.005

ตารางที่ 4.3 ค่าที่ได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC (DLC coated) และไม่เคลือบผิว (uncoated)



4.3.2 กลไกการกัดกร่อนที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่ถูกเคลือบผิวด้วยชั้น เคลือบ DLC และไม่เคลือบ

สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่สัมผัสกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ้ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่สภาพความเป็นกรด-กลาง-ค่าง 2.7 และ 10 พบว่าไอออน หลักที่ละลายอยู่ประกอบด้วย โปรตอน [H⁺] ไฮครอกซิล [OH] และคลอไรค์ไอออน [Cl] ที่เกิด จากการแตกตัวของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) และสารละลาย ์ โซเดียมไฮครอกไซด์ (NaOH) ซึ่งทำให้การกัดกร่อนเกิดที่ผิวของชิ้นงาน โดยเฉพาะสารละลายที่มี [Cl] และ [H⁺] ร่วมด้วยก็จะส่งเสริมให้เกิดการกัดกร่อนรุนแรงมากขึ้น โดยปกติลักษณะการ ้กัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือจะเกิดในลักษณะที่เรียกว่าการกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอทั่วผิวหน้า (general หรือ uniform corrosion) คือ มีการกัดกร่อนทั่วบริเวณผิวชิ้นงานที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม การกัดกร่อน ซึ่งลักษณะของการกัดกร่อนดังกล่าวนี้พบมากในโลหะที่ไม่สามารถสร้างฟิล์ม ปกป้องพื้นผิวของตัวเองได้รวดเร็ว การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นเป็นพื้นที่กว้างและทำลายพื้นผิวของ ชิ้นงานมากที่สุดในเชิงปริมาณ สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก็มีการกัดกร่อนในลักษณะ เช่นเดียวกันคือ เมื่อเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 สัมผัสกับสารละลายที่ประกอบด้วย [H⁺] [OH⁻] และ [Cl] จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้เหล็กไอออน (Fe²⁺ + 2e) ดังสมการที่ 4.1 นอกจากนี้ใน สารถะถายที่มีอากาศหรือออกซิเจนและ ไอน้ำซึ่งเป็นตัวออกซิ ใคส์และทำหน้าที่รับอิเล็กตรอน ได้ดี ้จึงทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชั้นอย่างรวดเร็วให้ OH ดังสมการที่ 4.2 ในขณะเดียวกันที่เหล็กไอออนทำ ปฏิกิริยากับไฮครอกซิลให้สารประกอบเฟอรัสไฮครอกไซค์ (Fe(OH),) ตกตะกอนที่ผิว คังสมการ ที่ 4.3 สุดท้ายเมื่อเฟอรัสไฮครอกไซค์สัมผัสกับออกซิเจนก็จะให้สารประกอบเฟอริกออกไซค์หรือ เฮมาไทต์ (Fe₂O₃) ที่รวมอยู่กับน้ำบนผิวเหล็ก ขณะที่น้ำระเหยออกไปจึงเหลือเฉพาะเฮมาไทต์หรือ ้สนิมเหล็ก ซึ่งมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดง ดังสมการที่ 4.4 ในระหว่างนั้นเมื่อโปรตอนในสารละลาย ้ที่เป็นกรคทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ละลายอยู่ก็จะให้ โมเลกุลของน้ำเกิดขึ้นในสารละลายต่อไป ดังสมการที่ 4.5 ทำให้ปฏิกิริยาการกัดกร่อนดำเนินต่อไป ซึ่งปฏิกิริยาทั้งหมดเป็นตัวกวบคุม กระบวนการของการกัดกร่อน แสดงดังสมการเคมีที่ 4.1 ถึง 4.5 ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนของ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13

$$Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^{-}$$
(4.1)

$$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4(OH)^-(aq)$$
 (4.2)

$$2Fe^{2+} (aq) + 4OH^{-} (aq) \leftrightarrow 2Fe(OH)_2 (s)$$
(4.3)

$$2Fe(OH)_{2}(s) + \frac{1}{2}O_{2}(g) \to Fe_{2}O_{3} \cdot H_{2}O(s) + H_{2}O(l)$$
(4.4)

$$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$$
 (4.5)

โดยงานวิจัยกรั้งนี้ได้มีการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ สารละลายไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ค่าพีเอชของสารละลายมีความเป็นกรด กลางและค่าง (พีเอช 2 7 และ 10) ตามลำดับ ซึ่งผลของการเติมสารละลายปรับค่าความเป็นกรด-ค่าง จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ 4.6 ถึง 4.11 ดังนี้

$$\operatorname{HCl}(\operatorname{aq}) \to \operatorname{H}^{+}(\operatorname{aq}) + \operatorname{Cl}^{-}(\operatorname{aq})$$

$$(4.6)$$

$$2\mathrm{H}^{+}(\mathrm{aq}) + 2\mathrm{e}^{-} \rightarrow 2\mathrm{H}(\mathrm{atoms}) \rightarrow \mathrm{H}_{2}(\mathrm{gas})$$

$$(4.7)$$

$$Fe^{2^{+}}(aq) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow FeCl_{2}(aq)$$
(4.8)

$$FeCl_2(aq) + 2H_2O(1) \rightarrow Fe(OH)_2(s) + 2H^+(aq) + 2Cl^-(aq)$$
 (4.9)

$$2Fe(OH)_2(s) + H_2O(l) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2Fe(OH)_3(s)$$
 (4.10)

$$2Fe(OH)_3 (s) \rightarrow 2FeO(OH) + 2H_2O (s) \rightarrow Fe_2O_3 (s) + 3H_2O (l)$$
 (4.11)

จากสมการเคมีที่ 4.6 ที่สารละลายพีเอช 2 เมื่อสารละลายกรดไฮโครคลอริกแตก ตัวให้ [H⁺] และ [CI] เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อ [H⁺] รวมตัวกับ e⁻ เกิดเป็นฟองแก๊สไฮโครเจน (H₂) ที่ผิวของชิ้นงาน ดังสมการเคมีที่ 4.7 เมื่อฟองแก๊สไฮโครเจนซึ่งมีแรงดันภายในสูงแตกสลาย จะทำลายผิวของชิ้นงานโลหะ ทำให้พื้นผิวมีลักษณะหยาบและเป็นหลุม ซึ่งเหนียวนำให้เกิดการ กัดกร่อนได้ง่ายขึ้น ทำให้กลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะจนเกิดการกัดกร่อนบน ผิวชิ้นงานโลหะให้สารละลายเหล็กกลอไรด์ได้อย่างรวดเร็ว ดังสมการเคมีที่ 4.8 หลังจากนั้นเมื่อ สารละลายเหล็กกลอไรด์รวมตัวกับน้ำและออกซิเจนจึงเกิดเป็นสนิมเหล็ก แสดงดังสมการเคมีที่ 4.9 ถึง 4.11 โดยลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะกล้ายกับการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันคือร่องรอยกัดกร่อนจะอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มและมีผิวที่หยาบชัดเจนกว่า ดังนั้นจึงสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบและที่ถูก เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ที่พีเอช 2 จึงมากกว่าที่พีเอช 7 และ 10 ตามลำดับ เนื่องด้วยที่ สารละลายพีเอช 2 มีปริมาณของ [CI] สูงนั้นเอง อย่างไรก็ตามที่พีเอช 10 การกัดกร่อนจะมี ไฮดรอกซิลไอออนที่เกิดจากการแตกตัวของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการปรับค่า พีเอชของสารละลายให้มีความเป็นด่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าค่า สักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานที่ทดสอบใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่พีเอช 10 จึงมีค่ามากกว่าที่พีเอช 7 เมื่อนำค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน ใปคำนวณหาอัตราการกัดกร่อน โดยใช้หลักการของฟาราเดย์ พบว่าอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่พีเอช 10 มีค่ามากกว่าที่พีเอช 7 ด้วยเช่นกัน

้สำหรับกลไกการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ้ชั้นเคลือบ DLC พบว่าเนื่องด้วยชั้นเคลือบมีคุณสมบัติที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี (chemical inertness) ้จึงทำให้ไม่ปรากฏลักษณะของฟิล์มป้องกันหรือหรือพาสสีฟฟิล์ม (passive film) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มี ้สภาพเฉื่อยต่อการกัดกร่อนและมักพบในเหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ที่มีสมบัติต้านทานการกัคกร่อนได้แต่ขณะเคียวกันชั้นเคลือบ DLC ก็ยังคงมีพฤติกรรมความ ้ต้านทานการกัดกร่อนที่แสดงให้เห็นเช่นกัน ดังนั้นเพื่ออธิบายกลไกการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก สามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะดังนี้ (Lillard, R. S., Butt, D.P., Taylor, T.N., Walter, K.C., and Nastasi, M., 1997; Liu, C., Hu, D., Xu, J., Yang, D., Qi, M., 2006) ลักษณะแรกการกัดกร่อนจะเริ่มเกิดเมื่อมีรอยแตกของ ชั้นเคลือบเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบการกัดกร่อน การเกิดรอยแตกในลักษณะดังกล่าวอาจเนื่อง มากจากสาเหตุที่ชั้นเคลือบมีความเก้นภายในสูงหรือชั้นเคลือบมีแรงยึคเกาะกับพื้นผิวต่ำอยู่ก่อนจึง ทำให้ชั้นเกลือบแตกหรือหลุดร่อนได้ง่าย เมื่อสารละลายสามารถแทรกซึมเข้าไปภายในรอยแตก และสัมผัสกับพื้นผิวเหล็กได้โดยตรง จากนั้นการกัดกร่อนจึงเริ่มเกิดขึ้น โดยลักษณะของการ กัดกร่อนจะคล้ายกับการกัดกร่อนในซอกหรือที่อับอากาศ (crevice corrosion) คือเริ่มแรกยังคงมี ้ปริมาณออกซิเจนเท่ากันทั้งภายนอกและภายในรอยแตก การกัดกร่อนจึงเกิดขึ้นทั้งภายนอกและ ภายในรอยแตก อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายในรอยแตกเมื่อเกิดการกัดกร่อนไปช่วงระยะหนึ่ง กลับ พบว่าออกซิเจนจะลดลงมากจนกระทั่งเกิดลักษณะที่ขาดออกซิเจนภายในรอยแตก ทำให้ปฏิกิริยา ้ รีดักชันที่บริเวณที่ทำหน้าที่เป็นขั้วคาโธด ดังสมการเคมีที่ 4.2 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหลือเฉพาะ ปฏิกิริยาออกซิเคชันที่ทำหน้าที่เป็นขั้วแอโนคที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังสมการเคมีที่ 4.1 เมื่อ ้ปริมาณ Fe²⁺ ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มจำนวนขึ้นมากในรอยแตก จะพบว่าคลอไรด์ไอออน

[Cl] ซึ่งมีประจุลบและขนาดเล็กจะเข้ามาดุลประจุภายในรอยแตกให้เป็นกลางและทำปฏิกิริยากับ Fe²⁺ ที่เป็นประจุบวกเกิดเป็นสารละลายเหล็กคลอไรด์ ดังสมการเคมีที่ 4.8 ซึ่งกลไกการเกิดการ ้กัดกร่อนลักษณะดังกล่าวมีสมการเคมีควบคุมคล้ายกับสมการเคมีที่ 4.8 ถึง 4.11 นอกจากนี้ HCl ที่ เกิดขึ้น ดังสมการเกมีที่ 4.9 จะส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนต่อไปอย่างรุนแรงประกอบกับภายนอก รอยแตกที่มีอัตราการกัคกร่อนของปฏิกิริยารีคักชันเพิ่มขึ้น เนื่องจากภายนอกรอยแตกมีปริมาณของ ออกซิเจนมากกว่าภายในรอยแตกจึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนมาปิดทับรอยแตกทำให้ ้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปภายในรอยแตกได้ง่าย จึงส่งผลให้อัตราการกัดกร่อนภายในรอยแตก รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เกิดเป็นการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) โดยบริเวณการ กัคกร่อนจะมีลักษณะคล้ายรูเข็ม (pits) แสดงคังรูปที่ 4.8 (ก) สำหรับลักษณะที่สองเกิดจาก ้ชั้นเคลือบมีรูพรุนหรือรอยแตกเกิดขึ้นอยู่ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน ดังนั้นสารละลายที่อยู่รอบ ้นอกจึงสามารถเข้าไปภายในรูพรุนและสัมผัสกับวัสดุพื้นหรือเหล็กกล้าได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นด้วย ้ความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเคมีระหว่างชั้นเคลือบและวัสดุพื้นจึงทำให้เกิดการกัดกร่อนในลักษณะ การกัดกร่อนแบบแกลแวนิก (galvanic corrosion) คือ การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับสองบริเวณที่มี ้ศักย์ไฟฟ้าเคมีแตกต่างกัน โดยบริเวณที่สูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย (มีศักย์ไฟฟ้าเคมีต่ำกว่า) คือ ้บริเวณที่เป็นวัสดุพื้น ทำหน้าที่เป็นผู้ให้อิเล็กตรอนและสูญเสียเนื้อโลหะและบริเวณที่ทำหน้าที่รับ อิเล็กตรอน (ศักย์ไฟฟ้าเคมีสูงกว่า) คือ บริเวณชั้นเคลือบ แสดงลักษณะการกัดกร่อนดังรูปที่ 4.8 (ข) ซึ่งความรุนแรงของการกัดกร่อนแบบแกลแวนิกจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเกมี ถ้า แตกต่างกันมากอัตราการกัดกร่อนก็จะสูงตามไปด้วย



รูปที่ 4.8 แผนภาพแสดงการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC (Lillard, R. S., Butt, D.P., Taylor, T.N., Walter, K.C., and Nastasi, M., 1997; Liu, C., Hu, D., Xu, J., Yang, D., Qi, M., 2006)

4.4 การบ่งชี้ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิว ด้วยชั้นเคลือบ DLC หลังทดสอบการกัดกร่อน

4.4.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบ ด้วย SEM

้จากรูปที่ 4.9 แสดงร่องรอยการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบด้วย ์ ชั้นเคลือบ DLC (-100DLC และ -1000DLC) และไม่เคลือบ (H13) ในสารละลายโซเคียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำคับ ด้วย SEM ที่กำลังขยาย 1,000X สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 พบว่าพื้นผิวมีร่องรอยการกัดกร่อนที่รุนแรงมากกว่า เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ที่ทุกก่าพีเอชของสารละลาย โดยที่ พีเอช 2 และ 7 มีลักษณะร่องรอยการกัดกร่อนที่ผสมกันระหว่างการกัดกร่อนแบบทั่วไป (general หรือ uniform corrosion) และการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) สำหรับที่พีเอช 10 ้ร่องรอยการกัดกร่อนส่วนใหญ่เป็นการกัดกร่อนแบบทั่วไป โคยปกติเหล็กกล้าเครื่องมือมักแสดง การกัดกร่อนที่ผสมกันระหว่างการกัดกร่อนแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่ เนื่องจากในเหล็กกล้า เครื่องมือที่ธาตุผสม โดยเฉพาะธาตุ โครเมียม ซึ่งธาตุ โครเมียมบางส่วนจะเกิดเป็นฟิล์ม โครเมียม ออกไซด์ (Cr_vO film) ทำหน้าที่ต้านทานการกัดกร่อน โดยการกัดกร่อนแบบทั่วไปมักเกิดขึ้น ้บริเวณรอบ ๆ คาร์ไบด์ที่อยู่ในเนื้อเหล็กกล้าเครื่องมือ และบริเวณที่ไม่มีฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ้สำหรับการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่จะเกิดขึ้นเมื่อฟิล์มโครเมียมออกไซด์บางส่วนมีรูพรุน (porous) หรือรอยแตก (crack) ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่และแบบรูเข็ม (pitting) ต่อไป ในกรณีของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ และ -1000 โวลต์ แสดงร่องรอยการกัดกร่อนคล้ายคลึงกัน โดยที่ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 พีเอช 2 เนื่องจากสารละลายมีสภาวะการกัดกร่อนที่รุนแรง ทำให้ชั้นเคลือบ DLC ส่วนใหญ่หลุด ้ร่อนออกไปก่อนการกัดกร่อนจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่เป็นเนื้อเหล็กกล้า ในทางตรงกันข้ามที่พีเอช 7 และ 10 ซึ่งสารละลายมีสภาวะการกัดกร่อนที่ไม่รุนแรงมาก ดังนั้นการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ้ชั้นเกลือบ DLC จะเกิดขึ้นเฉพาะที่ (localized corrosion) บริเวณที่ชั้นเกลือบมีรูพรนหรือมีรอยแตก ทำให้ชั้นเคลือบ DLC ส่วนใหญ่ยังคงเกาะอยู่บนพื้นผิววัสดุพื้น ในกรณีนี้บริเวณที่ถูกกัดกร่อนจะ ้เป็นบริเวณที่ไม่มีชั้นเคลือบ DLC ปกคลุมอยู่ ซึ่งการกัดกร่อนก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่เป็นเหล็กกล้า ้โดยมีลักษณะร่องรอยการกัดกร่อนเช่นเดียวกันกับเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ถ้าพิจารณาการกัดกร่อนเฉพาะชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบ ผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC พบว่าชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีร่องรอยการ กัดกร่อนที่น้อยกว่าชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ ทุกพีเอชของสารละลาย



รูปที่ 4.9 ลักษณะพื้นผิวที่ถูกกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบ ในสารละลายโซเดียมคลอ ไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ ที่กำลังขยาย 1,000X

4.4.2 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิค X-PEEM

เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการป้อนศักย์ใฟฟ้าใบแอสที่มีต่อพฤติกรรมความ ด้านทานการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ DLC หลังจากทดสอบการกัดกร่อนชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ใฟฟ้าใบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ได้ถูกนำมา วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเทคนิค X-PEEM ซึ่งมีข้อดีคือเป็นเทคนิคที่สามารถเลือกศึกษาและ ถ่ายภาพพื้นผิวที่มีบริเวณแตกต่างกันได้ในระดับนาโนเมตรประกอบกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทางเคมีและ โครงสร้างของพื้นผิวได้ ดังนั้นจึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน ในระดับที่เล็กมาก ๆ เช่น บริเวณที่ถูกกัดกร่อนและบริเวณที่ไม่ถูกกัดกร่อน ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ ความแตกต่างได้จากเทคนิคอื่น

จากการทดสอบการกัดกร่อนตามหลักการไฟฟ้าเกมี พบว่าชิ้นงานที่เคลือบผิวด้วย DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีความต้านทานการกัคกร่อนดีที่สุด รองลงมาเป็น ้ชิ้นงานที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ และชิ้นงานที่ไม่เคลือบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าโครงสร้างที่แตกต่างกันของสัดส่วนระหว่างเพชรต่อแกรไฟต์ของชั้นเคลือบภายใต้ ้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ อาจมีผลต่อพฤติกรรมความต้านทานการกัดกร่อนที่ ต่างกันด้วย จากการทดสอบด้วย X-PEEM ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 4.10 ถึง 4.12 จากรูปแสดงภาพที่ ถ่ายด้วยเทคนิค PEEM และสเปกตรัมของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ภายหลังทคสอบการกัคกร่อนในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่พีเอช 2 ในที่นี้ส่วนผสมทางเคมีของ ชิ้นงานภายหลังทคสอบการกัดกร่อนจะถูกตรวจสอบค้วยเทกนิก μ-XAS แสคงที่ตำแหน่งระคับ พลังงานต่าง ๆ ใด้แก่ ธาตุการ์บอน(C K-edge) ที่ 285 และ 292 อิเล็กตรอนโวลต์ ธาตุออกซิเงน (O K-edge) ที่ 530 และ 539 อิเล็กตรอนโวลต์ และธาตไทเทเนียม (Ti L-edge) ที่ 458 459 463 และ 465 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งค่าระคับพลังงานของธาตเหล่านี้ พบว่าสอคกล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ (Dash R., Chmiola J., Yushin G., Gogotsi Y., Laudisio G., 2006; K. Asokan, S.K. Srivastava, D. Kabiraj, S. Mookerjee, D.K. Avasthi, J.C. Jan, J.W. Chiou, W.F. Pong, L.C. Ting, F.Z. Chien, 2002; Abbas, G.A., Roy, S.S., Papakonstantinou, P., McLaughlin, J.A., 2005; Ahmad, I., Roy, S.S., Maguire, P.D., Papakonstantinou, P., and McLaughlin. J.A., 2005; Kendelewicz, T., Liu, P., Doyle, C.S., Brown G.E. Jr., 2000; P Karlsson, P.G., Richter, J.H., Andersson, M.P., Johansson, M.K.-J., Blomquist, J., Uvdal, P., Sandell, A., 2011; Soriano, L., Sánchez-Agudo, M., Mossanek, R.J.O., Abbate, M., Fuentes, G.G., Bressler, P.R., Alvarez, L., Méndez, J., Gutiérrez, A., and

Sanz, J.M., 2011) จากสเปกตรัมของธาตุการ์บอน (C K-edge) พบว่าชิ้นงานที่เกลือบผิวภายใต้ ้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีลักษณะสเปกตรัมที่แตกต่างจากชิ้นงานที่ถูกเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้า ใบแอส -100 โวลต์ เล็กน้อยคือ นอกจากจะแสดงระดับพลังงานที่ตำแหน่ง 285 และ 292 eV แล้ว ้ยังพบระดับพลังงานที่ตำแหน่ง 289 eV ด้วย โดยระดับพลังงานที่ 285 และ 292 eV นั้นจะบ่งบอก ถึงโครงสร้างของการ์บอนที่เป็นแกรไฟต์ (sp² carbon bonds) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นสเปกตรัมของ ้ธาตุการ์บอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กหรือเป็นการ์บอนที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบ ในขณะที่ระดับพลังงาน ตำแหน่ง 289 eV จะแสดงโครงสร้างของเพชร (sp³ carbon bonds) ซึ่งเป็นลักษณะของชั้นเคลือบ DLC ที่ประกอบด้วยทั้งโครงสร้างของแกรไฟต์และเพชร ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบ ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ เกิดการกัดกร่อนจนกระทั่งชั้นเคลือบได้หลุดลอกไปจนหมด ซึ่งต่างจากชิ้นงานที่ถูกเคลือบภายใต้ศักย์ไฟฟ้าใบแอส -1000 โวลต์ ที่ยังคงเหลือลักษณะของ ้ชั้นเคลือบ DLC อยู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดงพฤติกรรม ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ (ดังผลที่ได้แสดง ้ไว้ก่อนหน้านี้ในการทดสอบการกัดกร่อน) สำหรับสเปกตรัมที่แสดงก่าความเข้มพลังงานของธาตุ ออกซิเจน (O K-edge) พบว่าทั้งสองชิ้นงานมีลักษณะของสเปกตรัมคล้ายกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าธาตุ ออกซิเจนที่ปรากฏขึ้นนั้นอาจเป็นออกซิเจนที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมชั้นเคลือบ DLC หรือ ระหว่างการทดสอบการกัดกร่อนรวมทั้งอาจเป็นออกซิเจนที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเก็บชิ้นงาน ไว้ก่อนทคสอบ x-peem ก็เป็นได้ เนื่องจากออกซิเจนเป็นธาตุที่ไว้ต่อการเข้าทำปฏิกิริยา กับธาตุ ต่าง ๆ ดังนั้นในการทดสอบเกี่ยวข้องกับการหาองค์ประกอบทางเคมีของธาตุ มักจะพบธาตุ ออกซิเจนปรากฏอยู่เสมอ นอกจากนี้พบว่าสเปกตรัมของ O K-edge จากการทคลองมีลักษณะคล้าย กับสเปกตรัมของ O K-edge ในเหล็กออกไซค์หรือแม็กนีไทต์ (Fe₃O4) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kendelewicz, T., Liu, P., Doyle, C.S., Brown G.E. Jr., 2000) อย่างไรก็ดีธาตุเหล็กก็เป็นธาตุที่มัก เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่าย เนื่องจากเป็นธาตุที่มีความสามารถในการคึงดูด (affinity) ที่ดีกับ ้ ธาตุออกซิเจน ดังนั้นถ้ามีออกซิเจนปรากฎอยู่ธาตุเหล็กจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นสารประกอบออกไซด์ สำหรับระดับพลังงานของธาตุไทเทเนียม (Ti L-edge) จะเห็นว่า ์ชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ มีลักษณะของสเปกตรัม Ti L-edge ที่แตกต่างกันคือ ชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ แสดงระดับพลังงานตำแหน่ง ้ของธาตุไทเทเนียมชัดเจน ในทางตรงกันข้ามชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสคง ้ลักษณะของสเปกตรัมของธาตุไทเทเนียมที่ต่ำมากหรืออาจไม่พบธาตุไทเทเนียมเลย เมื่อพิจารณา สเปกตรัมของ Ti L-edge ของชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าใบแอส -100 โวลต์ พบว่าลักษณะของ สเปกตรัมมีความคล้ายคลึงกับสเปกตรัมของ O K-edge ในไทเทเนียมออกไซด์ (Ti₂O₃ และ TiO₂) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Soriano, L., Sánchez-Agudo, M., Mossanek, R.J.O., Abbate, M., Fuentes, G.G., Bressler, P.R., Alvarez, L., Méndez, J., Gutiérrez, A., and Sanz, J.M., 2011) ลักษณะดังกล่าวนี้ก็เช่นเดียวกันกับธาตุเหล็ก เนื่องด้วยธาตุไทเทเนียมก็มีความสามารถในการดึงดูด กับออกซิเจนได้ดีเช่นกันกับธาตุเหล็ก ดังนั้นจึงมักทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นสารประกอบ ไทเทเนียมออกไซด์เสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสเปกตรัมของไทเทเนียมระหว่าง ชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้าใบแอส -100 และ -1000 โวลต์ จึงอาจกล่าวได้ว่าชั้นเคลือบที่ศักย์ไฟฟ้า ใบแอส -100 โวลต์ เกิดการกัดกร่อนจนกระทั่งชั้นเคลือบ DLC หลุดลอกออกไปหรือมีรูพรุนอยู่ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้สัมผัสกับสารละลายและออกซิเจนจนกระทั่งเกิดเป็นสารประกอบ ไทเทเนียมออกไซด์ได้มากกว่าชั้นเคลือบภายใต้ศักย์ไฟฟ้าใบแอส -1000 โวลต์ ดังจะเห็นได้จาก สเปกตรัมของไทเทเนียม

จากการวิเคราะห์พื้นผิวด้วยเทคนิค X-PEEM จะเห็นว่าชิ้นงานที่เคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีลักษณะพื้นผิวที่ยึดเกาะกับพื้น (เหล็กกล้า) ได้ดีกว่า ชั้นเคลือบที่ -100 โวลต์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของชั้นเคลือบ DLC ที่มีสัดส่วนของเพชร ต่อแกรไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ที่แตกต่างกันเนื่องจากการป้อนศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ -100 และ -1000 โวลต์ ให้กับชิ้นงานมีผลต่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกัดกร่อน แต่สิ่งที่ทำให้ชิ้นงานทั้งสอง มีพฤติกรรมความด้านทานการกัดกร่อนที่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติเชิงกลของ ชั้นเคลือบด้วย ได้แก่ แรงยึดเกาะระหว่างชั้นเคลือบกับวัสดุพื้น หรือความหนาแน่นและปริมาณ รูพรุน ด้วยสาเหตุนี้ในอนากตอาจจะมีการทดสอบในส่วนของคุณสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบ DLC เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา ชั้นเคลือบ DLC ต่อไป



รูปที่ 4.10 สเปกตรัม XAS ของ C K-edge ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนในสารละลาย โซเดียมกลอไรค์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2



รูปที่ 4.11 สเปกตรัม XAS ของ O K-edge ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2



รูปที่ 4.12 สเปกตรัม XAS ของ Ti *L*-edge ของชิ้นงานเหล็กกล้าที่เคลือบด้วยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์ ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะการทดลองต่อไป

5.1 สรุป

การวิจัยครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างชั้นเกลือบ DLC ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ศักย์ไฟฟ้าไบแอสด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโธคิกอาร์กในระบบสุญญากาศ ซึ่งอัตราส่วนของพันธะ และโครงสร้างของชั้นเคลือบถูกตรวจสอบด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี สเปกโตรสโกปีของ อนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอ็กซ์ เอ็กซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกปี และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด จากการทคลองการกัดกร่อน พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าไบแอส และค่า พีเอช (พีเอช 2 7 และ 10) ของสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ที่ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก มีผลต่อพฤติกรรมกัดกร่อนของชิ้นงานเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 และเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติล้ายเพชร ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

H13 ที่เกิดขบผวด วิชานิเกิดขบทาวบอนที่มีถุมบิติดายเพชร ซึ่งสามารถสรุบ เจ็ก วามสากญู เคดงน 5.1.1 เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย DLC และไม่เคลือบผิว มีพฤติกรรม ทางด้านการกัดกร่อนเปลี่ยนตามค่าศักย์ไฟฟ้าไบแอส และพีเอชของสารละลาย (พีเอช 2 7 และ 10)

5.1.2 จากรามานสเปกโตรสโกปี XPS และ X-PEEM บ่งบอกว่าศักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้นเคลือบ ซึ่ง XPS แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีสัดส่วนระหว่างเพชร ต่อกราฟไฟต์สูงถึง 86 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก นอกจากนี้ ผลจาก X-PEEM ยังชี้ให้เห็นว่าชั้นเคลือบ DLC นอกจากประกอบด้วยโครงสร้างการ์บอนอสัณฐานระหว่างเพชรและกราฟไฟต์แล้วยังมื องค์ประกอบของออกซิเจนรวมถึงไฮโครเจนอยู่ด้วย

5.1.3 เหล็กกล้าเกรื่องมือ H13 ที่เกลือบผิวด้วย DLC มีความต้านทานการกัดกร่อนได้ ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เกลือบผิว ที่ทุกก่าพีเอชของสารละลาย

5.1.4 ชั้นเคลือบ DLC ที่ถูกเคลือบภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ แสดง พฤติกรรมความด้านทานการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นด์ โดยน้ำหนัก ได้ดีที่สุดในทุกก่าพีเอชของสารละลาย รองลงมาเป็นชั้นเคลือบ DLC ที่ถูกเคลือบ ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบผิว ตามลำดับ 5.1.5 จาก SEM พบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC มีพื้นผิว ที่ถูกกัดกร่อนต่ำกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบทุกค่าพีเอช โดยชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -1000 โวลต์ มีร่องรอยการกัดกร่อนต่ำที่สุด รองลงมาเป็นชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 โวลต์ และสุดท้ายเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ไม่เคลือบ ตามลำดับ

5.1.6 จากเทคนิค X-PEEM พบว่าสเปกตรัมของ O K-edge และ Ti L-edge ที่วัดได้เป็น สเปกตรัมของผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนได้แก่ สารประกอบ Fe₃O₄ Ti₂O₃ และ TiO₂ ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทดลองต่อไป

จากการทดลองครั้งนี้ พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย DLC และไม่ เคลือบผิวมีพฤติกรรมทางการกัดกร่อนที่แตกต่างกันเกิดจากหลายปัจจัย เช่น สภาวะความเป็นกรด กลาง และด่างของสารละลาย รวมถึงศักย์ไฟฟ้าไบแอส โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวควบคุม พฤติกรรมทางด้านการกัดกร่อน ซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์ผลอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แต่จาก ข้อมูลที่ได้เป็นการศึกษาวิจัยเบื้องต้น ดังนั้นควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อสามารถนำไปใช้งานใน ภากอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการทดลองดังนี้

(1) ควรมีการทดสอบชั้นเคลือบ DLC ภายใต้ศักย์ไฟฟ้าไบแอสเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ที่ได้ศึกษาไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ (ศักย์ไฟฟ้าไบแอส -100 และ -1000 โวลต์) ยกตัวอย่างที่ -200
 -400 -600 และ -800 โวลต์ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรมทางด้านการกัดกร่อนต่อการ เปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าไบแอส

(2) ควรมีการทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น ความสามารถในการยึดเกาะและความ ด้านทานการเสียดสีรวมทั้งอัตราการสึกหรอของชั้นเคลือบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อการ ประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมเคลือบผิวและทางด้านการกัดกร่อนต่อไป

รายการอ้างอิง

- Abbas, G.A., Roy, S.S., Papakonstantinou, P., and McLaughlin, J.A. (2005). Structural investigation and gas barrier performance of diamond-like carbon based films on polymer substrates. **Carbon**. 43: 303-309.
- Ahmad, I., Roy, S.S., Maguire, P.D., Papakonstantinou, P., and McLaughlin. J.A. (2005) Effect of substrate bias voltage and substrate on the structural properties of amorphous carbon films deposited by unbalanced magnetron sputtering. **Thin Solid Films**. 482: 45-49.
- Anders, A., Brown, I.G., MacGill, R.A., and Dickinson, M.R. (1998). 'Triggerless' triggering of vacuum arcs. Journal of Physics D: Applied Physics. 31: 584.
- Anders, A., MacGill, R.A., and McVeigh, T.A. (1999). Efficient, compact power supply for repetitively pulsed, "triggerless" cathodic arcs. Review of Scientific Instruments. 70: 4532.
- Anders, A., Yotsombat, B., and Binder, R. (2001). Correlation between cathode properties, burning voltage, and plasma parameters of vacuum arcs. Journal of Applied Physics. 89: 7764.
- Anders, A., (2000). Handbook of plasma immersion ion implantation and deposition. John-Wiley& Sons. Unites states of America.
- Anders, A., (2008). Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) In Cathodic Arcs. From Fractal Spots to Energetic Condensation (pp. 445-447). New York: Springer Science+Business Media. LLC.
- Anders, A., (2008). Case study: Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) In Cathodic Arcs. From Fractal Spots to Energetic Condensation (pp. 394-399). New York: Springer Science+Business Media. LLC.
- Asokan, K., Srivastava, S.K., Kabiraj, D., Mookerjee, S., Avasthi, D.K., Jan, J.C., Chiou, J.W., Pong, W.F., Ting, L.C., and Chien, F.Z. (2002). Study of ion beam mixing in C/Si multilayers by X-ray absorption spectroscopy. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 193: 324-328.
- Bannister, K.E. (1996). Lubrication Theory. In Lubricant for industry. (pp. 9-19). New York: Industrial Press Inc.
- Bannister, K.E. (1996). Oil and Grease. In Lubricant for industry. (pp. 33-59). New York: Industrial Press Inc.
- Brown, I.G. (1994). Vacuum arc ion sources. Review of Scientific Instruments. 65(10): 3061.
- Caminha, I., Zeng, C., Paes, M.P., Monteiro, M.J., and Rizzo, F. (2004). Corrosion resistance of a steel under an oxidizing atmosphere in a fluid catalytic cracking regenerator. Materials Research. 7(1): 183-188.
- Dash R., Chmiola J., Yushin G., Gogotsi Y., and Laudisio G. (2006). Titanium Carbide Derived Nanoporous Carbon for Energy-Related Applications. **Carbon**. 44(12): 2489-2497.
- DLC Coatings-Diamond-Like Carbon. (2010). Richter Precision Inc. [Online]. Available: http://www.richterprecision.com/dlc-coatings.html
- Fontana, M.G. (1987). Corrosion Engineering. 3rd Edition. McGraw-Hill Book Company. Singapore.
- Fung, M.K., Lai, K.H., Lai, H.L., Chan, C.Y., Wong, N.B., Bello, I., Lee, C.S., Lee, S.T. (2000).
 Diamond-like carbon coatings applied to hard disks. Diamond and Related Materials.
 9: 815-818.
- Grill, A., (1999). Diamond-like carbon: state of the art. Diamond and Related Materials. 8: 428-434.
- Gunther, S., Kaulich, B., Gregoratti, L., Kiskinova, M. (2002). Progress in Surface Science. (70): 187-260.
- Hantzsche, E. (1991). Theory of the expanding plasma of vacuum arcs. Journal of Physics D: Journal of Physics D: Applied Physics. 24: 1339.

Hot Work Steel. (2010). ThyssenKrupp Materials (Thailand) Co., Ltd. [On-line]. Available: http://www.thyssenkruppmaterials.co.th/content/view/77/96/

Huang, G.F., Lingping, Z., Weiqing, H., Lihua, Z., Shaolu, L., and Deyi, L. (2003). The mechanical performance and anti-corrosion behavior of diamond-like carbon film.
Diamond and Related Materials. 12: 1406-1410.

- Jimenez, Sutherland, D.G.J., Buuren, T.V., Carlisle, J.A., Terminello, L.T., and Himpsel, F.J. (1998). Photoemission and x-ray-absorption study of boron-carbide and its surface thermal-stability. Physical review. B, Condensed matter. 57(20): 13167-13174.
- Karlsson, P.G., Richter, J.H., Andersson, M.P., Johansson, M.K.-J., Blomquist, J., Uvdal, P., and Sandell, A. (2011). TiO₂ chemical vapor deposition on Si (111) in ultrahigh vacuum: Transition from interfacial phase to crystalline phase in the reaction limited regime.
 Surface Science. 605: 1147-1156.
- Kendelewicz, T., Liu, P., Doyle, C.S., Brown G.E. Jr. (2000). Spectroscopic study of the reaction of aqueous Cr (VI) with Fe3O4 (111) surfaces. **Surface Science**. 469: 144-163.
- Lattemann, M., Ehiasarian, A.P., Bohlmark, J., Persson, P.Å.O., and Helmersson, U. (2006). Investigation of high power impulse magnetron sputtering pretreated interfaces for adhesion enhancement of hard coatings on steel. Surface and Coatings Technology. 200: 6495-6499.
- Li, K.Y., Zhou, Z.F., Chan, C.Y., Bello, I., Lee, C.S., and Lee, S.T. (2001).Mechanical and tribology properties of diamond-like carbon films prepared on steel by ECR-CVD process. **Diamond and Related Materials**. 10: 1855-1861.
- Li, K.Y., Zhou, Z.F., Chan, C.Y., Bello, I., Lee, C.S., and Lee, S.T. (2005). Study of tribological performance of ECR–CVD diamond-like carbon coatings on steel substrates. Part 1. The effect of processing parameters and operating conditions. **Wear**. 258: 1577-1588.
- Lillard, R. S., Butt, D.P., Taylor, T.N., Walter, K.C., and Nastasi, M. (1997). The breakdown mechanism of diamond-like carbon coated nickel in chloride solution. Corrosion Science. 39(9): 1601-1624.
- Liu, C., Hu, D., Xu, J., Yang, D., and Qi, M. (2006). In vitro electrochemical corrosion behavior of functionally graded diamond-like carbon coatings on biomedical Nitinol alloy. Thin Solid Films. 496: 457-462.
- Lu, Z.G., Chung, C.Y., (2008). Electrochemical characterization of diamond like carbon thin films. Diamond and Related Materials. 17: 1871-1876.
- Lung, B.H., Chiang, M.J., Hon, M.H. (2001). Effect of gradient a-SiCx interlayer on adhesion of DLC films. Materials Chemistry and Physics. 72: 163-166.

- Marciano, F.R., Almeida, E.C., Bonetti, L.F., Corat, E.J., and Trava-Airoldi, V.J. (2010). Improvement of diamond-like carbon electrochemical corrosion resistance by addition of nanocrystalline diamond. Journal of Colloid and Interface Science. 342: 636-637.
- Marques, F.C., Lacerda, R.G., and Champi, A., (2003). Thermal expansion coefficient of hydrogenated amorphous carbon. **Applied Physics Letters**. (83): p.15
- Martin, P.J., and Bendavid, A. (2001). Review of the filtered vacuum arc process and materials deposition. **Thin Solid Films**. 394: 1-15.
- Nanotechnology equipment. (2010). Made in Zelenograd. [Online]. Available: http://www.made-in-zelenograd.com/products/mvu-tm-izophase-cvd-icp/
- Robert, G.A. (1998). Tool Steels. 5th Edition. Materials Park, OH: ASM International. United States of America.: 364.
- Robertson, J. (2002). Diamond-like amorphous carbon. Materials Science and Engineering. Report: A Review Journal. R 37: 129-281.
- Sanders, D.M., and Anders, A. (2000). Review of cathodic arc deposition technology at the start of the new millennium. **Surface and Coatings Technology**. 133-134: 78-90.
- Schulke, T., Witke, T., Scheibe, H.J., Siemroth, P., Schultrich, B., Zimmer, O., and Vetter, J. (1999). Comparison of DC and AC arc thin film deposition techniques. Surface and Coatings Technology. 120-121: 226-232.
- Sedriks, A.J. (1996). Corrosion of Stainless Steels. 2nd Edition. John-Wiley & Sons. New York.
- Soriano, L., Sánchez-Agudo, M., Mossanek, R.J.O., Abbate, M., Fuentes, G.G., Bressler, P.R., Alvarez, L., Méndez, J., Gutiérrez, A., and Sanz, J.M. (2011). Interface effects in the electronic structure of TiO₂ deposited on MgO, Al₂O₃ and SiO₂ substrates. Surface Science. 605: 539-544.
- Strondl, C., Carvalho, N.M., De Hosson, J.Th.M., and Van der Kolk, G.J., (2003). Investigation on the formation of tungsten carbide in tungsten-containing diamond like carbon coatings. Surface and Coatings Technology. 162: 288-293.
- Sui, J., and Cai, W. (2006). Mechanical properties and anti-corrosion behavior of the diamondlike carbon films. Surface and Coatings Technology. 201: 1323-1327.
- Sui, J., and Cai, W. (2007). Mechanical and corrosion study of diamond-like carbon coating on NiTi alloys. Surface and Coatings Technology. 201: 5121-5123.

- Surface Modification Technology. Ion Beam Deposited Deposition. (2010). Spire Biomedical. [Online]. Available: http://www.spirecorp.com/spire-biomedical/surface-modificationtechnology/ion-beam-assisted-deposition.php
- Weng, K.W., Hen, S., Chen, Y.C., and Wang, D.Y. (2009). Characterization of tungsten-titanium oxide electrode for electrochromic applications. Applied Surface Science. 255: 3848-3853.
- Wu, J.B., Chang, J.J., Li, M.Y., Leu, M.S., and Li, A.K. (2007). Characterization of diamond-like carbon coatings prepared by pulsed bias cathodic vacuum arc deposition. Thin Solid Films. 516: 243-247.
- Wei, C., and Yen, J.Y. (2007). Effect of film thickness and interlayer on the adhesion strength of diamond like carbon films on different substrates. Diamond and Related Materials. 16: 1325-1330.



ภาคผนวก ก

การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบผิว

การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนของ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบผิว

ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนสามารถหาได้ โดยใช้ซอฟแวร์ฟิตค่าอัตราการกัดกร่อน (corrosion rate, fit) ของ Metrohm Autolab ซึ่งเป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่อง AUTOLAB PGSTAT 302H โดยมีหลักคือ ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน ทดสอบที่ใช้ในการคำนวณ หลังจากนั้นเลือกจุด 2 จุดที่อยู่บนเส้นโค้งโพลาไรเซชัน ซึ่งจะต้องเลือก ช่วงที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง (เพื่อจะได้ก่าที่แม่นยำมากที่สุด) ดังแสดงในรูปที่ ก.1 ซึ่งแสดงเส้นโค้ง โพลาไรเซชันช่วงที่เกิดปฏิกิริยาแอโนดและช่วงที่เกิดปฏิกิริยาแคโทด เมื่อกำหนดจุดเสร็จแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณหาค่าความชัน โดยสังเกตเห็นว่าเส้นความชันของปฏิกิริยาแอโนดจะตัด กับเส้นความชันของปฏิกิริยาแคโทด ตรงจุดนี้ค่าความชันของทั้งสองเส้นจำเป็นต้องเท่ากันจึงทำให้ จุดนี้เป็นจุดที่ใช้ในการหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน หลังจากได้ก่าทั้ง สองแล้วซอฟแวร์จะทำการคำนวณหาค่าอัตราการกัดกร่อนให้



รูปที่ ก.1 วิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดร่อนจาก เส้นโค้งโพลาไรเซชัน

การหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร

การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนสามารถหาได้จากซอฟแวร์ฟิตค่าอัตราการกัดกร่อน ซึ่งมี ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณร่วมกัน เช่น น้ำหนักสมมูลของโลหะ (equivalent weight [g/mol]) และค่าความหนาแน่นของโลหะ (density [g/cm³]) ที่ใช้ในการทดสอบและค่าพื้นผิวที่สัมผัสกับ สาระลายกัดกร่อน (surface area [cm²]) โดยค่าอัตราการกัดกร่อนจะแสดงผลในหน่วยมิลลิเมตรต่อ ปี (corrosion rate [mm/year])) นอกจากนี้การคำนวณจะต้องคำนึงถึงค่าน้ำหนักกรัมสมมูลและ ความหนาแน่นของโลหะด้วย โดยแสดงค่าเหล่านี้ในตารางที่ ก.1 สำหรับค่าอัตราการกัดกร่อนที่ได้ จากการคำนวณของชิ้นงานทั้งหมดที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนแสดงดังตารางที่ ก.2

ตารางที่ ก.1 ก่าน้ำหนักกรัมสมมูลและความหนาแน่นของเหล็กกล้าเกรื่องมือ AISI H13 และ ชั้นเกลือบ DLC

ชิ้นงาน	น้ำหนักสมมูล (<i>EW, g/mol</i>)	ความหนาแน่น (ρ, g/cm³)
H13	28.37	7.87
DLC	3.05	2.27

ตารางที่ ก.2 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบผิว ในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2

ชิ้นงาน	E_{corr} (mV)	$i_{corr}(A/cm^2)$	R _{mmpy} (mm/year)
Uncoated H13	-518.290	37.08×10^{-6}	0.449
-100V DLC coated	-550.100	20.38×10^{-6}	0.090
-1000V DLC coated	-641.200	18.50×10^{-6}	0.081

ตารางที่ ก.3 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้ำเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และ ไม่เคลือบผิว ในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7

ชิ้นงาน	E_{corr} (mV)	$i_{corr}(A/cm^2)$	R _{mmpy} (mm/year)
Uncoated H13	-566.460	3.18×10^{-6}	0.037
-100V DLC coated	-521.360	1.12×10^{-6}	0.090
-1000V DLC coated	-493.790	0.90×10^{-6}	0.005

ตารางที่ ก.4 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ DLC และไม่เคลือบผิว ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 10

ชิ้นงาน	E_{corr} (mV)	$i_{corr}(A/cm^2)$	R _{mmpy} (mm/year)
Uncoated H13	-571.610	3.60×10^{-6}	0.042
-100V DLC coated	-533.800	1.18×10^{-6}	0.009
-1000V DLC coated	-546.250	1.15×10^{-6}	0.005

ร_{ัราวั}กยาลัยเทคโนโลยีสุรบา

ภาคผนวก ข

เทคนิคการอาร์กในระบบสุญญากาศและขั้นตอนการเคลือบชั้นเคลือบ DLC ด้วยเทคนิคฟิลเตอร์คาโชดิกอาร์กในระบบสุญญากาศ

เทคนิคการอาร์กในสุญญากาศ

การอาร์กในสุญญากาศ (vacuum arc) คือการปลดปล่อยพลาสมา (plasma discharge) ที่ เกิดขึ้นจากการอาร์กระหว่างสองอิเล็กโทรด (คาโธดและแอโนด) ในระบบสุญญากาศ (Brown, I.G., 1994) ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งที่คาโธดและแอโนด ถ้ากระบวนการแตกตัวของอะตอมหรือ โมเลกุลเป็นไอออน (ionization) เกิดที่พื้นผิวของคาโธด ถูกเรียกว่า คาโธดิกอาร์ก ในทางตรงกัน ข้ามถ้าพลาสมาถูกสร้างที่ผิวของแอโนด จะถูกเรียกว่า แอโนดิกอาร์ก ในทางปฏิบัติกาโธดิกอาร์ก จะให้พลาสมาที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการเกิดพลาสมาได้ง่าย ส่งผลให้ถูกใช้เป็นส่วน ใหญ่ในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว

เทกนิกการอาร์กในสุญญากาศและกาโธดิกอาร์กมีความแตกต่างกันอยู่บ้างได้แก่ การเกิด พลาสมาของเทกนิกการอาร์กในสุญญากาศจะเกิดอยู่ในระบบสุญญากาศที่ไม่มีองก์ประกอบของ ก๊าซเข้าร่วมทำปฏิกิริยา ส่วนเทกนิกกาโธดิกอาร์กอาจมีองก์ประกอบของก๊าซต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ในระบบด้วย โดยทั่วไปเป็นก๊าซที่ใช้เพื่อจุดประสงก์ในการเปลี่ยนแปลงกุณสมบัติของชั้นเกลือบ ทั้งทางกายภาพและทางกล ตัวอย่างเช่น ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน มักถูกใช้เพื่อต้องการให้ได้ ชั้นเกลือบที่เป็นสารประกอบของไนตรายด์หรือออกไซด์ บ่อยกรั้งอาจพบว่ามีการเรียกสลับกันอยู่ ระหว่างเทกนิกการอาร์กในสุญญากาศและกาโธดิกอาร์ก

พื้นผิวของกาโธดที่ถูกอาร์กในกาโธดิกอาร์กจะมีกระแสไฟฟ้าความเข้มกระแสสูงเกิดขึ้น เป็นจุดเล็กๆ แยกกันอยู่ทั่วบริเวณ เรียกจุดนี้ว่า จุดอาร์กบนกาโธด (cathode spot) ซึ่งเป็นจุดที่ พลาสมาถูกสร้างขึ้นผ่านการกลายเป็นไอและการแตกตัวเป็นไอออน ขณะที่แอโนดกระทำตัวเป็น เพียงส่วนขยายและยุบตัวให้พลาสมาเท่านั้น (Hantzsche, E., 1991) เมื่อจุดอาร์กบนกาโธดเกิดขึ้นจะ ปล่อยแสงสว่างออกมาเล็กน้อยที่พื้นผิวของกาโธด ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันที่กระแสจากกาโธดถูก ส่งผ่านไปทางลำของการอาร์ก (arc column) จุดอาร์กบนกาโธดแต่ละจุดมีระยะเวลาเกิดขึ้นสั้นๆ ประมาณ 10 นาโนวินาที ถึงประมาณ 1 ไมโครวินาที หลังจากนั้นจุดอาร์กบนกาโธดจุดใหม่ก็จะ เกิดขึ้นที่บริเวณขอบของจุดอาร์กบนกาโธดจุดเดิมแล้วเกลื่อนที่ข้ามไปเรื่อย ๆ บนพื้นผิวของกาโธด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวกาโธด เช่น มีลักษณะแหลมหรือยื่น ออกจากระนาบพื้นผิว มักเป็นจุดที่มีแนวโน้มเป็นจุดอาร์กบนกาโธดจุดต่อไป

พื้นผิวของคาโธคในบริเวณที่เป็นจุดอาร์กบนคาโธดจะมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าอุณหภูมิจุด เดือด (boiling temperature) ของโลหะ โดยความดันและความหนาแน่นของพลาสมาภายในจุด อาร์กบนคาโธดจะมีค่าสูง (ถึง 10⁵ บาร์) ด้วยความแตกต่างของความดันระหว่างจุดอาร์กบนคาโธด และบริเวณรอบๆ นี้เองเป็นเหตุให้เกิดพลาสมาขึ้นที่พื้นผิวของคาโธดก่อนที่จะขยายออกไปยัง แอโนดและผนังรอบข้าง

ถ้าเปรียบเทียบกับเทคนิคพลาสมาอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบของก๊าซเกี่ยวข้องแล้ว พบว่า พลาสมาที่ได้จากเทคนิคคาโชดิกอาร์กเกือบทั้งหมดจะแตกตัวเป็นไอออนและยังมีความหลากหลาย ทางสถานะของประจุ (charge state) ที่มากกว่าด้วย โดยทั่วไปโลหะที่มีจุดเดือดต่ำมักมีสถานะของ ประจุเฉลี่ยที่ต่ำ

ศักย์ไฟฟ้าในการอาร์ก (arc voltage) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้การอาร์กเกิดขึ้น ถูกเรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าในการเผาไหม้ (burning voltage) โดยทั่วไปมีก่าอยู่ในช่วง 10 ถึง 30 โวลต์ อาจ เปลี่ยนแปลงสอดกล้องกับวัสดุที่ใช้เป็นกาโธด (Anders, A., Yotsombat, B., and Binder, R., 2001) แรงดันหรือศักย์ไฟฟ้าในการเผาไหม้มักถูกใช้เพื่ออ้างถึงการลดลงของศักย์ไฟฟ้าบริเวณใกล้กับ พื้นผิวของกาโธด กระแสที่ต่ำสุดที่จะทำให้เกิดจุดอาร์กบนกาโธด ถูกเรียกว่า chopping current (Anders, A., Yotsombat, B., and Binder, R., 2000) เมื่อกระแสที่ทำให้เกิดจุดอาร์กบนกาโธดมีก่า มากเกินก่าวิกฤตแล้วจะส่งผลให้บริเวณแอโนคมีกวามร้อนสูงและเปลี่ยนเป็นจุดอาร์กบนแอโนด (anode spot) ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดจุดอาร์กบนแอโนดจำเป็นต้องติดตั้งระบบ หล่อเย็นให้กับแหล่งกำเนิดกาโธดิกอาร์ก (cathodic arc source)

คาโชดิกอาร์กแบบกระแสตรงและพัลส์

เราทราบว่าพลาสมาที่เกิดขึ้นในเทคนิคคาโธดิกอาร์กถูกสร้างที่พื้นผิวของคาโธดบริเวณที่ เรียกว่าจุดอาร์กบนคาโธดแต่ปัญหาที่มักพบคือความยากในการเริ่มต้นของจุดอาร์กบนคาโธดจุด แรกก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลาสมา ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีที่ประสบความสำเร็จในการจุด ประกายไฟ (triggering) หรือเริ่มทำให้เกิดจุดอาร์กบนคาโธด สำหรับเทคนิคคาโธดิกอาร์กวิธีที่ใช้ ส่วนมากได้แก่ การจุดประกายไฟทางกล (mechanical trigger) การจุดประกายไฟด้วยศักย์ ไฟฟ้าแรงสูง (high-voltage surface discharge or surface flashover) การจุดประกายไฟด้วยเลเซอร์ (laser trigger) เป็นต้น (Anders, A., 2000)

เทคนิคคาโธดิกอาร์กสามารถทำงานได้ทั้งแบบพัลส์ (pulse) และกระแสตรง (direct current, DC) หรือแบบต่อเนื่อง (continuous) (Martin, P.J., and Bendavid, A., 2001; Sanders, D.M., and Anders, A., 2000) กำลังเฉลี่ยที่ให้กับแหล่งกำเนิดอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 ถึง 3 วัตต์ (การ ทำงานแบบพัลส์ที่ "low arc-pulse duty cycle") จนถึงหลายกิโลวัตต์ (กระแสตรงหรือ พัลส์กระแส สูงทำงานที่รอบการทำงานสูง "high duty cycle") ในกรณีของคาโธดิกอาร์กที่ทำงานแบบ กระแสตรงหรือพัลส์ยาว (long-pulse) โคยปกติจะมีสนามแม่เหล็กชี้นำ (magnetic steering) เพื่อนำ ทางการเกลื่อนที่ของจุดอาร์กบนคาโชดขณะที่ในพัลส์สั้น (short-pulse) จะไม่มี (ไม่จำเป็นต้องมี) ลักษณะเช่นนี้

แหล่งกำเนิดกาโธดิกอาร์กแบบกระแสตรงปกติทำงานที่กระแสตั้งแต่ 30 ถึง 300 แอมแปร์ ในทางตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดกาโธดิกแบบพัลส์จะทำงานเป็นพัลส์ที่ช่วงสั้น ๆ ของการจ่าย กระแสสูงถึง 5000 แอมแปร์ (Schulke, T., Witke, T., Scheibe, H.J., Siemroth, P., Schultrich, B., Zimmer, O., and Vetter, J., 1999) กาบเวลา (pulse duration) ของพัลส์ที่ใช้ในกาโธดิกอาร์กโดย พื้นฐานตั้งแต่ 100 นาโนวินาที ถึง 5 ไมโครวินาที ดังนั้นจุดอาร์กบนกาโธดจะเคลื่อนที่และเลื่อนไป ด้วยตัวของมันเองบนพื้นผิวของกาโธด ซึ่งทำให้เทกนิกกาโธดิกอาร์กแบบพัลส์ไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ ใช้เพื่อชื้นำทางการเกลื่อนของจุดอาร์กบนกาโธดเหมือนเช่นเทกนิกกาโธดิกอาร์กแบบกระแสตรง

การตัดสินใจเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบกระแสตรงหรือแบบพัลส์หลัก ๆ ขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งระบบกระแสตรงสามารถที่จะให้อัตราการเคลือบที่สูงมากกว่า ดังนั้น จะเหมาะกับการเคลือบขึ้นงานขนาดใหญ่และต้องการชั้นเคลือบที่หนา ซึ่งไม่ต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการลดหรือการกำจัดอนุภาคระดับไมโครเมตร (macroparticles) โดยแท้จริงแล้วในเชิงพาณิชย์ ทุกวันนี้จะใช้กาโธดิกอาร์กที่เป็นระบบกระแสตรง สำหรับระบบพัลส์มีอัตราการเคลือบที่ช้ากว่า เนื่องจากรอบการทำงาน (duty cycle) ที่ต่ำ แต่ข้อดีของการทำงานแบบพัลส์คือไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องทำความเย็นที่ดีมากเหมือนกับระบบกระแสตรง

เทคนิคแหล่งกำเนิดคาโธดิกอาร์กแบบพัลส์ส่วนใหญ่ขั้นตอนการเริ่มต้นการอาร์กจะ ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การจุดประกายไฟด้วยศักย์ไฟฟ้าแรงสูง (high-voltage surface flashovers triggering) และการจุดประกายไฟด้วยศักย์ไฟฟ้าแรงต่ำ (low-voltage "triggerless") (Anders, A., Brown, I.G., MacGill, R.A., and Dickinson, M.R., 1998; Anders, A., MacGill, R.A., and McVeigh, T.A., 1999) high-voltage surface flashovers triggering เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมากวิธีหนึ่ง สำหรับวัสดุกาโธดส่วนใหญ่ ซึ่งในการใช้งานต้องการระบบ ศักย์ไฟฟ้าบวกแรงสูงแบบพัลส์ (positive high-voltage pulse) (~10 กิโลโวลต์ หรือมากกว่า) เพื่อจุดประกายไฟให้อิเล็กโทรดซึ่งถูก แยกด้วยช่องว่างของฉนวนจากกาโธดโดยความเข้มสูงของสนามไฟฟ้ารอบๆ ฉนวนที่เกิดจากการ จ่ายเข้าไปจะทำให้บริเวณพื้นผิวของฉนวนดังกล่าวทำหน้าที่กล้ายเป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เป็น จุดเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นการเกิดจุดอาร์กบนกาโธด

วิธีศักย์ไฟฟ้าแรงต่ำไม่จำเป็นต้องใช้ระบบจุดประกายไฟในการเริ่มต้นการอาร์ก ซึ่งถูก เรียกว่า triggerless ในที่นี้ประกอบไปด้วยชั้นเคลือบตัวนำโดยเฉพาะชั้นเคลือบของวัสดุที่เป็น กาโธดเองซึ่งถูกเคลือบบนฉนวนที่ทำหน้าที่แยกกาโธดและแอโนดออกจากกัน หลังจากศักย์ไฟฟ้า ในการอาร์กถูกจ่ายไปที่คาโธด (โดยปกติจะอยู่ประมาณ 100 ถึงหลายร้อยโวลต์) พลาสมาจะเริ่ม เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างชั้นเคลือบตัวนำกับคาโธด ด้วยสาเหตุจาก Joule ohmic heating วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายและน่าเชื่อถือมากเช่นกันสำหรับวัสดุคาโธดส่วนใหญ่ โดยกำลังที่ใช้ในการ อาร์กสำหรับการทำงานของการจุดประกายไฟจะอยู่บนพื้นฐานของ thyristor-switched pulsed forming network (Anders, A., MacGill, R.A., and McVeigh, T.A., 1999)

อัตราการเกลือบเฉลี่ยของระบบพัลส์สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้กระแสในการอาร์กสูง ขึ้นในช่วงกิโลแอมแปร์และการทำงานที่ความถี่ของพัลส์และรอบการทำงานสูงขึ้น

แหล่งกำเนิดกาโซดิกอาร์กแบบพัลส์ถูกใช้อย่างกว้างขว้างในงานวิจัย เนื่องจากมีข้อดีบาง ประการที่เหนือกว่าระบบกระแสตรง (Schulke, T., Witke, T., Scheibe, H.J., Siemroth, P., Schultrich, B., Zimmer, O., and Vetter, J., 1999) ได้แก่การทำงานของระบบพัลส์สามารถเพิ่ม กุณสมบัติของชั้นเคลือบและสามารถควบคุมคุณสมบัติของชั้นเคลือบได้มากกว่าการทำงานระบบ กระแสตรง ยกตัวอย่างเช่น ชั้นเคลือบการ์บอนอสัณฐาน (amorphous carbon) ที่ได้จากการเคลือบ ด้วยระบบคาโซดิกอาร์กพลาสมาแบบ pulsed มีแนวโน้มที่จะได้ปริมาณโครงสร้างของเพชร (sp³ carbon bonds) สูงกว่าการเคลือบด้วยระบบกระแสตรง (Sanders, D.M., and Anders, A., 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบพัลส์จะให้คุณสมบัติของชั้นเคลือบที่ดีมากเมื่อชั้นเคลือบที่ต้องการเป็นชั้น เคลือบที่มีความบางมาก (ultra thin film)

ตัวกรองอนุภาคระดับไมโครเมตร

เนื่องด้วยธรรมชาติในการเกิดพลาสมาของกระบวนการกาโธดิกอาร์กที่จุดอาร์กบนคาโธด จะมีความร้อนสูงมากจนกระทั่งเกิดการหลอมเหลวของโลหะหลอมเหลวแล้วถูกผลักออกมาเป็น อนุภาคขนาดเล็กๆ ก่อนเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่ารอบข้างแล้วแข็งตัวอย่างฉับพลันเป็นเศษอนุภาค ของแข็งขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมโครเมตร ถึงประมาณ 100 ไมโครเมตร โดยอนุภาคของแข็งนี้เกิดขึ้น ปริมาณต่ำในโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง ซึ่งอนุภาคของแข็งนี้โดยปกติถูกกล่าวถึงเป็น อนุภาค ระดับไมโครเมตร "macroparticles" เนื่องจากมีขนาคระดับไมโครเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด อนุภาคไอออนของพลาสมา โดยอนุภาคระดับไมโครเมตรจะถูกสร้างขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพลาสมากับของแข็งที่จุดอาร์กบนคาโธดซึ่งส่งผลกระทบต่อสมบัติของพื้นผิวชั้นเคลือบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการนำชั้นเคลือบไปใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์และออปติคอล ด้วยเหตุผล นี้ทำให้จำเป็นต้องกำจัดอนุภาคระดับไมโครเมตร โดยทั่วไปจะใช้ตัวกัดแยกอนุภาคระดับ ไมโครเมตร ซึ่งถูกเรียกว่า ตัวกรองอนุภาคระดับไมโครเมตร (macroparticle filter)

วัตถุประสงค์หลักของตัวกรองอนุภาคระดับไมโครเมตรเพื่อป้องกันเส้นทางในการตก กระทบ (line-of-sight) ของอนุภาคระดับไมโครเมตรและเพื่อนำทางพลาสมาไปยังวัสดุพื้น (substrate) ซึ่งทิศทางของพลาสมาสามารถควบคุมได้โดยการใช้ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ถูก เรียกว่า ด้วกรองแบบสนามแม่เหล็ก (magnetic filtering) โดยตัวกรองแบบสนามแม่เหล็กที่ถูกใช้ เป็นส่วนมากในระบบคาโธดิกอาร์กเพื่อกำจัดอนุภาคระดับไมโครเมตรมีลักษณะเป็นขดลวด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าดัดโค้ง 90 องศา (A 90° curved solenoid filter) ธรรมชาติของอนุภาคระดับ ไมโครเมตรจะเป็นกลางทางไฟฟ้าทำให้สามารถที่จะแยกออกจากพลาสมาได้เมื่ออยู่ในขดลวด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและด้วยลักษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของพลาสมาที่พุ่งออกไปข้างหน้าแตกต่าง จากอนุภาคระดับไมโครเมตรที่พุ่งออกจากพื้นผิวของคาโธดในลักษณะทำมุมประมาณ 20 องศา

ตัวกรองแบบสนามแม่เหล็กสามารถที่จะแบ่งแยกตามลักษณะ โครงสร้างได้ 2 รูปแบบ (Sanders et al., 2000) ดังนี้

ตัวกรองแบบปิด (closed-architecture filters): มีลักษณะเป็นท่อทรงปิด ดังนั้นมันอาจถูก เรียกเป็นแบบท่อ "duct" มีลักษณะเป็นท่อที่มีขดลวดสนามแม่เหล็กพันล้อมรอบ ซึ่งอนุภาคระดับ ใมโครเมตรที่เกิดขึ้นภายในจะไม่สามารถออกจากตัวกรองลักษณะนี้ได้ ดังนั้นมีแนวโน้มที่จะติด หรือสะท้อนผนังภายในท่อมาชนกับวัสดุพื้นได้ สำหรับวัสดุคาโชดบางชนิด ยกตัวอย่างเช่น อนุภาคระดับไมโครเมตรของการ์บอนจะไม่ติดอยู่ที่ผนังท่อ แต่มักจะสะท้อนอยู่ภายในผนังท่อ มากกว่า

ตัวกรองแบบเปิด (opened-architecture filters): ปัญหาของอนุภาคระดับไมโครเมตรมี แนวโน้มที่จะสะท้อนสามารถจัดการโดตัวกรองลักษณะนี้ได้ เพราะอนุภาคระดับไมโครเมตร สามารถที่จะลอดผ่านออกไปได้ ตัวกรองแบบเปิด ไม่มีลักษณะที่เป็นท่อปิดแต่ประกอบด้วยขดลวด สนามแม่เหล็กที่ตั้งอย่างอิสระ (free-standing magnetic field coil) ซึ่งยอมให้อนุภาคระดับ ไมโครเมตรผ่านไปได้ระหว่างช่องของขดลวดโดยปราศจากการเกาะติดที่ผนังท่อ แต่ปัญหาเรื่อง อนุภาคระดับไมโครเมตรก็ยังไม่สามารถกำจัดให้เป็นศูนย์ได้ เนื่องจากบางอนุภาคอาจสะท้อนจาก ขดลวดลงสู่ชั้นเคลือบได้เช่นกัน ดังนั้นตัวกรองแบบตั้งอย่างอิสระก็ยังไม่สามารถรับประกันว่าจะ ได้ชั้นเคลือบที่ปราศจากอนุภาคทั้งหมด

โดยทั่วไปตัวกรองแบบปิดจะถูกใช้ในระบบกระแสตรงขณะที่การทำงานระบบพัลส์จะใช้ เป็นตัวกรองแบบเปิดซึ่งลักษณะของตัวกรองที่ใช้เพื่อกำจัดอนุภาคระดับไมโครเมตรในคาโธดิก อาร์กส่วนใหญ่จะเป็นตัวกรองแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดัดโด้ง 90 องศา (90° curved solenoid filter)

การเคลือบแบบคาโชดิกอาร์ก

การเคลือบด้วยพลาสมา (plasma-assisted deposition) คือ เทคนิคที่ให้พลาสมาของโลหะ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการสังเคราะห์ชั้นเคลือบ มักถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อการ ปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุและเพื่อสร้างชั้นเคลือบต่าง ๆ เช่น ชั้นเคลือบเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออปติกอล และชั้นเคลือบเพื่อต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อน

โดยพลาสมาของโลหะจะเกิดขึ้นที่จุดอาร์กบนคาโธดก่อนพุ่งออกจากคาโธดด้วยความเร็ว ของไอออนในช่วง 1 ถึง 3×10⁴ เมตรต่อวินาที ซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานของไอออนประมาณ 10 ถึง 200 อิเล็กตรอนโวลต์ขึ้นอยู่กับมวลไอออนของวัสดุกาโธดนั้น ด้วยลักษณะนี้มีความสำคัญมากต่อ กุณภาพของชั้นเคลือบ การเคลือบที่พลังงานของไอออนสูงจะทำให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะต่อการโต ของชั้นเคลือบ ทำให้อะตอมมีความสามารถในการเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ดี นำไปสู่ชั้นเคลือบที่มี กุณภาพสูง และปรับปรุงการยึดเกาะของชั้นเคลือบให้ดีขึ้น

ผลกระทบของการใบแอสต่อชั้นเคลือบ

การใบแอส (biasing) ที่วัสดุพื้น (substrate) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ ้ควบคุมพลังงานของไอออนในการเคลือบชั้นเคลือบที่เกี่ยวข้องกับพลาสมา โดยทั่วไปในการ ้ใบแอสจะใช้ศักย์ใฟฟ้าลบ เพื่อที่ไอออนบวก (ในกรณีที่คาโธดเป็นคาร์บอน, C⁺) จะได้ถูกดึงออก ้งากพลาสมาและถูกเร่งความเร็วก่อนที่จะตกกระทบที่พื้นผิวของวัสดุพื้นด้วยการควบคุมพลังงาน ของไอออนจะส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่น ความเค้นของชั้นเคลือบและการใช้ไบแอสสามารถ ที่จะเปลี่ยนแปลงกุณสมบัติของชั้นเกลือบเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชั้นเกลือบที่มีกุณสมบัติที่ดีที่สุด ใน ปัจจุบันมีรูปแบบการใช้ใบแอสอย่างหลากหลาย เช่น ใบแอสแบบกระตรง (direct current, DC bias) ใบแอสกระแสตรงแบบพัลส์ (pulse DC bias) ใบแอสแบบคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency, RF bias) ซึ่งไบแอสจะกระทำเฉพาะกับไอออนเท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้ไบแอสก็ยังต้อง ระมัคระวังเมื่อกาโธคที่ใช้มีธาตุผสมที่ให้มวลของไอออนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการสปัตเตอร์ที่ แตกต่างกัน แม้ว่าศักย์ที่ใช้ในการใบแอสจะเท่ากัน ปัญหามักเกิดขึ้นกับกาโธดที่มีมวลของไอออน หนัก (heavier ion) และค่าสถานะของประจุ (charge state) สูง ซึ่งในกรณีนี้พลังงานของไอออนจะ ้สูงขึ้นตามค่าสถานะประจุ ดังนั้นส่งผลให้การสปัตเตอร์สูงด้วยการรวมกันของมวลขนาดใหญ่ขึ้น และพลังงานสูงขึ้น เมื่อพลังงานในการสปัตเตอร์ดังกล่าวสูงเกินไปจะส่งผลเสียทำให้อัตราส่วนของ ้อะตอมหนักและเบาในชั้นเกลือบที่ต้องการไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับค่าการ ้ไบแอสเพื่อทำให้สอดคล้องกับพลังงานของไอออนที่จะวิ่งเข้ามายังชิ้นงานและเพื่อให้ได้ชั้นเคลือบ ที่มีสมบัติตามต้องการ

การเตรียมชิ้นงานสำหรับเคลือบผิว

 ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องสั่นแบบอัลตราโซนิกส์ในสารละลายอะซิโตน 5 นาที ตามด้วย สารละลายเอทธานอล 5 นาที และสุดท้ายเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน (ในกรณีที่ ต้องเตรียมชิ้นงานเพื่อนำไปทดสอบด้วยเทคนิค LEEM/PEEM จำเป็นต้องตัดชิ้นงานให้มีขนาด ความกว้าง ยาวและหนาเท่ากับ 1 1 และ 2.5 เซนติเมตร เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบและมีพื้นผิวเรียบ เพื่อป้องกันการอาร์กของชิ้นงานขณะทดสอบ)

 ควรใช้ถุงมือหรือใช้คืมทุกครั้งที่สัมผัสกับชิ้นงานที่ถ้างเสร็จแล้ว เนื่องด้วยถ้าชิ้นงาน มีคราบสกปรกจะเป็นปัญญาหาต่อระบบสุญญากาศ

 การติดชิ้นงานบนวัสดุพื้นควรใช้กาวหรือเทปกาวที่สามารถใช้ในระบบสุญญากาศ ได้ (ปกติจะใช้เทปการ์บอน)

การเปิดระบบปั้มและน้ำหล่อเย็น

การสร้างระบบสุญญากาศจะต้องเปิดปั๊มหมุน (rotary pump) และตามด้วยปั๊มโมเลกุลแบบ เทอร์โบ (turbomolecular pump) ส่วนการปิดกีทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ

 การสร้างระบบสุญญากาศขั้นต้น (~1013 มิลลิบาร์) ใช้ปั้มหมุน ซึ่งให้ความคันต่ำสุด ประมาณ 10⁻³ มิลลิบาร์ เท่ากับ 0.75×10⁻³ ทอร์ โดยการเสียบปลั๊กของปั้มหมุนเครื่องปั้มก็จะเริ่มปั้ม

 ตามด้วยเปิดสวิตช์ด้านหลังตัวแสดงสถานะปั๊มโมเลกุลแบบเทอร์โบ ดังรูปที่ v.1.1 (หมายเลv 1) หลังจากนั้นรอให้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วจึงเสียบ D-sub pin ที่ตัวควบคุมปั๊ม ดังรูปที่
 v. 1.2 (หมายเลv 2) เครื่องก็จะเริ่มการปั๊ม (ระบบสุญญากาศขั้นสูง 5×10⁻⁵ ถึง 5×10⁻⁶ มิลลิบาร์ ควร
 เปิดปั๊มโมเลกุลแบบเทอร์โบที่ความดันประมาณ 2×10⁻² ทอร์ เพื่อป้องกันใบพัดของปั๊มเสียหาย) ปั๊ม
 โมเลกุลแบบเทอร์โบที่ใช้สำหรับระบบดังกล่าวจะให้ความดันต่ำสุดประมาณ 2.5×10⁻⁶ ทอร์ โดย

อากาศที่อยู่ในห้องเคลือบจะถูกดูดออกผ่านปั๊มโมเลกุลแบบเทอร์และปั๊มหมุนโบตามลำดับ 3. การเปิดระบบหล่อเย็น กดปุ่ม ON ด้านหน้าเครื่อง ดังรูปที่ ข. 2 ซึ่งการเปิดระบบ หล่อเย็นจะเปิดก่อนการเคลือบประมาณ 5 ถึง 10 นาที เพื่อให้อุณหภูมิของระบบเคลือบใกล้เคียงกับ อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น หลังจากเคลือบเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ 5 ถึง 10 นาที เพื่อป้องกัน thermal shock





รูปที่ ข. 1.2 D-sub pin และตัวควบคุมปั้ม

รูปที่ ข. 1.1 สวิตช์เปิด/ปิค ตัวแสดงสถานะของปั้ม





รูปที่ ข. 2 สวิตช์ ON/OFF ระบบน้ำหล่อเย็น

การเปิดเครื่องเคลือบชั้นเคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร

 เปิดเครื่องง่ายสักย์ไฟฟ้าไบแอสที่ใช้สำหรับง่ายสักย์ไฟฟ้าไบแอสให้กับชิ้นงาน กดสวิตช์ด้านหลัง ดังรูปที่ ข. 3.1 แล้วตามด้วยทำการโยกสวิตช์ด้านหน้าขึ้น ดังรูปที่ ข. 3.2 ไปที่กำ ว่า ON หลังจากนั้นสามารถปรับขนาดศักย์ไฟฟ้าไบแอสได้ด้วยปุ่มหมุนปรับโวลต์

2. ต่อสาย USB จ่ายไฟให้แผงวงจรควบคุม pulse (Arduino Diecomila)

 กดสวิตช์เปิดด้านหลังเครื่อง Plasma Arc Power Supply ดังรูปที่ ข. 4.1 เพื่อเปิด สวิตช์ง่ายศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอาร์ก

4. สุดท้ายโยกสวิตช์เปิดจ่ายไฟไปที่ ON ให้ Arduino ทำงาน ดังรูปที่ ข. 4.2 ระบบก็จะ เริ่มทำการเคลือบ





รูปที่ ข. 3.1 สวิตช์เปิด/ปิด เครื่องจ่ายศักย์ไฟฟ้า ใบแอส

รูปที่ ข. 3.2 สวิตช์ ON/OFF และปุ่มหมุนปรับ ศักย์ไฟฟ้า





รูปที่ ข. 4.1 เครื่อง Plasma Arc Power Supply



รูปที่ ข. 4.2 แผงควบคุมพัลส์ในการอาร์ก (Arduino Diecimila) และสวิตช์ ON/OFF

การปิดเครื่องเคลือบชั้นเคลือบการ์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร

 โยกสวิตช์ที่ Arduino ไปที่ OFF หยุดการจ่ายไฟให้ Arduino ระบบก็จะหยุดการ เคลือบ แล้วถอดสาย USB ที่จ่ายไฟออกเก็บให้เรียบร้อย

 ลดงนาดศักย์ไฟฟ้าไบแอสให้เป็น 0 ก่อนโยกสวิตช์ด้านหน้าเครื่องไปที่ OFF แล้ว ปิดสวิตช์ด้านหลังตัวเครื่องอีกครั้ง

3. กดสวิตช์ปิดด้านหลังที่ง่ายไฟให้เครื่อง Plasma Arc Power Supply

4. ปิคระบบน้ำหล่อเย็นให้รอประมาณ 5 ถึง 10 นาที เพื่อให้ระบบถ่ายเทความร้อนที่ เหลือออก หลังจากนั้นกคปิคด้านหน้าเครื่องหล่อเย็น

หลังจากปิดระบบไฟฟ้าครบแล้ว ให้ปิดปั้ม โมเลกุลแบบเทอร์ โบก่อน โดยการถอด
 D-sub pinoon แล้วรอจนกระทั่งรอบของปั้ม โมเลกุลแบบเทอร์ โบเป็น 0 เฮิรตซ์ ดูที่หน้าจอ monitor
 ของตัวแสดงสถานะปั้ม แล้วจึงปิดปั้มหมุนตามลำดับ

6. ภายหลังปิดระบบปั๊มเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะเปิดห้องเกลือบให้ปรับความดันภายใน และภายนอกห้องเกลือบให้เท่ากันโดยการเปิดวาล์วก๊าซไนโตรเจนที่ต่อไว้ที่ห้องเกลือบเข้า (ระวัง ก่อนเปิดก๊าซไนโตรเจนเข้าต้องกลายเกลียวยึดหน้าแปลน (flange) ออก เพื่อป้องกันแรงดันภายใน ห้องเกลือบเกินก่าวิกฤต ซึ่งอันตรายอาจทำให้ view port ระเบิดได้) ดังรูปที่ ข. 5 หลังจากนั้น สามารถที่จะนำชิ้นงานออกจากห้องเกลือบได้ โดยจำเป็นต้องใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนสัมผัสชิ้นงาน เพื่อป้องกันกราบสกปรกปนเปื้อนชิ้นงาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อระบบสุญญากาศ



รูปที่ ข. 5 วาล์วเปิค/ปิค ก๊าซไนโตรเจน

การปฏิบัติในการเคลือบครั้งต่อไป

บริเวณหัวอาร์กระหว่างฉนวนที่เป็นเซรามิกส์และกราฟไฟต์ จำเป็นต้องเคลือบด้วยตัวนำ ทุกครั้งก่อนเริ่มการเคลือบครั้งใหม่ เพื่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านและเกิดการอาร์กได้ ซึ่งในที่นี้ใช้ดินสอ 2B ทำการเคลือบให้รอบบริเวณ A และ B ดังรูปที่ v. 6 หลังจากนั้นวัดค่าการนำไฟฟ้า ดังรูปที่ 7 (ระหว่างหมาย 1 และ 2) ให้ได้ค่าต่ำกว่า 400 โอห์ม จึงทำให้เกิดการอาร์กได้ นอกจากนี้หลังจาก เคลือบทุกครั้งที่ปลายของแท่งกราฟไฟต์จะสึกกร่อน ซึ่งจำเป็นต้องขัดให้เสมออีกครั้ง



รูปที่ ข. 6 ฉนวนเซรามิกส์และบริเวณที่ต้องเคลือบด้วยคินสอ 2B



รูปที่ ข. 7 แสดงตำแหน่งการวัดการนำไฟฟ้าด้วยมิเตอร์วัดไฟฟ้า



ภาคผนวก ค

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ะ _{7 วิ}กยาลัยเทคโนโลยีสุรบได

รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

- Konkhunthot, N., Euaruksakul, C., Photongkam, P., and Wongpanya, P. (2013). Characterization of diamond-like carbon (DLC) films deposited by filtered cathodic vacuum arc technique. Journal of Metals, Materials and Minerals. 23(1). (อยู่ระหว่าง ขั้นตอนในการดำเนินการตีพิมพ์)
- Photongkam, P., Konkhunthot, N., Tunmee, S., Euaruksakul, C., and Wongpanya, P. Investigation wear-resistant thin film by X-ray Photoelectron Emission Microscopy. 8th International Workshop on Low Energy Electron Microscopy and Photoemission Electron Microscopy. Hong Kong. 11-15 November 2012.





JOURNAL OF METALS, MATERIALS AND MINERALS (J. Mot. Mator. Miner.)

Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chutalongkorn University Sci Chuta 12, Physichai Road, Bangkok 10330, Thailand Tel.:+66 2218 4209-12 Fax: +56 2611 7586 E-mail: prant.p@chuta.ac.th Homepage http://www.material.chula.ac.th/gumm

Reference No: 12/2013

January 23, 2013

Pernwasa Wengpanya School of Metallorgical Engineering. Institute of Engineering, Suzararee University of Technology, Nakhon Ratebasima 3000

Dear Authors,

Thank you for submitting your manuscript entitled "Characterization of diamond-like carbon (DLC) films deposited by filtered cathodic vacuum are technique" to the Journal of Metals, Materials and Minerals. I am pleased to inform you that your manuscript has now been accepted for publication in Vol.23 No.1 (June, 2012). You should receive the galley proof shortly. Further correspondence regarding this manuscript should be addressed to the Journal's Managerial Office at the above address.

May I take this opportunity to thank you for contributing your work to our Jeannal.

Sincerely years,

Associate Professor Prantt Poliyaraj, Pk.D. Editor-in-Chief, Journal of Metals, Materials and Minerals Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.23 No.1 pp., 2013

Characterization of Diamond-like Carbon (DLC) Films Deposited by Filtered Cathodic Vacuum arc Technique

Natthaphong KONKHUNTHOT¹, Chanan EUARUKSAKUL², Pat PHOTONGKAM² and Pornwasa WONGPANYA¹*

¹School of Metallurgical Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 3000, Thailand
²Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Nakhon Ratchasima 3000, Thailand

Abstract

Diamond-like carbon (DLC) films were prepared on AISI H13 hot-work tool steel substrates by filtered cathodic vacuum arc (FCVA) technique under variable substrate DC biasing. The atomic structures of the films were investigated by Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and near edge x-ray absorption fine structure spectroscopy. The Raman spectra revealed that when the magnitude of the bias voltage increased, the G peak was shifted toward lower wave numbers, and indicated that the sp³ content in the DLC films increased. The ratios between the sp³ and sp² bonds in the films were verified by X-ray photoelectron spectroscopy, and the analyses from near-edge x-ray absorption fine structure measurements demonstrated the mixture of the sp³, sp² bonds together with C-O, C-H bonds, and the amorphous structure in the DLC films.

Key words : Filtered cathodic vacuum arc, Diamond-like carbon, Amorphous carbon film, Bias voltage

Introduction

AISI H13 hot-work tool steel is the most popular materials for hot working of industries in Thailand. It has been utilized as parts of hot molds, punches, extrusion dies, and forging because of its high toughness, wear and abrasion resistance and red hardness. However, applications of AISI H13 under an exposure to lubricant and high temperature may result in the corrosion of surface, leading to severe degradation of the properties. A possible way to solve this problem is to use surface modification methods such as carburizing, carbonitriding, nitriding, chemical vapor deposition, and physical vapor deposition to help improve the corrosion resistance. In the past, hard Cr-plating has been the most widely used technique for this purpose. However, despite the excellent wear and corrosion resistance properties, the negative health impact and environmental in hazards in the form of chromic-acid by-products have led to the reduction of hard Cr-plating usage worldwide.(1) In recent years, diamond-like carbon (DLC) coating becomes a more environmentalfriendly alternative to Cr-plating. DLC possesses excellent physical and chemical properties similar to those of diamond film^(2,3), having extreme characteristics of not only high hardness and wear resistance, and low friction coefficient, but also high chemical inertness. As a result, the DLC coatings have been extensively used to prevent corrosion in molds, sliding parts, auto mobile parts, magnetic storage disks, cutting tools, high precision gears, micro electro-mechanical devices and biomedical equipment.⁽⁴⁾ The properties of DLC films are strongly dependent on the fraction of sp3/sp2 C bonding as the mixed bonds provide combined characteristics of diamond and graphite. In many applications of DLC, the sp3 C bonding is desirable as it provides higher hardness, Yong's modulus, and wear resistance. There are several deposition methods which have been successfully used to synthesize the DLC films: plasmaenhanced chemical vapor deposition(5), ion-beam deposition⁽⁶⁾, DC and RF magnetron sputtering depositions⁽⁷⁾, ion plating⁽⁸⁾, laser ablation, mass selected ion beam deposition, plasma-immersion ion implantation and deposition⁽⁰⁻¹¹⁾, and filtered cathodic vacuum arc (FCVA) deposition. Among these, FCVA has been proved as one of the most successful to synthesize high quality DLC films, typically having sp3-bonded C close to 90% of the total mass.^(13,14) However, in metallurgical applications, one of the main problems of DLC films prepared on steel substrates is the poor adhesion due to the diffusion of C from the films into the steel substrates, after which delaminating of the DLC films takes place.⁽¹⁵⁾ This problem can

* Corresponding author. E-mail address: pornwasa@sut.ac.th

KONKHUNTHOT, N. et al.

be solved by depositing a barrier layer prior to the DLC coatings to hinder the C diffusion.⁽¹⁶⁾ Many effective barrier layers have been applied such as Si^{160} , $\mathrm{Nb}^{(17)}$, $\mathrm{TiN}^{(17)}$, $\mathrm{Ti}\mathrm{N}^{(17)}$, $\mathrm{W}^{(17)}$, $\mathrm{Cr}^{(18)}$, and $\mathrm{Mo}.^{(19)}$

The objective of this work is to investigate compositions and structures of DLC films prepared on AISI H13 hot work tool steel substrates by FCVA using a variety of the substrate negative bias voltages in order to improve the sp³/sp² bonding ratio. The DLC films were examined by Raman spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and near edge x-ray absorption fine structure (NEXAFS) spectroscopy.

Materials and Experimental procedures

DLC films were deposited on AISI H13 hot work tool steel substrates (the chemical composition of the steel is shown in Table 1) at room temperature using FCVA under variable negative DC biasing on the substrates. To prepare the substrates, first, the steel was cut into rectangular pieces of 10 mm × 10 mm × 2.5 mm. Then, the samples were heat-treated at 1075°C followed by oil quenching and tempering. Their hardness at this stage was measured as about 50 HRC, which was within the standard range of this material. Subsequently, the samples were polished with SiC sand paper in order to smoothen the surface, and then successively cleaned by ultra-sonication in acetone, isopropyl alcohol, and de-ionized water for 5 minutes each. The samples were pre-coated with ~100 nm Ti interlayer by DC magnetron sputtering to improve the adhesion and to prevent the C inter-diffusion. For DLC deposition, the samples were introduced to the FCVA chamber which was later pumped down to ~3.0 × 10-5 Torr by a turbo-molecular pump. The C deposition is supplied by a graphite rod with a diameter of 6.25 mm and purity of 99.99%. During the deposition, a negative DC bias was applied to the samples. For each set of samples, we selected the bias voltage (-Vb) from 100 to 1000 V. The film thickness was controlled by the deposition time.

Table 1. Chemical composition of AISI H13 hot work tool steel.

Elements	с	Si	Cr	Mo	v	Fe
WL %	0.40	1.00	5.30	1.40	1.00	Bal.

The bonding structure of the deposited DLC films was characterized by Raman spectroscopy with the source λ of 514.5 nm produced by a 20 mW Ar-ion laser. The chemical states and the electronic structures of the films were determined by XPS at Beamline 3.2a: PES and NEXAFS at Beamline 3.2b: PEEM at the Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Thailand. The Raman and XPS spectra were curve-fitted by ORIGIN and ADVANTAGE softwares to evaluate the I_D/I_G ratio, the G peak position, the sp³/sp² contents in the DLC films for comparison with other references.

Results and Discussions

Raman spectroscopy in the 800–2300 cm⁻¹ spectral range is extensively used to identify the sp³ and sp² sites in the DLC film.⁽²⁰⁾ For pure diamond, the Raman peak is located at 1332 cm⁻¹, while for graphite the peaks are located at 1350 and 1580 cm⁻⁽⁽²¹⁻²³⁾

The Raman spectrum of disordered graphite shows two sharp peaks. The peak around 1580– 1600 cm⁻¹ is designated as the "G" peak attributed to graphite-like layers of sp² microdomains, and the other peak around 1350 cm⁻¹ is designated as the "D" peak representing bond-angle disorder in the sp² graphite-like microdomains.⁽²⁴⁻²⁷⁾ In comparison, the Raman spectrum of amorphous C contains two broad peaks, a G peak centered around 1500-1700 cm⁻¹ and a D peak centered around 1200-1450 cm⁻¹.

Figure 1, shows the Raman spectra of DLC films deposited with different substrate bias voltages. The spectra from all samples in this study have similar shape, with a broad skewed peak centered at approximately 1560 cm⁻¹, which is the characteristic of the diamond-like structure.(28) Each spectrum can be decomposed into two Gaussian line curves, one at the lower wave numbers between 1350 and 1370 cm⁻¹ (D peak) and the other at the higher wave numbers between 1545 and 1565 cm⁻¹ (G peak). The structure of the different C films can be specified by analyzing features in the Raman spectra, such as the relative position of G and D peaks, the intensity ratio of the fitted Gaussian curves representing each peak (1_D/I_G), or the full width half maximum of each.⁽²⁹⁾ From Figure 2, when the magnitude of the bias voltage increase from -100 to -200 V, the G peak shifted toward lower wave numbers from 1564 to 1557 cm-1. For

Characterization of Diamond-like Carbon (DLC) Films Deposited by Filtered Cathodic Vacuum arc Technique

the bias voltage from -600 to -1000 V, the G peak shifted to lower wave numbers from 1560 to 1546 cm⁻¹. In the same way, the D peak also shifted toward lower wave numbers. The shift of G peak position toward the lower wave numbers has been related to the increase of the sp³ fraction of the DLC films.⁽³⁰⁾ In our results, the G peak position tends to decrease as the negative bias voltage increases, which suggests that more sp³ content can be achieved by applying higher sample bias. The increase of the sp³ bonding is mainly owing to the higher acceleration of bombarding ion species during the FVCA deposition, leading to implantation and local densification under the surface of the DLC films.⁽³¹⁾

XPS is used to study the chemical states of the prepared DLC films. In Figure 3, the C1s XPS spectra of the -100 V and -1000 V DLC films were deconvoluted into three peaks at around 287.5, 285.0, and 284.0 eV. The background is subtracted by Shirley method. The first peak at 287.5 eV is corresponded to C–O bonding from contamination which may have been deposited during the sample preparation and from moisture in the atmosphere while the peaks at 285.0 and 284.0 eV are corresponded to sp³ bonding (diamond), and sp² bonding (graphite), respectively. Our XPS measurement is consistent with reference⁽⁵⁾, thus confirming the diamond-like structure in the films. From Gaussian fitting, the calculated percentages of sp³, sp² C-C, and C-O bonds are shown in Table 2.





negative bias voltage.



Figure 3. C1s XPS spectra of DLC films prepared by FCVA with negative bias voltages of 100 and 1000 V.

Table 2. Peak positions in the XPS spectra of DLC films analyzed using Gaussian-curve fitting procedure

Bias (-V _b)	Structure	Center (eV)	Area	At. %
	C-sp ³	284.9	382.8	89.1
1000	C-sp ²	284.0	26.2	4.7
	C-0	287.7	20.2	6.2
	C-sp ³	C-sp ³ 285.0 229.5	229.5	83.3
100	C-sp ²	284.2	21.2	7.6
	C-0	288.0	24.5	9.1

KONKHUNTHOT, N. et al.

The NEXAFS technique is performed in the electron-yield mode to determine electronic structure of the sp3 and sp2 bond mixture. Figure 4, shows the C K-edge absorption spectra of the DLC films deposited under the sample bias of -100, -600, and -1000 V. The spectra of all samples show three main peaks. The peak located at 285.2 eV is corresponded to the transition from C (1s) $\rightarrow \pi^*$ state in graphite (sp² hybridization), the small shoulder near 287.8 eV is due to the C (1s) $\rightarrow \sigma^*$ transition of carbon atoms bonded to H and O [sp3 (C-H) or sp2 (C=O)]. The peak located at 289.5 eV is due to the transition of C (1s) $\rightarrow \sigma^*$ state, the characteristics for diamond's sp3 hybridization. The broadened absorption feature behind 291 eV reveals the amorphous structure of the films." Taking the NEXAFS measurements with longer acquisition time to improve the quality of the spectra are required in order to further analyze the difference in the electronic structures between DLC films deposited in the different conditions.



Figure 4. Carbon K-edge spectra of DLC films synthesized using FCVA with a substrate negative bias voltage at 100, 600, and 1000 V.

Conclusions

The DLC films were successfully synthesized by FCVA using substrate negative DC biasing as a variable to control the sp3 content. The bonding ratio and the atomic structure of the DLC films were investigated with Raman spectroscopy, XPS, and NEXAFS techniques. The measurement results can be summarized as follows.

- a. The Raman spectra of the DLC films reveal that an increase in the negative bias voltage improves the sp³ content of the DLC films.
- b. XPS demonstrates that the DLC films mainly contain a mixture of sp³ and sp² bonds along with C-O bonding. The peakfitting results from DLC deposited under -100 and -1000 V bias are in agreement with the Raman measurement.
- c. NEXAFS spectra illustrate the amorphous structure of the films, and the C-O and C-H bonds mixing among the sp³ and sp² bonds.

Acknowledgements

The authors wish to thank the Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Thailand, for financially supporting this research, BL6a: DXL for Ti sputtering and the measurement of film thickness, and Western Digital (Thailand) Co., Ltd., for the Raman spectroscopy measurement.

References

- Leu, Ming-Sheng, Chen, S.Y., Chang, J.J., Chao, L.G. and Lin, W. (2004). Diamondlike coatings prepared by the filtered cathodic arc technique for minting application. Surf. Coat. Technol. 177-178 : 566-572.
- Huang, L.Y., Zhao, J.W., Xu, K.W. and Lu, J. (2002). A new method for evaluating the scratch resistance of diamond-like carbon films by the nano-scratch technique, *Diamond Relat. Mater.* 11: 1454–1459.
- Liao, J.X., Liu, W.M., Xu, T. and Xue, Q.J. (2004). Characteristics of carbon films prepared by plasma-based ion implantation. *Carbon.* 42: 387-393.
- Tsai, P.C. and Chen, K.H. (2008). Evaluation of microstructures and mechanical properties of diamond like carbon films deposited by filtered cathodic arc plasma. *Thin Solid Films*. 516(16): 5440-5444.
- Wu, J. B., Chang, J. J., Li, M. Y., Leu, M. S. and Li, A. K. (2007). Characterization of diamond - like carbon coatings prepared by pulsed bias cathodic vacuum arc deposition. *Thin Solid Films*. 516(2-4) : 243–247.



KONKHUNTHOT, N. et al.

- 25. Tuinstra, F. and Koeing, J.L. (1970). Raman Spectrum of Graphite. Chin. J. Chem. Phys. 53: 1126-1130.
- Beeman, D., Silverman, J., Lynds, R. and Anderson, M.R. (1984). Modeling studies of amorphous carbon. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 30(2): 870-875.
- 27. Dillon, R.O., Woollam, J. A. and Katkanant, V. (1984). Use of Raman scattering to investigate disorder and crystallite formation in as-deposited and annealed carbon films. Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 29: 3482.
- 28. Yoon, S.F., Yang, H., Rusli, A., Ahn, J. and Zhang, Q. (1998). Large area deposition of diamond like carbon coatings by microwave electron cyclotron resonance (ECR) plasmas. Diamond Relat. Mater. 7:70.
- 29. Chu, P. K. and Li, L. (2006). Characterization of amorphous and nanocrystalline carbon films. Mater. Chem. Phys. 96(2-3): 253-277.
- 30. Lung, B.H., Chaing, M.J. and Hon, M.H. (2001). Growth characterization and properties of diamond-like carbon films by electron cyclotron resonance chemical vapor deposition. Thin Solid Films. 392(1) : 16-21.
- 32. Jiménez, I., Sutherland, D. G. J., Van Buuren, T., Carlisle, J. A., Terminello, L. J. and Himpsel, F. (1998). Photometry ray-absorption study of boron carbide and its surface thermal stability. *Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys.* **57(20)** : 13167-13174.



ประวัติผู้เขียน

นายณัฐพงศ์ กลขุนทด เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2531 สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2548 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ในระหว่างที่กำลัง ศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับทุนสหกิจศึกษาจากบริษัทไทย โตเลน เทอร์โม จำกัด พร้อมกันนี้ ได้รับการกัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นนักศึกษาสหกิจดีเด่นของสาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 หลังจากสำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2553 โดยได้รับทุนสนับสนุน บัณฑิตศึกษาจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องก์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในระหว่างนี้ได้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ที่สถานีทดลอง 3.2b ของสถาบันวิจัยแสง ซินโครตรอน (องก์การมหาชน) นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช 2555 ได้เสนอผลงานทางวิชาการใน งานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Metallurgy Conference, TMETC 6, 2012 Chiang Mai, Thailand)

โดยมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้

 Konkhunthot, N., Euaruksakul, C., Photongkam, P., and Wongpanya, P. (2013) Characterization of diamond-like carbon (DLC) films deposited by filtered cathodic vacuum arc technique, Journal of Metals, Materials and Minerals. 23 (1). (อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ตีพิมพ์)

(2) Photongkam, P., Konkhunthot, N., Tunmee, S., Euaruksakul, C., and Wongpanya, P. Investigation wear-resistant thin film by X-ray Photoelectron Emission Microscopy. 8th International Workshop on Low Energy Electron Microscopy and Photoemission Electron Microscopy. Hong Kong. 11-15 November 2012.